

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2026-011



北京赛微电子股份有限公司

2025 年年度报告

2026 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨云春、主管会计工作负责人许骥及会计机构负责人(会计主管人员)霍夕淼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加，主要系 2025 年 7 月公司完成对原全资子公司瑞典 Sillex 控制权的出售。上述股权交易完成后，瑞典 Sillex 由公司全资子公司转变为公司参股子公司，不再纳入上市公司合并报表范围，由此产生的非经常性损益对本报告期归属于上市公司股东的净利润产生重大影响；同时，瑞典 Sillex 控制权出售亦对本报告期 MEMS 纯代工收入及总体营业收入构成较大影响。报告期内，公司完成对展诚科技 56.24%股权的收购，拓展了 IC 设计服务业务，公司还少量从事寄生参数提取 EDA 软件研发并向客户提供寄生参数提取与分析相关技术支持。

公司 MEMS 纯代工与 IC 设计服务面向各芯片设计企业客户；区别于芯片设计公司的产品销售逻辑，公司不涉足自有芯片品牌的研发和设计，不通过销售芯片产品实现收入，而是形成以 MEMS 纯代工服务能力为核心的业务定位，有效保护客户核心 IP 及设计方案，保障与客户合作关系的纯粹性与稳定性。

本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望”章节中，对公司可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、MEMS 业务收入下降风险

公司重大资产出售交割完成后，瑞典 Sillex 由公司全资子公司变为参股子公司，不再纳入公司合并报表。2023-2025 年，瑞典 Sillex 业务收入占公司 MEMS 业务收入的比例分别为 85.56%、82.69%、77.72%，本次控制权出售后，瑞典 Sillex 的收入不再纳入公司合并范围，静态情形下将导致公司 MEMS 业务收入规模大幅下降。

2、业务协同不及预期风险

2025 年 9 月，公司完成对展诚科技 56.24%股权的收购，本次交易完成后公司合计持有展诚科技 61.00%股权，通过本次交易公司拓展了 IC 设计服务业务。得益于集成电路行业总体行业的发展以及展诚科技在 IC 设计服务领域领先的行业地位，展诚科技 IC 设计服务业务发展势头良好，但公司收购展诚科技还旨在进一步拓展和深化在 MEMS 纯代工、IC 设计服务领域的战略布局，即依托展诚科技在 IC 设计服务领域积累的产业资源，以“MEMS+”模式推动双方业务发展，促进公司半导体服务产业生态协同，进一步提升公司综合竞争实力、行业地位和竞争力。若公司未能有效应对与展诚科技在企业文化、

技术体系差异、业务整合管理等可能的多重协同整合影响因素，双方业务或将难以高效协同，因此在未来一段时间内，存在公司与展诚科技业务协同不及预期的风险。

3、国际局势及汇率波动风险

自二战之后，特别是上世纪八九十年代以来，全球化发展日益加速，已成为时代发展的重要特征和显著标志，国家之间在经济、政治、文化、社会等方面的交流程度大幅提升，在加速科技进步和生产力发展的同时，也使得民族国家的利益面临着多元化的冲击和挑战，最终导致民族主义情绪的累积并在近年来显著抬头，右翼民粹主义、反全球化主义、贸易保护主义、本土主义等主张在全球，尤其是欧美国家泛起，引发国际局势紧张及日趋复杂化，对跨国经营的企业提出诸多新的挑战。公司同时持有境内外资产及业务，近年来直接源自境外营业收入的比例较高，2023-2025 年的比例分别为 50.04%、59.28%、60.88%，虽然公司在报告期后已完成瑞典 Sillex 控制权出售的交割，但公司持有外币资产且部分原材料采购以及 MEMS 业务的部分机器设备采购仍涉及外币结算，日常涉及美元、欧元、瑞典克朗、日元、人民币等货币。因此，公司日常经营活动客观上面临着国际政治经济局势剧烈变化的风险，随之而来的还包括因汇率大幅波动对公司报表业绩（以人民币计算）产生较大影响的风险。

4、新兴行业的创新风险

公司 MEMS 主业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，同时也是国家“十五五”规划中的科技前沿攻关领域，该产业技术进步及迭代迅速，要求行业参与者不断通过新技术/工艺的研究和新产品的开发以应对下游需求的变化。如公司对新技术/工艺、新产品的投入不足，或投入方向偏离行业创新发展趋势或未能符合重要客户需求的变化，将会损害公司的技术优势与核心竞争力，从而给公司的市场竞争地位和经营业绩带来不利影响；此外，近年来，公司研发费用支出的绝对金额以及占营业收入的比重均处于高位，2023-2025 年，公司研发费用分别高达 3.57 亿元、4.55 亿元、3.93 亿元，占营业收入的比重分别高达 27.44%、37.75%、47.66%，而研发活动本身存在一定的不确定性，公司还存在研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力的创新风险。

5、行业竞争加剧的风险

公司 MEMS 主业直接参与全球竞争，竞争对手既包括博世、惠普、意法半导体、德州仪器等 IDM 企业，也包括 Teledyne、台积电、X-FAB、索尼、Atomica 等境外代工企业，以及芯联集成、广州增芯、上海先进、华虹宏力、华润微、士兰微、华鑫微纳等含 MEMS 业务的境内企业；IC 设计服务及 EDA 工具服务竞争对手包括创意电子、智原科技、灿芯股份、创耀科技、芯原股份、华大九天、概伦电子、广立微、行芯科技等。MEMS 属于技术、智力及资金密集型行业，涉及电子、机械、光学、医学等多个专业领域，技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响企业核心竞争力的关键因素。若公司不能正确判断未来市场及产品竞争的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 732,213,134 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理、环境和社会.....	75
第五节 重要事项	95
第六节 股份变动及股东情况.....	128
第七节 债券相关情况.....	133
第八节 财务报告	134

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的2025年年度报告文本原件。

以上备查文件备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
赛微电子、公司、本公司	指	北京赛微电子股份有限公司，原名称“北京耐威科技股份有限公司”，原简称“耐威科技”
赛莱克斯国际	指	北京赛莱克斯国际科技有限公司，原名称为“北京瑞通芯源半导体科技有限公司”，系本公司全资子公司
赛莱克斯北京	指	赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司，原名称为“纳微矽磊国际科技（北京）有限公司”，系赛莱克斯国际控股子公司
赛莱克斯、瑞典 Silex	指	Silex Microsystems AB，注册在瑞典的公司，原为赛莱克斯国际间接控股的全资子公司，从事微机电系统（MEMS）产品工艺开发及代工生产业务，2025 年 7 月公司完成对瑞典 Silex 控制权的出售，现为公司参股子公司
运通电子、GAE	指	运通电子有限公司（GLOBAL ACCESS ELECTRONICS LIMITED），为赛莱克斯国际 100%持股的在香港设立的控股型公司
运通电子科技、GAETD	指	运通电子技术发展有限公司（GLOBAL ACCESS ELECTRONICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED），系运通电子全资子公司
微芯科技	指	北京微芯科技有限公司，系本公司全资子公司
极芯传感	指	北京极芯传感科技中心（有限合伙），系本公司控股合伙企业
中科赛微	指	北京中科赛微电子科技有限公司，系微芯科技控股子公司
赛积国际	指	北京赛积国际科技有限公司，原名称为“北京聚能海芯半导体制造有限公司”，系本公司全资子公司
海创微芯	指	北京海创微芯科技有限公司，系微芯科技控股子公司
光谷信息	指	武汉光谷信息技术股份有限公司，新三板挂牌公司，股份代码 430161，系本公司参股子公司
北斗产业基金	指	湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙），系本公司参股合伙企业
国家集成电路基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
飞纳经纬	指	飞纳经纬科技（北京）有限公司，系本公司控股子公司
赛莱克斯深圳	指	赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司，系赛莱克斯国际控股子公司
海创微元	指	北京海创微元科技有限公司，系本公司控股子公司
赛微私募基金	指	北京赛微私募基金管理有限公司，原名称为“北京赛微股权投资管理有限公司”，系本公司参股子公司
阿基米德	指	阿基米德半导体（合肥）有限公司，系本公司参股子公司
展诚科技	指	青岛展诚科技有限公司，系微芯科技控股子公司
北京传感基金	指	北京北工怀微传感科技股权投资基金（有限合伙），系本公司参股合伙企业
深圳智能传感基金	指	深圳市金石重投智能传感器产业私募股权基金合伙企业（有限合伙），系本公司参股合伙企业
芯东来	指	北京芯东来半导体科技有限公司，系微芯科技参股子公司
初芯微	指	杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙），系微芯科技参股合伙企业
ODI	指	境外直接投资（ODI, Overseas direct investment）是指我国企业、团体在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资，并以控制国（境）外企业的经营管理权为核心的经济活动
FDI	指	外国直接投资（Foreign Direct Investment），是指一国的投资者将资本用于他国的生产或经营，并掌握一定经营控制权的投资行为
SEB	指	瑞典北欧斯安银行（Skandinaviska Enskilda Banken, SEB）是瑞典银瑞达集团核心投资的银行之一，也是北欧最大的金融集团之一
Nordea	指	瑞典北欧联合银行（Nordea Bank of Estonia, Nordea）是整个北欧与波罗的海地区重要的金融服务集团
集成电路、IC	指	Integrated Circuit，一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能

		的微型结构
IDM	指	Integrated Device Manufacturer, 整合器件制造商, 又称为集成器件制造商, 指自行进行芯片的设计、制造及封测, 掌握芯片设计与生产制造工艺的半导体公司
MEMS、微机电系统	指	Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写, 即微电子机械系统, 简称为微机电系统, 是指由基于 Micro-machining 技术制造的微传感芯片 (或微执行芯片), 和控制/处理芯片 (ASIC) 组成的微型电子机械系统, MEMS 能够将信息的获取、处理和执行集成在一起, 是一种将微电子技术与微机械工程融合到一起、具有多功能的工业技术及相应的集成系统。MEMS 能够大幅度地提高系统的自动化、智能化水平
EDA	指	Electronic Design Automation, 电子设计自动化, 是指使用软件工具和方法对电子系统进行建模、设计、验证与实现的技术体系, 面向超大规模集成电路 (VLSI) 及相关电子系统, 将功能设计、逻辑综合、仿真验证、物理实现等环节进行流程化与自动化处理。
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片, 由于其形状为圆形, 故称为晶圆; 在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构, 已具备特定功能
吋	指	英寸
DRIE, 深反应离子刻蚀	指	Deep Reactive Ion Etching, 深反应离子刻蚀, 基于氟基气体的高深宽比的干法硅刻蚀技术, 同时使用物理与化学作用进行刻蚀。该技术不仅可将等离子体的产生和自偏压的产生分离, 而且采用了刻蚀和钝化交替进行的工艺, 实现对侧壁的保护, 能够实现可控的侧向刻蚀, 大大提高了刻蚀的各向异性特性, 是超大规模集成电路工艺中很有发展前景的一种刻蚀方法
PE	指	Plasma Etching, 等离子刻蚀, 是指采用高频辉光放电反应, 使反应气体激活成活性粒子, 与被刻蚀材料进行反应形成挥发性反应物从而造成蚀刻
Dry Etching	指	干法刻蚀, 刻蚀的一种工艺, 是指用等离子体进行薄膜刻蚀的技术。干法刻蚀又分为物理性刻蚀、化学性刻蚀、物理化学性刻蚀
Wet Etching	指	湿法刻蚀, 刻蚀的一种工艺, 是指用液体化学试剂以化学方式去除硅片表面材料的技术
Sputtering	指	溅射, 是指只发生在反应物和基体表面的反应。反应物吸附在基体上, 然后第二种气体进入并与基体化学吸附成膜的一种反应方式
MOCVD	指	Metal-Organic Chemical Vapour Deposition, 金属有机化学气相沉积, 是在基板上生长半导体薄膜的一种技术
GaN	指	氮化镓, 氮和镓的化合物, 是一种新型半导体材料, 适合于制造光电子、高温大功率器件和高频微波器件
控股股东、实际控制人	指	杨云春
元/万元	指	人民币元/万元
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
章程、公司章程	指	北京赛微电子股份有限公司章程
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	赛微电子	股票代码	300456
公司的中文名称	北京赛微电子股份有限公司		
公司的中文简称	赛微电子		
公司的外文名称（如有）	Sai MicroElectronics Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	SMEI		
公司的法定代表人	杨云春		
注册地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室（德胜园区）		
注册地址的邮政编码	100029		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室（德胜园区） 北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼		
办公地址的邮政编码	100029、100176		
公司网址	www.smeicc.com		
电子信箱	ir@smeicc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张阿斌	孙玉华
联系地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼
电话	010-82252103	010-82251527
传真	010-59702066	010-59702066
电子信箱	ir@smeicc.com	ir@smeicc.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》 http://www.stcn.com 《证券日报》 http://www.zqrb.cn 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	-------------------

会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房
签字会计师姓名	侯红梅、梁益胜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路 86 号	孙涛、陈胜可	2021.9.8-2023.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 C 座 21 层	樊灿宇、郑敬元、瞿真	2025.7.24-2026.12.31

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	824,105,934.18	1,204,715,636.91	-31.59%	1,299,682,668.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,473,454,069.63	-169,994,109.70	966.77%	103,613,168.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-341,950,113.37	-190,715,861.54	-79.30%	8,153,452.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,906,760.08	355,594,512.77	-103.91%	144,390,831.67
基本每股收益（元/股）	2.0123	-0.2322	966.62%	0.1416
稀释每股收益（元/股）	2.0123	-0.2322	966.62%	0.1416
加权平均净资产收益率	25.27%	-3.37%	28.64%	2.04%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	8,939,422,428.40	7,011,337,774.25	27.50%	7,261,878,738.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,734,386,456.42	4,923,596,975.33	36.78%	5,162,100,953.14

注：上述表格中归属于上市公司股东的净利润与基本每股收益、稀释每股收益本年比上年增减不一致，系因小数点四舍五入导致；此外本年报表格中如出现加总数与各明细数之和在尾数上存在差异亦为小数点四舍五入所致。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

项目	2025 年	2024 年	备注
营业收入（元）	824,105,934.18	1,204,715,636.91	-

正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	40,018,918.68	63,218,695.30	与主营业务无关的业务收入
营业收入扣除金额（元）	40,018,918.68	63,218,695.30	房租收入 30,998,104.41 元，销售原材料收入 8,986,842.57 元，其他服务费收入 33,971.70 元。
营业收入扣除后金额（元）	784,087,015.50	1,141,496,941.61	房租收入 30,998,104.41 元，销售原材料收入 8,986,842.57 元，其他服务费收入 33,971.70 元。

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	264,012,302.74	306,083,480.39	111,819,836.83	142,190,314.22
归属于上市公司股东的净利润	2,642,119.76	-3,292,453.12	1,576,469,980.20	-102,365,577.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,398,865.69	-12,066,792.18	-234,970,682.04	-87,513,773.46
经营活动产生的现金流量净额	93,890,652.87	71,911,900.72	-144,371,526.22	-35,337,787.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,186,089,214.07	11,880,354.71	39,192,800.11	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经	1,240,259.33	15,976,561.42	106,536,415.73	

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-360,871,458.69			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,477.14	11,765.02	54,610.90	
减：所得税影响额	9,525,312.03	3,657,763.97	23,483,759.88	
少数股东权益影响额（税后）	1,456,042.54	3,489,165.34	26,840,350.94	
合计	1,815,404,183.00	20,721,751.84	95,459,715.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求

（一）主要业务

公司是以 MEMS 纯代工模式为理念、特色工艺和制造能力为基础、国际化运营为侧重的半导体专业服务厂商。公司通过长期积累掌握 MEMS 制造核心工艺技术，并努力向硅光、射频、模拟等特色工艺技术进行延伸拓展；公司同时向客户提供 IC 设计服务及 EDA 工具服务，MEMS 等特色工艺开发、集成、晶圆制造及封装测试服务。报告期内，公司服务客户包括硅光子、激光雷达、运动捕捉、光刻机、DNA/RNA 测序、高频通信、AI 计算、ICT、红外热成像、计算机网络及系统、社交网络、新型医疗设备厂商以及各细分行业的领先企业和众多知名芯片设计公司，涉及代工和服务芯片品类范围覆盖了通信计算、生物医药、工业汽车、消费电子等诸多应用领域。公司已初步构建 MEMS 封装测试能力，前瞻性布局 IC 设计服务及 EDA 工具服务，致力于为客户提供从设计服务及 EDA 工具、工艺开发、晶圆制造到封装测试的一站式综合服务，并将着重立足本土，拓展国际化运营。

报告期内，公司从事的主要业务为 MEMS 纯代工、IC 设计服务，以及基于存量设备继续开展部分半导体设备业务。同时，公司围绕半导体主业持续开展产业投资布局，对实体企业、产业基金进行参股型投资。

报告期内，为公司贡献业绩的业务主要为 MEMS 纯代工，IC 设计服务。公司 MEMS 纯代工与 IC 设计服务面向各芯片设计企业客户；区别于芯片设计公司的产品销售逻辑，公司不涉足自有芯片品牌的研发和设计，不通过销售芯片产品实现收入，而是形成以 MEMS 纯代工服务能力为核心的业务定位，有效保护客户核心 IP 及设计方案，保障与客户合作关系的纯粹性与稳定性。

1、MEMS 纯代工业务

公司 MEMS 纯代工包括工艺开发与晶圆制造。MEMS 工艺开发是指根据客户提供的芯片设计方案，以满足产品性能、实现产品“可生产性”以及平衡经济效益为目标，利用工艺技术储备及项目开发经验，进行产品制造工艺流程的开发，为客户提供定制的产品制造流程。MEMS 晶圆制造是指在完成 MEMS 芯片的工艺开发，实现产品设计固化、生产流程固化后，为客户提供批量晶圆制造服务。

2、IC 设计服务业务

公司 IC 设计服务业务，是指以芯片设计公司为主的客户在提出芯片具体功能要求后，公司协助其进行相关产品定义、架构设计、工艺选型、IP 选型、电路设计、仿真、物理设计以及量产流片等相关设计服务工作。同时，基于客户需求，公司也开始向客户少量提供 EDA 软件开发和技术支持服务。

3、半导体设备业务

近年来，为应对国际政治经济环境可能发生的极端变化，公司旗下子公司曾从境外战略性采购了多批次半导体设备进行储备使用，根据公司业务发展的实际需要及环境变化，开展了部分与半导体设备相关的销售业务，在服务集团旗下 FAB 产线设备使用需要的同时，也根据市场需求服务于其他半导体制造企业，对外销售半导体设备。报告期内，公司基于存量继续开展部分半导体设备业务。

（二）经营模式

公司 MEMS 纯代工业务以成熟商业化运营的 MEMS 产线为基础，以专业技术及生产团队、核心专利技术、核心工艺设备、丰富的工艺开发项目经验为条件，通过为客户开发并确定特定 MEMS 芯片的工艺及制造流程获得工艺开发收入，通过以特定 MEMS 工艺为客户批量制造不同类别的芯片晶圆获得晶圆制造收入。

公司 IC 设计服务业务是公司依托自身积累的技术实力、丰富的项目经验及定制开发能力，为芯片设计公司为主的客户提供以架构设计、工艺及 IP 选型、前端设计、物理设计、Memory 定制、IO/StdCell 定制优化为主的 IC 设计服务获得收入，此外公司在寄生参数提取 EDA 软件研发的同时向客户提供寄生参数提取与分析相关技术支持。

公司半导体设备业务是基于主要从境外采购的二手半导体设备，通过确保设备的可靠性和专业的维修保养能力获得设备销售收入。

（三）主要业绩驱动因素

随着集成电路终端应用场景多样性的不断增加，物联网生态系统的逐步发展落地，集成电路产业链分工不断细化，芯片设计复杂度较以往大幅提升，MEMS 智能传感设备应用越来越广泛，而通信计算、生物医疗、工业汽车、消费电子等终端应用领域对以 MEMS 芯片为核心的智能传感设备需求不断增加，带动着 MEMS 纯代工制造市场空间也随之增长；此外，包括但不限于 MEMS 芯片设计公司在内的众多芯片设计公司对 IC 设计服务的需求旺盛，IC 设计服务企业已成为连接芯片设计企业与制造企业的重要桥梁。

公司控股子公司赛莱克斯北京是国内领先的纯 MEMS 代工企业之一，正在持续扩大晶圆品类及客户应用领域；瑞典 Silix（2025 年 7 月出表）是全球领先的纯 MEMS 代工企业并正在境外扩充产能。报告期内，公司能够制造硅光子、微透镜、微透镜、红外、惯性、压力、气体、温湿度、微流控、谐振、滤波、硅麦、超声波、微开关等 MEMS 芯片，以及采用 MEMS 集成工艺制造的各种射频无源器件和模块。公司 MEMS 晶圆产品的终端应用涵盖通信计算、生物医疗、工业汽车、消费电子等领域。

公司控股子公司展诚科技拥有专业突出、经验丰富的 IC 设计工程师团队及 EDA 软件开发团队，向诸多全球芯片设计公司提供多样化的 IC 设计服务。报告期内，展诚科技不断提升工艺节点覆盖技术能力，拓宽服务芯片类别，延伸终端应用领域。展诚科技 IC 设计服务覆盖 90/55/40/28/22/16/14/7/5nm 等主流及先进工艺节点，服务芯片种类包括模拟芯片中的转换芯片、接口芯片、RF 芯片、时钟芯片，以及数字芯片中的处理器 CPU、控制器 MCU、数字信号处理 DSP、AI 相关芯片等，所服务的芯片终端应用也在不断延伸。

（四）报告期内集成电路业务情况

1、MEMS 纯代工业务

（1）晶圆厂基本情况

报告期内，公司在北京亦庄拥有一座已建成运营、具备规模产能的 MEMS 晶圆工厂，内含一条 8 英寸产线；2025 年 7 月公司在瑞典斯德哥尔摩的 8 英寸 MEMS 产线已出售控制权；公司在北京亦庄的 8 英寸 MEMS 封装测试产线在报告期末完成建设。北京亦庄 MEMS 量产线将继续适时有序的推动产能从当前的 1.5 万片/月向 3 万片/月产能的分阶段针对性扩充，并大力扩大晶圆类别及客户领域；此外，公司正稳步推进怀柔 MEMS 中试线的建设工作。

公司北京亦庄 MEMS 量产线的基本情况如下：

晶圆产线	产品制程	总体产能（片晶圆/年）	产能利用率	生产良率
北京 8 英寸 MEMS 产线（亦庄 MEMS 量产线）	0.25um-1um	180,000	28.99%	83.50%

注：1、亦庄 MEMS 量产线的定位属于规模量产线，产能处于持续扩充状态，已实现产能 15,000 片晶圆/月，由于产线仍处于产能爬坡阶段，面向客户需求产品的工艺开发、产品验证及批量生产需要经历一个客观的爬坡过程，虽然在本报告期涉足的产品及客户类别实现了增长，但已进入实现量产的晶圆品类仍相对较少，大部分仍处于工艺开发、产品验证或风险试产阶段。同时由于亦庄 MEMS 量产线在持续覆盖不同的 MEMS 产品，而不同 MEMS 晶圆对材料及工艺存在差异化需求，亦庄 MEMS 量产线需要根据客户要求针对性地添配设备，也将促进产能爬坡持续推进。

2、由于 MEMS 属于集成电路的特色工艺分支，考验制造厂商水平的主要因素是工艺、三维结构与功能，而不是单纯地追求细线宽线距（二维）；此外，由于 MEMS 晶圆常常是 2 个以上的晶圆键合在一起，因此上表产能数据中的单片“晶圆”数在多数情况下为复合晶圆的个数。即一个 MEMS “晶圆”所蕴含的硅（或玻璃）晶圆数相当于多个（2 个以上）普通 CMOS 晶圆，大幅增加了制造的难度和复杂性，“晶圆”生产数量的数值也少于一般集成电路行业。

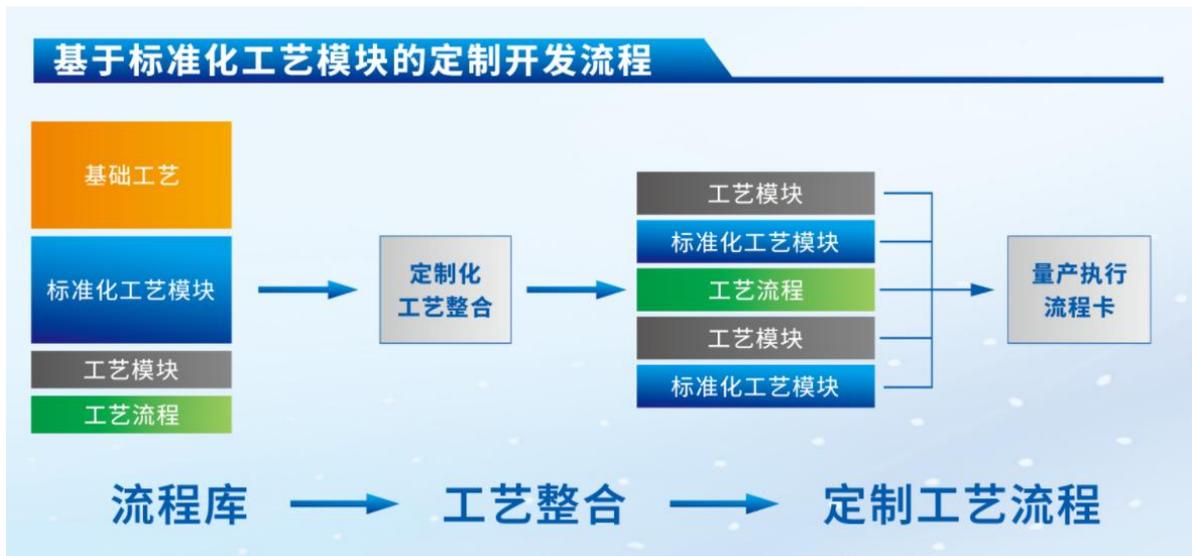
3、单片晶圆可以制造的 MEMS 芯片颗数因产品不同而存在巨大差异，平均而言每张 8 英寸晶圆可以产出大约为 6 英寸晶圆 2 倍数量的芯片，每张 12 英寸晶圆可以产出大约为 8 英寸晶圆 2.25 倍数量的芯片。

（2）特色生产工艺情况

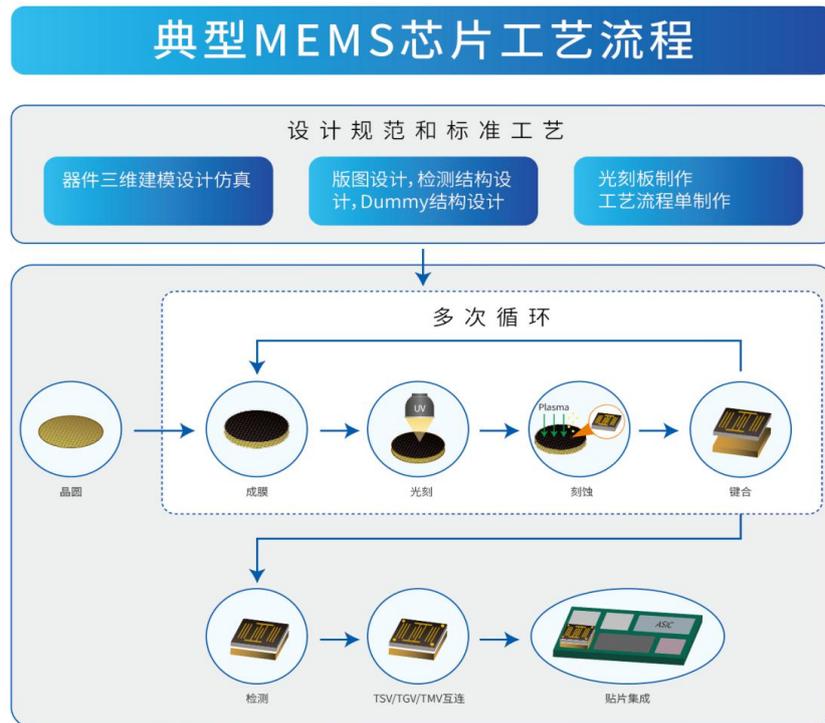
MEMS 属于集成电路行业中的特色工艺。公司 MEMS 业务经营采用“工艺开发+代工生产”的模式。“工艺开发（NRE）”模式，即 MEMS 代工厂商根据客户提供的芯片设计方案，以满足产品性能、实现产品“可生产性”以及平衡经济效益为目标，利用工艺技术储备及项目开发经验，进行产品制造工艺流程的开发，为客户提供定制的产品制造流程；“代工生产（Foundry）”模式则是 MEMS 代工厂商在完成 MEMS 产品的工艺开发，实现产品设计固化、生产流程固化后，为客户提供 MEMS 晶圆的批量代工生产服务。

MEMS 工艺开发过程示意图

结构化的工艺集成模块



图片来源：赛微电子



图片来源：赛微电子

（3）在建晶圆厂或产线情况

截至报告期末，公司亦庄 MEMS 量产线在已实现一期规模产能（1 万片/月）的同时，继续开展二期规模产能（2 万片/月）的建设，最新已实现 1.5 万片/月产能，保持产能的分阶段针对性逐步扩充；由于正筹划在自有半导体产业园区内新建 12 英寸 MEMS 产线，瑞典 Silix（2025 年 7 月已出表）维持了目前的 8 英寸 MEMS 产线产能不变；此外，公司正筹备建立怀柔 MEMS 中试线。报告期内，北京亦庄 MEMS 量产线已实现硅麦克风、BAW 滤波器、微振镜、超高频器件的量产，正在进行小批量试产气体、生物芯片、惯性加速度计、惯性测量单元（IMU）、温湿度、MEMS 硅晶振、MEMS-OCS 等 MEMS 器件，同时对于压力、硅光子、3D 硅电容、超声波换能器、喷墨打印头、磁性传感器等 MEMS 芯片、器件及模块，正积极从工艺开发向验证、试产、量产阶段推进。公司 MEMS 封装测试产线于报告期末实现通线，目前尚处于起步阶段。

2、IC 设计服务业务

报告期内，公司围绕半导体制造积极布局产业生态及相关业务，于 2025 年 9 月完成对展诚科技 56.24% 股权的收购，本次交易完成后公司合计持有展诚科技 61.00% 股权，通过本次交易公司拓展了 IC 设计服务业务，同时公司少量从事寄生参数提取 EDA 软件研发并向客户提供寄生参数提取与分析相关技术支持。

（1）服务应用情况

公司的 IC 设计服务业务区别于芯片设计公司的产品销售逻辑，并不拥有自有芯片品牌产品，亦不通过销售芯片产品实现收入，而是通过提供技术服务、解决方案或其他非芯片产品销售方式，向芯片设计公司为主的客户提供服务。

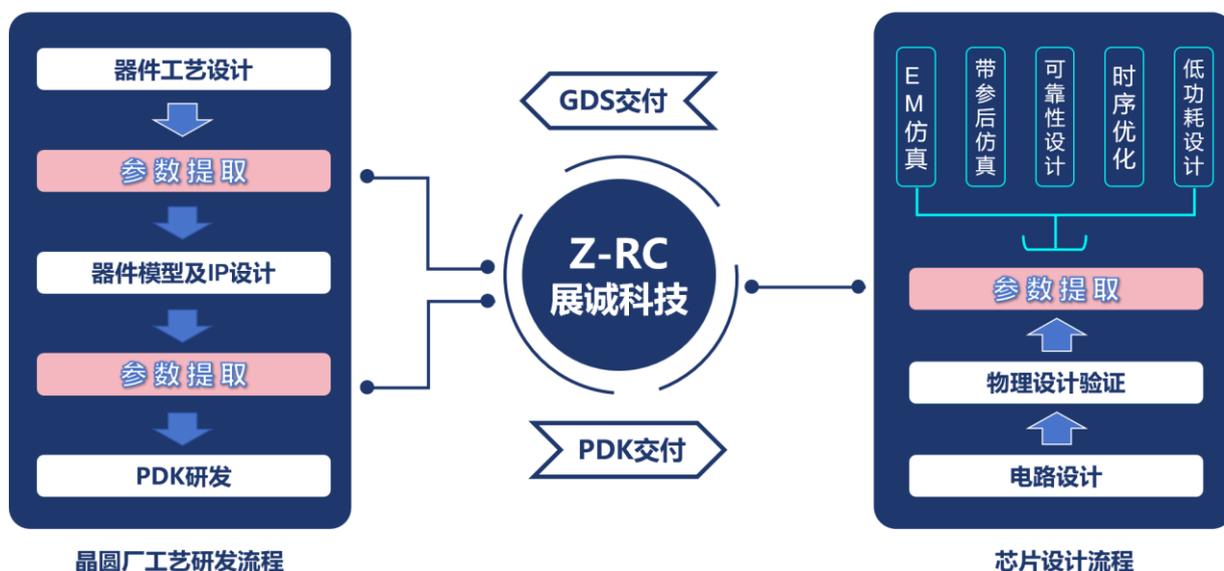
公司面向客户提供 IC 设计服务示意图



图片来源：展诚科技

此外，公司在 EDA 软件开发方面主要从事寄生参数提取 EDA 软件研发，并向客户提供寄生参数提取与分析相关技术支持。

公司 EDA 寄生参数提取流程应用示意图



图片来源：展诚科技

(2) 业务模式情况

根据协作方式、工作地点等的不同，公司通过子公司展诚科技向芯片设计公司为主的客户提供服务主要有 off-site、on-site、odc 三种模式。

展诚科技业务模式介绍				
服务模式	模式优势	重点关注	适用项目	展诚收入占比 (10-12月)
off-site 模式	灵活高效、不受地域限制、无需驻场、管理效率高。	严格项目管理和保障信息安全，确保沟通中数据保密和顺畅。	标准化程度高、交付周期要求严格、需要快速内部协同的项目。	48%

on-site 模式	深度协同、沟通效率高、响应速度快、信息安全。	总体成本管控。	数据安全要求高、客户高频沟通、项目周期长、持续迭代优化的项目。	49%
odc 模式	成本可控、团队专属化、技术与流程适配度高，核心数据与知识产权保密性好。	需要场地搭建前置性投入，高端人才供应稀缺，区域商业环境融合事宜的考量。	长期持续性需求、注重长期成本控制和数据安全的项目。	3%

（五）宏观需求分析

根据世界权威半导体市场研究机构 Yole Development 发布的《Status of the MEMS Industry 2025》，全球 MEMS 市场规模将由 2024 年的 154 亿美元增长至 2030 年的 192 亿美元，CAGR（年均复合增长率）为 3.7%。其中，2024 年 10 亿美元以上的 MEMS 细分领域包括射频器件（28.83 亿美元）、惯性测量单元 IMU（24.24 亿美元）、压力传感器（23.03 亿美元）、加速度计（14.65 亿美元）、麦克风（13.92 亿美元）、喷墨打印头（12.65 亿美元）；预计 2030 年 10 亿美元以上的 MEMS 细分领域包括惯性测量单元 IMU（30.29 亿美元）、射频器件（27.28 亿美元）、压力传感器（26.95 亿美元）、麦克风（18.26 亿美元）、加速度计（17.70 亿美元）、热辐射计（12.6 亿美元）、喷墨打印头（12.55 亿美元）。

根据 Archive Market Research's Growth 发布的《Integrated Circuit Back-end Design Service 2026-2033 Trends: Unveiling Growth Opportunities and Competitor Dynamics》，全球集成电路后端设计服务市场规模从 2020 年到 2034 年的复合年增长率预计为 3.93%，2025 年市场规模约为 524 亿美元，2031 年市场规模为约 660 亿美元。未来，随着产业政策、下游市场的持续向好，全球数据中心、智能物联网设备等领域蓬勃发展，芯片设计公司、系统厂商等对设计服务的需求不断上升，集成电路后端设计行业的市场规模有望持续扩大。

（六）国内外主要行业公司

MEMS 芯片纯代工制造处于产业链的中游，该行业根据设计环节的需求开发各类 MEMS 芯片的工艺流程并实现规模生产，兼具资金密集型、技术密集型和智力密集型的特征，对企业资金实力、研发投入、技术积累等均提出了极高要求。经历汽车电子、消费电子、物联网三次发展浪潮，MEMS 芯片纯代工制造行业已形成较为稳定的市场竞争格局，瑞典 Silix、TELEDYNE、台积电（TSMC）、X-FAB 长期保持在全球 MEMS 代工第一梯队。目前，公司控股子公司赛莱克斯北京投资建设的规模量产线“8 英寸 MEMS 国际代工线”正处于产能爬坡阶段，此外国内正在建设运营 MEMS 代工线的公司主要有芯联集成电路制造股份有限公司、广州增芯科技有限公司、上海先进半导体制造股份有限公司、无锡华润上华科技有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、安徽华鑫微纳集成电路有限公司等。

集成电路行业的飞速发展，促进了 IC 设计服务及 EDA 软件开发需求的日益旺盛。公司控股子公司展诚科技是国内较早从事 IC 设计服务及 EDA 软件开发的资深企业，此外其他从事 IC 设计服务或 EDA 软件开发的公司主要有创意电子股份有限公司、智原科技股份有限公司、灿芯半导体（上海）股份有限公司、创耀（苏州）通信科技股份有限公司、芯原微电子（上海）股份有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、上海楷伦电子股份有限公司、杭州广立微电子股份有限公司、杭州行芯科技有限公司等。

（七）发展战略及经营计划

公司的长期发展战略为：基于当前国际局势紧张及日趋复杂化的考量，对于经济全球化与国际产业链分工协作可能面临的挑战，积极拉通内部各业务板块，发挥资源及组织的协同效应，同时在境内外布局建立包括芯片纯代工制造及 IC 服务在内的业务平台，以同时满足境内外客户的不同需求，致力于形成可支持“内循环”、兼顾“双循环”的半导体服务体系；同时积极进行半导体产业投资布局，面向客户提供从 IC 设计服务及 EDA 工具、工艺开发、晶圆制造到封装测试的一站式综合服务，努力发展成一家立足本土、国际化经营的知名半导体专业服务厂商。

公司将继续落实总体发展战略及董事会制定的经营方针，以技术及市场为导向，聚焦发展半导体专业服务业务，统筹面向芯片设计公司为主要客户的各项资源及服务能力，在研发、生产、市场等方面全面加强，继续提高境内外业务平台的业务承接能力。

（八）报告期内的新产品或新工艺

公司 MEMS 主业继续投入研发，继续升级硅通孔（TSV）、晶圆键合、深反应离子刻蚀等多项工艺技术和工艺模块，继续开展压电（Piezo）、聚合物（Polymer）等新型材料的开发及应用，持续研发硅光子、微振镜、微透镜、红外、惯性、压力、气体、温湿度、微流控、谐振、滤波、硅麦、超声波、微开关等各型 MEMS 芯片的生产制造工艺，一方面为持续提高产线技术水平，满足不断新增的 MEMS 工艺开发及晶圆制造需求；另一方面基础及专项工艺技术的积累也将有利于境内外 MEMS 产线持续扩大服务产品品类、推进产能及良率爬坡。截至目前，该等材料开发及工艺开发升级活动仍在持续进行中，将随着业务规模的增长不断应用并成熟，最终将有利于加强公司在 MEMS 纯代工领域的竞争力。

报告期内，公司控股子公司展诚科技在主要从事的 IC 设计服务方面，不断优化架构设计、电路设计、寄生参数提取仿真优化、物理设计等设计服务各环节涉及的 PPA 极限优化、2.5D/3D 堆叠技术、多物理场验证、高效验证等技术。此外展诚科技还少量从事寄生参数提取 EDA 软件研发，可根据芯片物理版图和工艺信息，用算法与软件工程计算出导线、器件之间的寄生电阻、电容、电感等，并输出给仿真、时序分析使用，主要用于精确还原集成电路纳米尺寸下真实复杂的物理模型，是保证芯片制造工艺研发和芯片设计成功的关键环节。

二、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求

（一）公司所处行业的整体发展情况、行业政策及对公司的影响

1、集成电路行业的整体发展情况、行业政策

集成电路是信息处理和计算的基础，在科技革命和产业变革中发挥着关键作用。集成电路行业处于电子产业链的上游，其发展速度与全球经济增速正相关，呈现出周期性的波动趋势。2025 年集成电路行业呈现全球市场稳步复苏、AI 与先进工艺双轮驱动增长的态势。根据国际权威研究机构 Gartner 初步统计数据显示，2025 年全球半导体市场营收总额达 7,930 亿美元，同比增长 21%。其中，人工智能（AI）相关半导体（含处理器、高带宽内存 HBM 及网络组件）成为核心增长引擎，贡献了近三分之一的市场销售额；与此同时，AI 基础设施支出持续攀升，预计到 2026 年将突破 1.3 万亿美元，进一步为行业增长注入动力。

从中长期看，集成电路是一个繁荣向好的行业。近年来，国家大力支持集成电路行业创新发展。以《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》为统领，中国形成对集成电路产业发展的总体方向指引，并在此基础上出台了一系列支持集成电路产业发展的财税政策。如北京市政府在《2025 年市政府工作报告重点任务清单》中提出：大力推进集成电路、人工智能等九大专项攻关行动，着力提升共性技术供给能力，在人工智能、商业航天等领域突破一批关键核心技术。如 2023 年中央经济工作会议精神指出：“要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。完善新型举国体制，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强质量支撑和标准引领，提升产业链供应链韧性和安全水平。要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。”2025 年 7 月，工信部等七部门在《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》中提出：“创新基于光、电、磁、超声、化学的新型脑信号传感器，突破单模态信号局限，提高脑信号感知能力”等。2025 年“十五五”规划提出：“完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。突出国家战略需求，部署实施一批国家重大科技任务。加强基础研究战略性、前瞻性、体系化布局，提高基础研究投入比重，加大长期稳定支持。强化科学研究、技术开发原始创新导向，优化有利于原创性、颠覆性创新的环境，产出更多标志性原创成果。”因此，基于集成电路行业整体发展长期向好的态势以及国家的长期战略政策支持，公司业务的进一步发展将继续拥有良好的产业发展及政策支持环境。

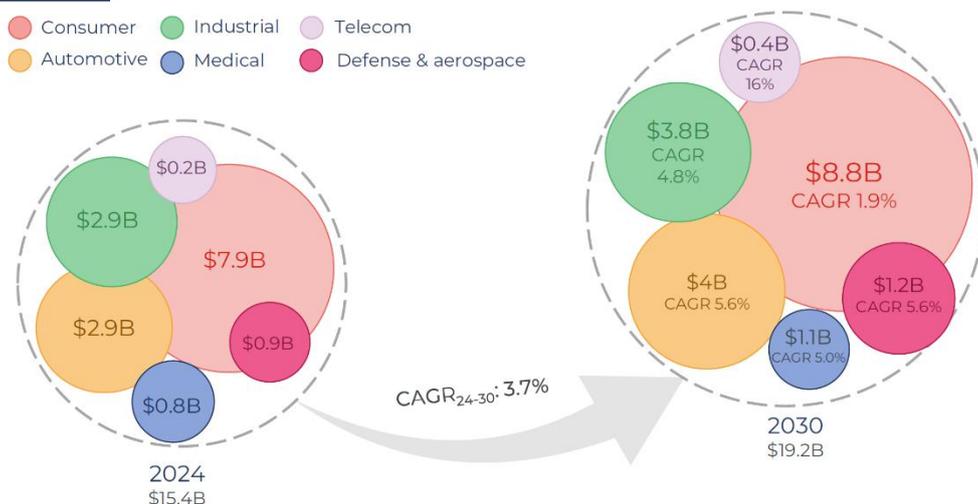
（1）MEMS 行业发展情况、行业政策

MEMS 是微电路和微机械按功能要求在芯片上的一种集成，基于光刻、腐蚀等传统半导体技术，融入超精密机械加工，并结合力学、化学、光学等学科知识和技术基础，使得一个毫米或微米级的 MEMS 具备精确而完整的机械、化学、光学等特性结构。MEMS 行业系在集成电路行业不断发展的背景下，传统集成电路无法持续地满足终端应用领域日渐变化的需求而成长起来的。随着微电子学、微机械学以及其他基础自然科学学科的相互融合，诞生了以集成电路工艺为基础，结合

体微加工等技术打造的新型芯片，而终端应用市场的扩张，使得 MEMS 应用越来越广泛，产业规模日渐扩大，成为集成电路行业一个日趋活跃的新分支。

随着万物互联与人工智能的兴起，作为集成电路细分行业的 MEMS 获得了更广阔的市场空间和业务机会。传统的传感器、执行器和无源结构器件逐步被替代，MEMS 技术的渗透率得以进一步提高。根据世界权威半导体市场研究机构 Yole Development 发布的《Status of the MEMS Industry 2025》，全球 MEMS 市场规模将由 2024 年的 154 亿美元增长至 2030 年的 192 亿美元，CAGR（年均复合增长率）为 3.7%。

MEMS MARKET FORECAST, BY END-MARKET



图片来源：Yole Development

MEMS 属于国家鼓励发展的高新技术产业和战略性新兴产业，是当前国际竞争和科技攻关的前沿热点。国家“十四五”规划纲要提出：“打造数字经济新优势，加强关键数字技术创新应用，聚焦传感器等关键领域。”与此同时，以高水平现代化生产力（新类型、新结构、高技术水平、高质量、高效率、可持续的生产力）为衡量标准，以“领域新、技术含量高，依靠创新驱动”为评判关键，MEMS 属于新质生产力的范畴，将助力推动相关产业的发展，增强产业创新能力和国际竞争力。2026 年初，国家“十五五”规划又进一步提出：“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。”“深入推进数字中国建设提升数智化发展水平。”近年来，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，从关键技术研发、产业应用等角度大力支持促进行业发展，为行业的发展提供了良好的政策环境。

集成电路及 MEMS 行业部分相关政策			
发布时间	政策名称	发布单位	主要内容
2023.1	《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	工信部等六部门	发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，集成多维度信息采集能力的高端传感器、新型 MEMS 传感器和智能传感器。
2023.1	《“机器人+”应用行动实施方案》	工信部等十七部门	推动机器人技术与 5G、云计算、智能传感等新技术融合，实现自主导航、自动避障、人机交互、语音及视觉识别、数据分析等功能。
2023.12	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	国家发改委	推动制造业高端化、智能化、绿色化。以下内容列为鼓励类技术、装备及产品： 集成电路：线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产；传感器封装（MEMS）、2.5D、3D 等一种或多种技术集成的先进封装与测试； 传感器：微纳位移传感器、柔性触觉传感器、高分辨率视觉传感器、可加密传感器等具有无线通信功能的低功耗智能传感器。
2024.1	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	工信部等七部门	突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用；加快突破 CPU 芯片、集群低时延互连网络、异构

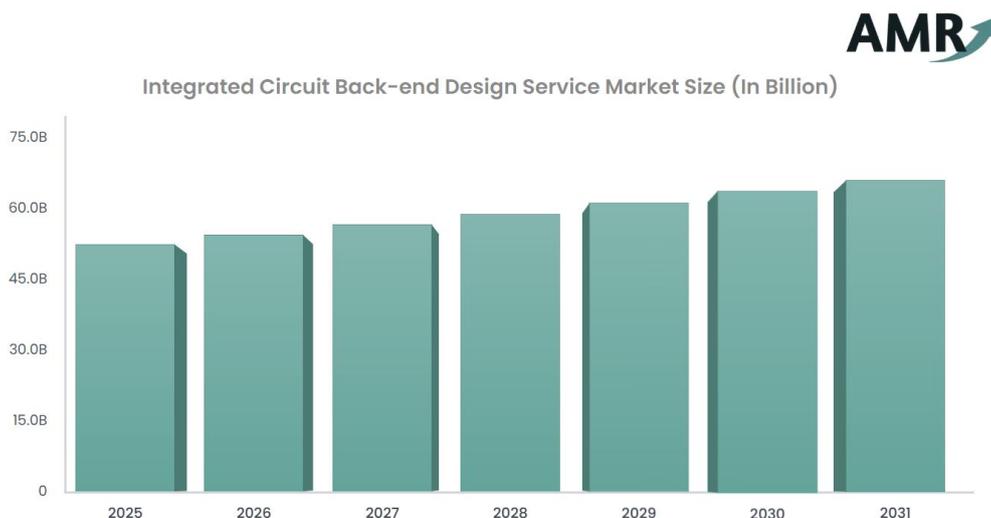
			资源管理等技术，建设超大规模智算中心，满足大模型迭代训练和应用推理需求。
2024.3	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	国务院	促进产业高端化、智能化、绿色化发展；推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造；开展汽车以旧换新；鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴；积极培育智能家居等新型消费。
2024.5	《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》	国家发改委等四部门	加快推动城市建筑、道路桥梁、园林绿地、地下管廊、水利水务、燃气热力、环境卫生等公共设施数字化改造、智能化运营，统筹部署泛在韧性的城市智能感知终端；推进城市智能基础设施与智能网联汽车协同发展。
2024.12	《关于深化养老服务改革发展的意见》	中共中央、国务院	研究设立养老服务相关国家科技重大项目，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。深化全国智慧健康养老应用示范，推广智能化家居和智慧健康产品，探索开展居家养老安全风险预警和防范服务。
2025.8	《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	国务院	为深入实施“人工智能+”行动，推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，重塑人类生产生活范式，促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革，加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态。
2025.9	《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》	工信部、市场监管总局	加强电子信息领域制造业创新中心等创新平台建设，强化行业关键共性技术供给。通过国家重点研发计划相关领域重点专项，持续支持集成电路、先进计算、未来显示、新型工业控制系统等领域科技创新。
2026.1	《关于进一步提升北京市中试服务能力促进科技创新和产业创新融合的若干措施》	北京市发改委、北京市经信局、北京市科委等	提升中试平台全链条服务能力。引导技术创新类、成果转化与产业化类创新平台拓展技术熟化、工程化放大和可靠性验证功能。鼓励平台以中试功能为基础，加快形成覆盖技术挖掘、技术熟化、产品试制、工艺创新、试验验证、检验检测、市场对接、资金筹集等功能的产业链全链条服务能力。支持市级重大中试平台、中试产线、中试零号工厂提升产品创制能力。
2026.3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》	全国人民代表大会、国务院	加强原始创新和关键核心技术攻关。坚持技术驱动和需求拉动相结合、锻长板和补短板相结合，完善新型举国体制，推动产出更多标志性原创成果。打好关键核心技术攻坚战。强化战略前沿领域科技布局。全面提升基础研究水平。 强化企业科技创新主体地位。落实企业在技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化应用中的主体地位，促进创新链产业链资金链人才链深度融合。推动创新资源向企业集聚。加强企业主导的产学研融通创新。完善促进企业创新的政策体系。

（2）IC 设计服务行业发展情况、行业政策

随着芯片集成度的不断提升，集成电路行业进入后摩尔时代，芯片性能单纯依靠制程微缩进行提升已面临瓶颈，产业发展也从早期的 IDM 一体化模式逐步走向高度专业化分工，IC 设计服务与 EDA 软件开发正是在这一产业演进过程中应运而生的。当下，芯片设计涉及前端设计及验证、逻辑综合、时序分析、物理实现、版图验证、功耗优化、可靠性设计等大量复杂环节，仅仅依靠芯片设计企业自身团队已难以覆盖全部流程，为提升设计效率、降低研发成本、缩短产品上市周期，专业化的 IC 设计服务逐步从产业链中独立出来，成为连接芯片设计与制造的关键环节和重要能力补充。与此同时，为实现芯片自动化设计、逻辑仿真、电路综合、布局布线、寄生参数提取、设计规则检查、物理验证等工作，以计算机辅助设计（CAD）为基础的电子设计自动化工具逐步发展，最终形成了 EDA 软件开发行业。

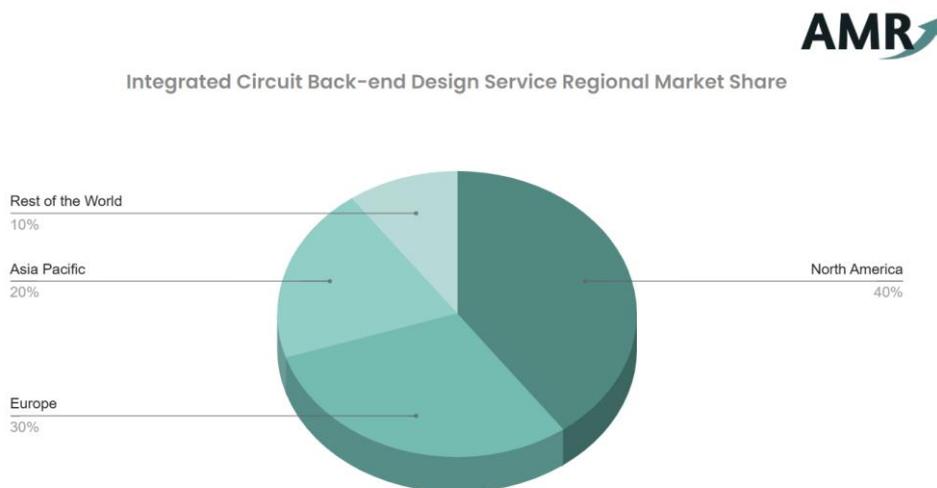
根据 Archive Market Research's Growth 数据，全球集成电路后端设计服务市场规模 2025 年市场规模约为 524 亿美元，到 2031 年市场规模将增长至约 660 亿美元。其中，亚太地区的集成电路后端设计服务市场正经历显著增长，市场份额占比约 20%。

集成电路后端设计服务市场规模（十亿美元）



图片来源：Archive Market Research's Growth

集成电路后端设计服务区域市场份额



图片来源：Archive Market Research's Growth

一直以来，在 IC 设计服务与 EDA 软件开发的先进制程和关键技术领域，国外大型 IC 设计服务企业都居于主导地位，国内企业正奋力追赶。近年来，国内发布了一系列围绕 IC 设计服务与 EDA 软件开发行业的支持政策，重点以《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》为基础，持续强化顶层设计，推动国产 IC 设计服务行业与 EDA 国产替代。随着自主可控战略深入推进、下游算力与智能终端需求持续增长，叠加全方位政策红利，IC 设计服务及 EDA 软件开发行业正处在高速发展期，未来前景广阔，国产替代空间巨大。

公司当前业务以 MEMS 纯代工为核心，并兼具 IC 设计服务及 EDA 工具服务，基于两项细分行业整体发展长期向好的态势以及国家的战略政策支持，公司业务的发展将继续拥有良好的产业空间及政策支持环境。报告期内，公司及旗下控股子公司继续获得中央及地方集成电路项目的各项政策支持，这有利于公司进一步加大相关投入，推动业务未来持续向好发展。

（二）所属细分领域主流技术水平、市场需求变化及对公司的影响

1、MEMS 纯代工

MEMS 的生产制造使用了包括体微机械加工和表面微机械加工在内的微细加工技术，并结合沉积、光刻、键合、刻蚀等集成电路工艺，在硅片上实现微型机械三维结构的构建，在保留器件机械性能的基础上大幅缩减了机械体积、降低了能耗并提高了机械可靠性，同时可批量生产，大大降低生产成本。MEMS 技术发展正受到多重因素的推动，包括成本、尺寸、性能、功率、稳定、智能及连接性。成本的降低有助于实现新应用场景，小型化的 MEMS 器件有助于系统整合，并支持增强现实（AR）等新应用的发展。在性能方面，高准确性和低噪声是关键指标，直接影响 MEMS 传感器的可靠性和效果。功率管理是确保 MEMS 技术能够持续运行的重要因素。MEMS 器件还需要对环境条件具有稳定性，能够抵抗冲击、振动、湿度、压力等环境因素。此外，传感器融合、集成数据处理（DSP）、嵌入式软件和算法、边缘 AI（包括推理和最终训练）以及多种通信接口（如 I2C、I3C、SPI、MIPI、LoRa、BLE）都是提升 MEMS 智能和连接性的关键技术。

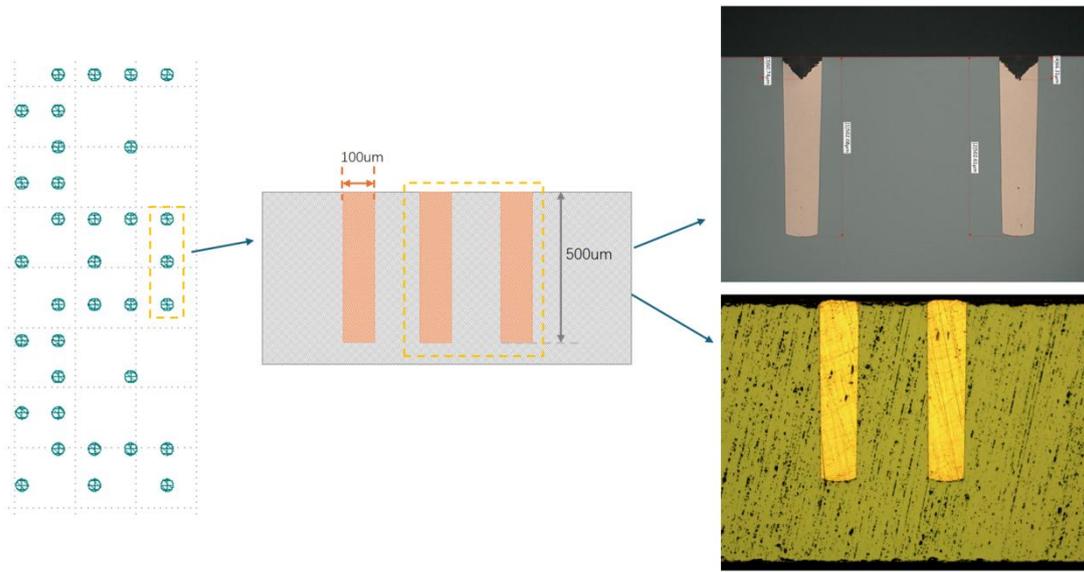
在通信计算领域，除 MEMS 光开关在传输领域的成熟应用外，数据中心及 AI 超级计算机对硅光技术的采用，促进了 MEMS-OCS（Optical Circuit Switch，光链路交换器件）的兴起，高频通信则对基于 MEMS 工艺制造的 BAW 滤波器提出了更多的应用需求；在生物医疗领域，由于试验、诊断、监测、给药设备及载体的微型化以及生物与机械之间的融合探索，MEMS 器件在医疗领域的需求持续增加；在工业汽车领域，受高端工业装备对精密传感及执行需求以及自动驾驶和高级驾驶辅助系统（ADAS）功能集成的推动，MEMS 传感器件的价值量及渗透率不断增长；在消费电子领域，随着智能手机、可穿戴设备、AR/VR/MR 等消费终端的发展，对于设备的智能化、精准化及交互性提出了丰富的需求，促进了 MEMS 传感器件的应用。整体而言，MEMS 行业拥有来源丰富、活跃变化的市场需求。

公司拥有覆盖 MEMS 领域的全面工艺技术储备，关键技术已经成熟并经过多年的生产检验，TSV、TGV、DRIE 及晶圆键合等技术模块行业领先。报告期内，公司的核心工艺及技术水平状况如下：

公司的核心工艺及技术水平状况			
核心工艺模块	对应的生产环节	效果/作用	技术水平
硅通孔技术 SilVia®TSV	芯片互连、CMOS-MEMS 集成、先进封装	在先进的三维集成电路中实现多层芯片之间的互联，能够在三维方向使得堆叠度最大而外形尺寸最小，提升芯片速度和低功耗性能。	国际领先
硅通孔金属层 MetVia®TSV			国际领先
玻璃通孔 MetVia®TGV			国际领先
深反应离子刻蚀 DRIE	刻蚀	在硅衬底上刻蚀深沟槽和深孔。	国际领先
晶圆键合 Wafer Bonding	键合与退火	将晶圆相互结合，使表面原子相互反应，产生共价键合，让其表面间的键合能达到一定强度，使晶片间无需媒介物而纯由原子键结为一体。	国际领先
DUV 光刻	光刻	最小分辨率低至 0.2 微米，对准精度小于 50 纳米。	相对领先
压电材料 Piezo material	材料应用	利用压电材料受压力作用在两端面间出现电压的特性，实现机械能和电能的互相转换。	国内领先
聚合物材料 Polymer	材料应用	聚合物增强了断裂强度、具有低杨氏模量、延长断裂时间和相对低成本，其具有惰性和生物相容的特点，适于生物和化学应用。	相对领先
磁阻材料	材料应用	利用隧道磁阻效应，实现磁场，电流的非接触量测，可应用于转速控制，编码等相关场景。	国内领先
无铅焊锡电镀 Plating solders	电镀	利用电解作用使金属或其他材料的表面附着一层金属膜，从而防止腐蚀，并提高耐磨性、导电性、反光性等。	相对领先
封帽 Capping	圆片封盖密封	形成机械结构所需的真空空间并保护晶圆避免受到机械刮伤、高温破坏。	相对领先
离子注入 Implant	硅材料改性	采用高能离子束注入硅表面一定深度，并进行退火扩散处理，使硅表面材料改性，达到器件需要的性能。	相对领先

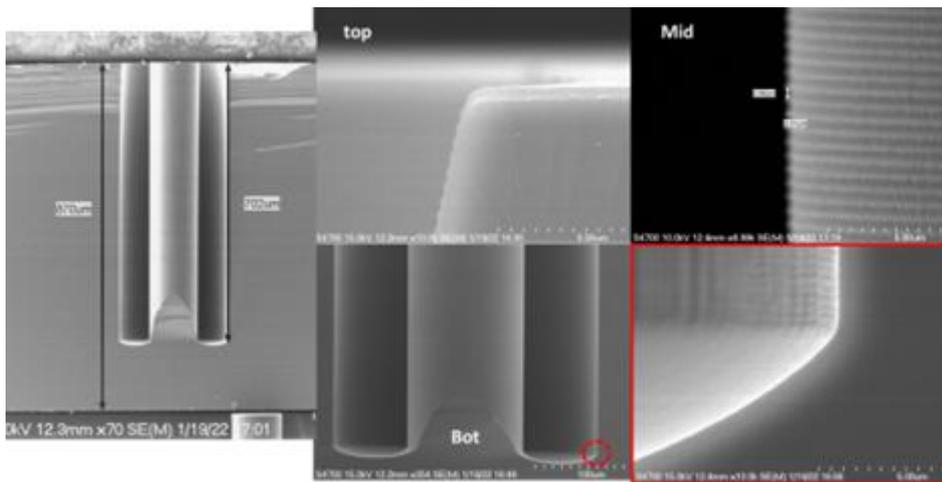
由于 MEMS 应用场景及产品种类的多样性，对 MEMS 制造工艺的需求也体现出高度的定制化与复杂性，公司掌握的硅通孔（TSV）、压电材料（PZT）、晶圆键合工艺技术举例图示如下：

硅通孔（TSV）工艺技术图示



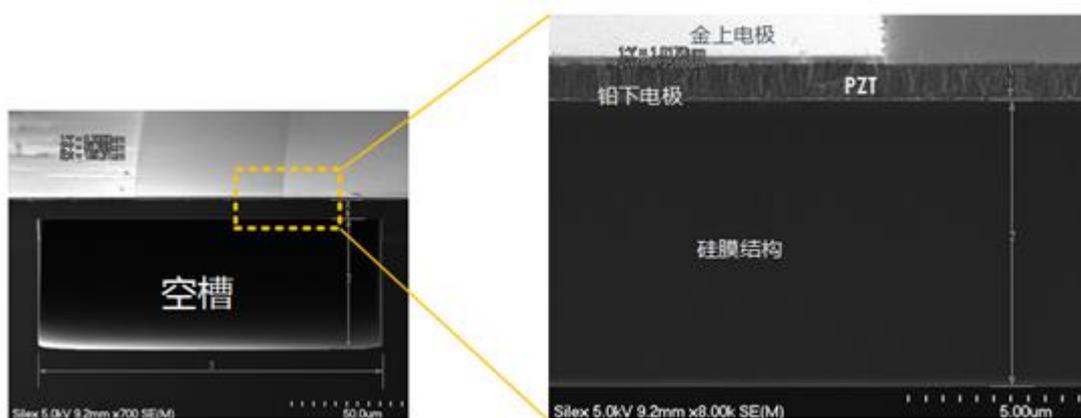
图片来源：赛微电子

厚硅晶圆 TSV 工艺技术图示



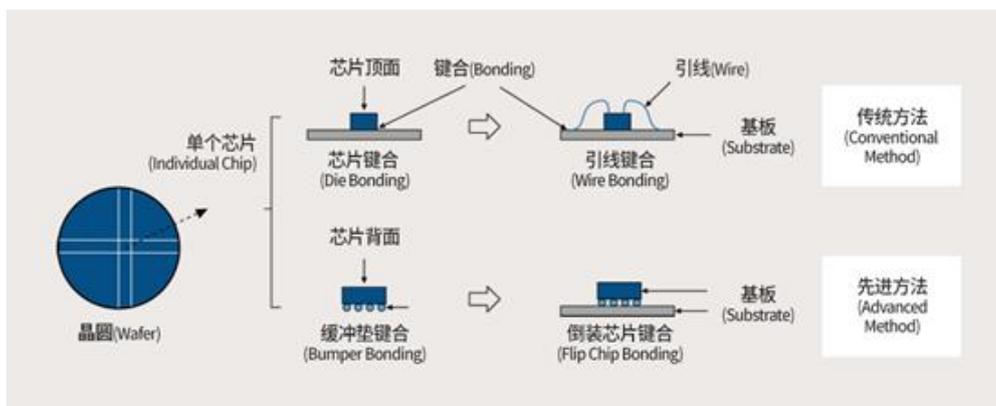
图片来源：赛微电子

压电材料（PZT）工艺技术图示



图片来源：赛微电子

键合技术图示



图片来源：赛微电子

因此，在市场需求保持中长期旺盛态势、公司代表着业内主流、领先技术水平的情况下，公司 MEMS 纯代工业务的进一步发展拥有良好的市场及竞争要素。

2、IC 设计服务

近年来，IC 设计服务主流技术围绕着“先进制程突破、异构集成落地、自动化赋能升级、多场景高效验证”四大方向进行，总体 IC 设计服务的产业角色，也从传统的物理实现工具升级为系统级优化解决方案服务商。在先进制程突破方面，随着芯片集成度持续提升，IC 设计服务已需要开始逐步适应 3nm 量产、2nm 研发的技术需求，并需要为后续更先进节点做好准备，包括 PPA（Performance 性能、Power 功耗、Area 面积）极限优化等在内的技术愈发重要。在异构集成落地方面，Chiplet（芯粒）异构集成技术、2.5D/3D 堆叠技术成为延续芯片性能增长的关键，这直接推动了 IC 设计服务与先进封装的深度融合。在自动化赋能升级方面，近年来 EDA 工具迎来 AI 赋能的革命性变革，国产 EDA 工具在 IC 设计服务成熟制程领域实现积累，积极打破国际垄断，机器学习、强化学习技术全面应用于 IC 设计服务全流程，这大幅缩短了芯片设计周期，成为 IC 设计服务效率提升的核心支撑。在多场景高效验证技术方面，随着人工智能芯片、车规芯片等高端场景需求爆发，IC 设计服务的验证要求已从传统的时序、物理验证，升级为电、热、应力、电磁等一体化的多物理场验证，以确保芯片在复杂场景下的高可靠性。

展诚科技的 IC 设计服务技术能力覆盖了 90/55/40/28/22/16/14/7/5nm 等主流及先进工艺节点，在上述主流技术方面的积累如下：

展诚科技 IC 设计服务主流技术积累情况			
技术	展诚科技技术积累	应用环节	技术水平
PPA 极限优化	自研 EDA 工具与优化流程，实现 5nm/7nm 节点 PPA 极限收敛；在性能、功耗、面积多目标平衡上形成成熟方法论；服务众多等头部客户，支撑高端芯片 PPA 最优设计。	全流程后端设计（布局布线、时序/功耗优化、物理验证、签核）。	技术能力覆盖 90/55/40/28/22/16/14/7/5nm 等主流及先进工艺节点。
2.5D/3D 堆叠技术	具备微凸点等先进互连设计能力；完成 2.5D 中介层、3D 堆叠的版图与验证方案；结合自研多物理场分析，优化堆叠结构的信号/电源/热/机械可靠性。	2.5D/3D 堆叠架构设计、互连仿真、热/应力分析、封装协同。	支撑先进封装与 Chiplet 集成的 2.5D/3D 方案落地。
多物理场验证	自研 Z-RC 寄生参数提取工具，支持高精度 RC 提取；开发多物理场（电、热、应力、电磁）协同仿真与验证流程；适配车规/航天/AI 高可靠场景验证需求。	先进工艺寄生参数提取、信号完整性、电源完整性、热/应力/EMC 分析、签核验证。	自研工具达到业内主流工具同水平，多物理场验证能力突出。
高效验证技术	构建并行化、自动化验证平台；自研验证工具与流程，提升 5nm 节点验证效率；实现物理验证、时序验证、功耗验证、多物理场验证一体化；支持大规模芯片快速签核，缩短验证周期。	全流程物理验证、时序/功耗签核、多物理场验证、量产前 sign-off。	验证效率与精度达到业内先进水平，支撑高端芯片快速交付。

未来，全球 IC 设计服务市场需求总体将依旧保持可观增长态势，但需求结构却持续发生变化。应用需求结构方面，消费电子（手机、平板、电脑等）仍是 IC 设计的基础需求，但占比逐步下降，AI 算力芯片、车规级芯片、高速通信芯片（5G-A/6G/光通信）成为核心增长引擎；技术需求结构方面，IC 设计服务需求从低端化、普适化需求向高端化、定制化需求升级转变，从 PPA 优先需求向 PPA+可靠+安全+热等多目标平衡需求转变，从通用设计需求向垂直定制需求转变。

国内集成电路产业在国产替代政策推动下，本土芯片设计企业已开始逐步崛起，这带动着配套的 IC 设计服务公司快速发展。目前，先进制程（7nm 及以下）IC 设计服务需求规模快速增长，但能提供先进制程服务的 IC 设计服务企业以国外企业居多，国内企业虽在努力进军但仍占较小份额，因此以展诚科技为代表的本土 IC 设计服务公司市场发展空间巨大。此外，尽管目前国内 EDA 市场目前仍由新思科技（Synopsys）、楷登电子（Cadence）和西门子（Siemens）等国际企业占据主导地位，但随着国家和市场对国产 EDA 行业的重视程度提升，近年来国内 EDA 企业在产业政策、产业环境、投资支持、行业需求、人才回流等方面的利好影响下获得了迅速发展，上下游协同显著增强，展诚科技的 EDA 工具服务拥有良好的国产替代机遇。

（三）公司核心技术、成本控制及竞争优势

1、MEMS 核心技术、成本控制及公司竞争优势

（1）MEMS 核心技术

MEMS 代工业务的本质是通过集成电路大规模、标准化工艺技术，实现各类传感器件的批量精密制造，同时实现器件的小体积与低功耗。作为业界领先的 MEMS 纯代工厂商，公司 MEMS 工艺开发及晶圆制造业务的主要生产技术类别及环节与其他竞争厂商相比并无重大差异，公司的竞争优势更多地体现在通过长期实践，在制造过程中集成了大量的专利技术（IP）和技术诀窍（Know-how），以及坚定保持“Pure-Foundry”商业运营模式。

MEMS 代工涉及的主要生产技术类别及环节		
主要技术	具体内容	使用的设备或技术
光刻	除去晶圆表面薄膜的特定部分，主要分为涂胶、曝光、显影、定影等步骤。	步进式光刻机、接触式光刻机。
键合	通过化学和物理作用将硅片与硅片、硅片与玻璃或其它材料紧密地结合起来的一种晶圆制造技术。硅晶圆键合往往与表面硅工艺、体硅工艺相结合，被用于 MEMS 器件的加工制造工艺中。	技术分支：直接键合（硅-硅、阳极、混合等）；间接键合（共晶、金属、glass frit 等）。 设备：晶圆级键合机。

氧化退火	氧化是在硅上形成二氧化硅；而退火提高了温度使注入的掺杂剂离子从晶格间迁移到晶格点。	技术：扩散，或晶格修复。 设备：FGA 氧化退火炉等。
沉积	采用物理和化学等方法在晶圆表面或近表面形成膜（薄膜、厚膜）。	金属溅射机、金属蒸镀机、二氧化硅/氮化硅等离子增强化学气相沉积、物理气相沉积、电镀。
干法刻蚀	干法刻蚀的刻蚀剂为等离子体，利用等离子体和表面薄膜反应，形成挥发性物质，或直接轰击薄膜表面使之被腐蚀的工艺。	深反应离子刻蚀；二氧化硅/氮化硅/多晶硅/聚酰亚胺薄膜刻蚀、螺旋波等离子体源二氧化硅刻蚀。
湿法刻蚀	通过化学刻蚀液和被刻蚀物质之间的化学反应将需被刻蚀物质剥离下来的刻蚀方法。	KOH 溶液湿法硅刻蚀、HNA 系统湿法硅刻蚀、氮化硅湿法刻蚀。
量测	对加工体（晶圆等）的电性/机械/化学/形貌/尺寸等参数进行测量，用于控制工艺参数、校调生产设备、分析失效因素和验证基本功能。	晶圆级、分立器件级探针机台、显微镜、形貌仪等。
切割	使用高速旋转的晶圆切割设备，采用磨削的方式切割晶圆，以使芯片间得以切割分离。	（自动/或手动）晶圆切割机。

MEMS 制造上连产品设计，下接产品封测，是 MEMS 产业链中必不可少的一环。MEMS 产品类别多样、应用广泛，客户定制化程度非常高，其生产采用的微加工技术强调工艺精度，属于资金、技术及智力密集型行业。与 CMOS 相比，MEMS 代工行业呈现出多品种、小批量的特点，部分品种陆续提出大批量制造需求但暂不具备显著的规律性，同时对代工厂商的工艺技术及成本控制能力提出极高要求。

（2）MEMS 成本控制及公司竞争优势

报告期内，公司在 MEMS 业务的工艺技术及成本控制方面具有如下特点：

A、形成了标准化、结构化的工艺模块

虽然 MEMS 产品的特殊性要求制造者为每种产品开发独特的工艺流程，但实践中许多工艺步骤是可为多种器件通用的。公司以最大化利用工程资源为目标，提炼出多种可重复使用的工艺制程模块。标准工艺模块作为工艺集成规划的起点，再对单个产品的关键工艺开发、调整和优化，最后对单个产品开发特殊工艺或材料。标准化的工艺模块加上调整优化后的关键工艺和特殊工艺能直接整合客户的产品，实现工艺标准化和规模量产定制化相结合。

B、丰富的项目开发及代工经验

公司在历史经营期内与下游客户开展广泛合作，代工生产了包括微镜、光开关、片上实验室、微热辐射计、振荡器、原子钟、压力传感器、加速度计、陀螺仪、硅麦克风等在内的多种 MEMS 产品。长期实践中，公司严格按照新产品导入流程（NPI）进行项目管理，在产品复杂多样的环境下做好生产工艺的开发与管理；公司团队自主开发的生产管理系统能够很好地对生产计划和制造过程进行整体控制，形成了一套行之有效的 MEMS 代工厂运营管理办法。

C、建立量产工厂的成本控制体系

随着工艺开发向量产的并行转换、公司结合量产需要，采取相应的成本控制手段，一方面根据规模量产工厂的定位要求建立成本控制体系，另一方面则是积极扩大产品范围及客户群体，通过规模效应来实现边际业务成本的降低。

2、IC 设计服务核心技术、成本控制及公司竞争优势

（1）IC 设计服务核心技术

IC 设计服务是芯片产品定义与芯片制造中间的关键环节，在芯片设计全产业链中占据不可或缺的重要地位，对提升产业效率、强化企业核心竞争力、保障产业链供应链稳定具有关键作用。公司控股子公司展诚科技在服务客户（以芯片设计企业为主）过程中提供的 IC 设计服务主要技术及环节涵盖架构设计、前端设计及验证、物理设计及验证等。

展诚科技 IC 设计服务主要技术及环节		
主要技术	具体内容	关键作用
架构设计	依据客户需求定义关键性能指标，梳理接口与互联需求，确定芯片整体架构，划分功能模块，搭建架构级性能模	架构设计：决定芯片性能、功耗和面积等。

	型，模块划分与接口定义，验证与迭代。	
前端设计及验证	前端设计主要是根据芯片规格、架构方案、接口协议、性能指标，使用 Verilog/SystemVerilog/VHDL 编写寄存器传输级代码，通过综合、DFT 和仿真，最终交付代码及设计文档。 验证主要是搭建测试环境，编写验证代码，设计测试用例，全面验证芯片的功能是否正常实现。	前端设计核心是把架构需求落地为可实现、可综合的 RTL 代码和相关模拟电路设计，做好模块设计、时钟复位规划和 DFT 支持，确保设计方案合规、高效，是芯片设计成功的基础。验证，核心是通过搭建验证环境、开展全面仿真、排查边界异常，确保芯片功能符合规格，把缺陷消灭在前端，避免后期流片风险。是芯片设计成功的关键。
物理设计及验证	根据前端设计数据，完成版图规划，开展布局、时钟树设计、单元创建和布线工作；依据电路逻辑关系用金属连线连接标准单元，结合客户工艺制程节点和具体需求完成相关工作，力争缩小芯片面积、降低功耗。验证核心工作时开展设计规则检查、电学规则检查、电路图和版图一致性检查及可靠性检查等。	芯片物理设计直接决定芯片的核心性能、长期可靠性及量产良率，关乎项目成败、成本控制和产品核心竞争力，优化芯片面积与功耗，保障芯片设计性能落地和功耗控制，是芯片从设计理念落地为可量产产品的关键环节。

与芯片设计公司相比，展诚科技所从事的 IC 设计服务更强调物理实现的专业性、工艺规则的适配性和设计结果的可制造性，在满足工艺约束的前提下，展诚科技需要依据客户需求实现芯片面积、功耗、时序的最优平衡，这对展诚科技服务的技术能力、成本管控提出了严苛要求。

(2) IC 设计服务成本控制及公司竞争优势

报告期内，展诚科技在 IC 设计服务成本控制方面形成了显著优势，具体特点如下：

A、打造一体化服务体系，精准匹配客户需求，进行高质量交付

展诚科技深耕 IC 设计服务领域，形成了全流程 IC 设计服务能力，可针对数字芯片、模拟芯片等不同类型产品，以及不同制程节点的工艺要求，为客户提供从版图规划到最终 GDS II 文件交付的一体化服务。在服务过程中，展诚科技深度融合工艺规则与设计优化，确保 IC 设计服务既符合客户的功能、性能需求，又高度适配芯片制造的工艺标准，有效保障客户芯片流片的良率与成功率，实现从逻辑设计到物理实现的无缝衔接。

B、构建标准化服务流程，结合客户定制化要求，实现服务效率提升

集成电路芯片设计的定制化需求虽然要求 IC 设计服务公司根据不同芯片的功能、工艺节点、性能指标制定个性化的设计方案，但芯片设计的部分核心环节与关键流程具备通用可复制性。展诚科技以提升服务效率、最大化利用技术资源为核心目标，提炼出覆盖全环节的标准化服务流程与模块化设计方法，将各环节的核心操作要点固化为标准模块，作为各类项目设计的基础框架。在此基础上，针对不同客户的工艺制程节点、芯片性能需求进行定制化调整与精细化优化，实现了标准化服务流程与定制化设计优化的有机结合，既大幅提升了项目开发效率，又能满足客户定制化要求，实现了服务效率提升。

C、运用丰富项目实操经验，构建成熟的项目管控体系，降低返工率

展诚科技在二十多年经营过程中与多家集成电路设计公司开展深度合作，积累了丰富的 IC 设计服务项目经验，在实际服务中完成了各类通用及定制化芯片的 IC 服务工作。基于长期丰富的项目实操，展诚科技建立了成熟的项目管理管控体系，从项目立项、需求对接、方案制定到设计实施、质量验证、成果交付，全流程进行精细化管控，从源头上尽最大可能规避 IC 设计服务错误，保障 IC 设计服务成果的准确性与合规性，大幅降低了项目返工率，提升了客户服务体验。

D、运用数字化/信息化手段，聚焦核心客户及业务，实现服务成本优化与规模效应

展诚科技围绕 IC 设计服务的全流程，积极通过数字化、信息化手段提升项目管理与设计协作，优化内部资源配置，减少了管理成本与运营成本。此外，公司凭借核心的技术服务能力与良好的行业口碑，聚焦核心客户及业务，提升客户合作粘性，减少市场开拓成本，实现了成本控制与业务发展的良性循环。

(四) 所属行业的周期性特点

集成电路行业处于电子产业链的上游，其发展受到下游终端应用的深刻影响，其行业发展速度与全球经济增速正相关，呈现出周期性的波动趋势。近年来，随着行业分工的深化，芯片设计、制造及封测各环节专业化程度显著提高，行

业整体能够更加准确的把握需求变动趋势、更有计划地控制产能规模及资本性支出、更加及时地对市场变化做出反应及修正；同时，集成电路产业在社会其他行业的渗透日益深入，终端消费群体基数庞大，一定程度上抵消了经济周期的影响，使集成电路行业整体的周期性波动日趋平滑。MEMS 纯代工、IC 设计服务行业作为基于集成电路技术演化而来的新兴子行业，其周期性与集成电路行业相似；同时由于 MEMS 技术具有替代性、前沿性、创造性，IC 设计服务也可大幅提升行业整体效率，与 MEMS 相关的技术、产品的更新和 IC 设计服务以及 EDA 软件开发的技术迭代，将为下游市场注入新的活力，并引导下游突破现有瓶颈限制、持续激发创新、拓宽终端应用范围，推动社会经济有机增长，故其行业周期性波动风险可得到有效降低。

公司 MEMS 纯代工、IC 设计服务必然受到宏观经济周期的影响，但由于终端各应用领域行业正处于快速蓬勃发展阶段，且境内企业正逐步提升自身技术进行国产替代，智能传感是推动全球经济发展的新兴力量，MEMS 更是技术变更与竞争的新兴领域，IC 设计服务亦是集成电路产业链的关键环节。因此在国产化替代、技术升级与生态构建多重驱动下的当前阶段，集成电路行业以及公司所在的 MEMS 和 IC 设计服务行业，更多受自身发展阶段的影响，受宏观经济周期的直接影响相对较小。

（五）公司所处的行业地位

MEMS 业务方面，公司控股子公司赛莱克斯北京已投入运营并持续推动产能爬坡。赛莱克斯北京是国内领先的纯 MEMS 代工企业之一，在瑞典 Sillex 控制权转让后，公司将集中资源重点发展并深化运营北京产线，随着赛莱克斯北京产能的持续爬坡，公司有望在纯 MEMS 代工领域仍保持重要地位。公司参股子公司瑞典 Sillex（2025 年 7 月出表成为公司参股子公司）是全球领先的纯 MEMS 代工企业，服务于全球各领域巨头厂商，且正在瑞典持续扩充产能。根据 Yole Development 的统计数据，2012 年至今，瑞典 Sillex 在全球 MEMS 代工厂营收排名中一直位居前五，与意法半导体（ST Microelectronics）、TELEDYNE、台积电（TSMC）、索尼（SONY）等厂商持续竞争，2019-2024 年则在全球 MEMS 纯代工厂商中位居第一。2025 年 7 月，瑞典 Sillex 的控制权转让事项已完成交割，但瑞典 Sillex 仍为公司持股 45.24% 的重要参股子公司。

IC 设计服务业务方面，公司控股子公司展诚科技是国内较早从事集成电路设计服务细分领域的头部公司，累计服务多家行业知名企业，在集成电路设计服务领域占据国内领先地位。报告期内，公司控股子公司展诚科技还在 EDA 软件开发方面主要从事寄生参数提取 EDA 软件研发，展诚科技研发的寄生参数提取 EDA 主要用于精确还原集成电路纳米尺寸下真实复杂的物理模型，是保证工艺研发和芯片设计成功的关键环节。展诚科技先后荣获国家重点集成电路设计企业、国家专精特新“重点小巨人”企业、山东省“瞪羚”企业、山东省电子信息行业优秀企业、山东省软件产业高质量发展重点项目等资质荣誉。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司持续进行技术创新和市场拓展，加大研发投入，进一步提升和扩大在 MEMS 纯代工及 IC 设计服务行业的核心竞争力，主要表现在如下方面：

（一）自主创新及研发优势

公司坚持自主创新战略，研发团队围绕 MEMS 纯代工业务、IC 设计服务业务的关键技术进行了深入系统研究，自主研发并掌握了相关工艺核心技术及相关产品的软硬件设计核心技术，不断扩大自主创新及技术研发成果。截至本报告期末，公司拥有软件著作权 122 项，专利 75 项，正在申请的专利 146 项（集成电路相关商标、软著及专利明细列表详见本节“四、主营业务分析”之“研发投入”）。凭借技术研发经验和人才优势，公司具备承担重要科研项目的能力，在 MEMS 工艺开发、晶圆制造、IC 设计服务等领域积累了丰富的研发经验。

（二）高端人才优势

公司所在的集成电路行业以及下属的 MEMS 和 IC 设计服务属于国家鼓励发展的高新技术产业及战略新兴产业，专业的技术团队以及具有丰富从业经验、对行业有深刻理解的管理层是企业可持续发展的保障。公司 MEMS 业务及 IC 设计服务业务，拥有业界一流的专家与工程师团队，其中包括多名国家特聘专家、十数名国际国内行业知名技术专家、数十名

来自著名半导体企业和高校科研院所的技术专家以及专家顾问。截至本报告期末，公司拥有博士 50 名，硕士 124 名，合计占公司总人数的 16.81%；公司研发及技术人员合计 793 名，占公司总人数的 76.62%。公司核心技术及业务团队包含诸多资深专业人士，服务公司多年且经验丰富；公司首席科学家，重要子公司 CEO、CTO 和核心产品组经理从业时间均超过 10 年。

（三）纯代工/服务模式下的多品类拓展优势

公司 MEMS 纯代工与 IC 设计服务客户均以各类芯片设计企业为主，形成了服务面向产业链设计环节的精准业务定位。在 MEMS 纯代工业务方面，公司始终坚持并严格执行专业化纯代工（Pure-Foundry）模式，不涉足自有芯片品牌的研发、设计与销售，完全聚焦于制造环节，为客户提供稳定、可靠、可规模化的 MEMS 纯代工服务；在 IC 设计服务业务方面，公司同样坚持无自有芯片品牌产品、仅提供专业服务的运营策略。

对于采用 Fabless（无晶圆厂）模式或 Fab-lite（轻晶圆厂）模式的芯片设计企业而言，与公司开展深度合作具有显著的产业价值与成本优势。一方面，设计公司无需承担晶圆厂建设、设备采购、产线运维等巨额固定资产投资，能够显著降低前期资本开支与运营风险；另一方面，公司严格恪守专业芯片纯代工和技术服务定位，建立了完善的知识产权保护机制与信息安全体系，可有效保障客户核心 IP、设计方案与关键技术不被泄露、不被滥用，让客户在技术合作与量产落地过程中具备高度安全感。综上，公司保障了合作关系的纯粹性与稳定性，在潜在客户拓展与纯代工及服务品类延伸方面具备独特的竞争优势。

（四）先进的工艺开发及晶圆制造技术优势

公司以往 MEMS 代工品类涉及 500 余项 MEMS 工艺开发经验（包含境内外产线），与下游客户开展广泛合作，代工生产了包括微镜、微针、硅光子、片上实验室、微热辐射计、振荡器、原子钟、压力传感器、加速度计、陀螺仪、硅麦克风、气体、温湿度等在内的多种 MEMS 产品。公司在长期实践制造工艺中集成了大量的专利技术（IP）和技术诀窍（Know-how），拥有覆盖 MEMS 领域的全面工艺技术储备，关键技术已经成熟并经过多年的生产检验，TSV、TGV、DRIE 及晶圆键合等技术模块行业领先。

（五）体系化的 IC 设计服务能力优势

公司控股子公司展诚科技的 IC 设计服务累计交付设计专案 5,000 余项，服务于行业知名企业，在 IC 设计服务领域占据国内领先地位，是国内较早从事 IC 设计服务细分领域的企业。通过多年的发展积累，展诚科技在 IC 设计服务领域形成了体系化的 IC 设计服务能力，服务工艺制程覆盖 90/55/40/28/22/16/14/7/5nm 等主流及先进工艺节点；服务芯片种类包括模拟芯片中的转换芯片、接口芯片、RF 芯片、时钟芯片，以及数字芯片中的处理器 CPU、控制器 MCU、数字信号处理 DSP、AI 相关芯片等，展诚科技在体系化的 IC 设计服务能力方面具备行业领先优势。

（六）良好运营管理系统和项目管控体系优势

在 MEMS 方面，长期实践中公司严格按照新产品导入流程（NPI）进行项目管理，在产品复杂多样的环境下做好生产工艺的开发与管理；公司团队自主开发的生产管理系统能够很好地对生产计划和制造过程进行整体控制，形成了一套行之有效的 MEMS 代工厂运营管理办法。在 IC 设计服务方面，展诚科技提炼出标准化服务流程与模块化设计方法，将各环节的核心操作、质量管控要点固化为标准模块，作为各类项目设计的基础框架，实现了标准化服务流程与定制化设计优化的有机结合。

（七）正在逐步建立的一体化综合服务优势

报告期内，公司围绕半导体制造积极布局产业生态及相关业务，于 2025 年 9 月完成对展诚科技 56.24% 股权的收购，本次交易完成后公司合计持有展诚科技 61.00% 股权，通过本次交易公司拓展了 IC 设计服务业务。公司目前开展 MEMS 纯代工、IC 设计服务等业务，已初步构建 MEMS 封装测试能力，并前瞻性布局集成电路寄生参数提取 EDA 软件研发。相对于 IC 产品的封装测试，MEMS 的封装测试面对的是一个需要与外界环境进行交互的器件或系统，在专用性、复杂性、保护性及可靠性等多方面存在其独特性，整体而言更为复杂且难度更高，MEMS 封装测试也因此具有更高的附加值。公司当前已具备先进封装的核心发展要素，掌握 TSV（硅通孔）等三维系统集成所必须的首要工艺，拥有目前业界领先的 TSV 绝缘层工艺和制造平台；公司拥有广泛且不断增长 MEMS 客户基础，具备拓展 MEMS 封装测试业务的技术研发实力及一定的技术、人员储备。因此，出于 MEMS 产业发展趋势以及自身发展战略需要，依托公司在 MEMS 代工制造领域的全球领先

竞争优势，公司正积极在 MEMS 产业链向下游进行延伸拓展，已初步构建 MEMS 先进封装测试能力，面向硅麦克风、压力、惯性、光学、RF、生物医疗等 MEMS 器件提供先进集成封装、测试服务，在市场需求增长的背景下，充分利用业务间的高度相关性与紧密性，逐步建立从 IC 设计服务及 EDA 工具、工艺开发、晶圆制造再到封装测试的一体化服务能力。

（八）专业资质优势

由于性能及工艺的独特性，MEMS 产品的工艺开发周期较长，视产品结构、技术要求及材料应用的不同，开发期间从数月至数年不等，期间代工厂商需要与客户持续交互反馈，客户的粘性及厂商转换成本均非常高，公司 MEMS 纯代工业务主要服务于各领域知名客户及中小创新企业，公司 MEMS 产线正在结合业务需要保持各项管理体系的认证，包括 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO27001、IATF16949、QC080000 等。此外，公司 IC 设计服务业务客户对服务专业技术能力、体系管理能力要求较高，公司控股子公司展诚科技具有完备的 ISO 管理体系（ISO9001、ISO27001、ISO45001），获得软件 CMMI3 级认证。

（九）优质客户资源优势

公司 MEMS 产品覆盖了通信计算、生物医疗、工业汽车、消费电子等诸多领域，公司作为同时具备先进工艺开发能力的纯 MEMS 代工企业，在服务各领域头部企业的同时，一直耐心陪伴众多创业型团队或公司，并且通过多年的相互紧密协作，不断有各领域的新兴公司陆续从工艺开发阶段向批量生产甚至规模量产阶段切换，且受益于全球 MEMS 应用的持续增长，该等细分领域客户的发展往往具有爆发性，能够为公司 MEMS 业务的持续发展提供巨大的发展潜力。公司 MEMS 服务的客户包括硅光子、激光雷达、运动捕捉、光刻机、DNA/RNA 测序、高频通信、AI 计算、ICT、红外热成像、计算机网络及系统、社交网络、新型医疗设备厂商以及通信计算、生物医疗、工业汽车和消费电子各细分行业的领先企业。公司控股子公司展诚科技开展 IC 设计服务业务，累计服务华为海思、台积电（TSMC）、海光半导体、中芯国际等行业知名企业超 300 家，在行业内形成了良好的口碑和品牌知名度，不断巩固和强化了行业大客户的核心供应商地位。

（十）全球化布局运营能力优势

公司 MEMS 纯代工及 IC 设计服务业务具备突出的全球化布局运营能力优势。公司 MEMS 纯代工业务拥有深厚发展底蕴，具备先进的纯 MEMS 代工工艺及正在扩张的代工产能，在 2019-2024 年全球 MEMS 纯代工厂商排名中公司参股子公司瑞典 Sillex（2025 年 7 月出表成为公司参股子公司）均位居第一，公司控股子公司北京亦庄 MEMS 量产线在中国 MEMS 纯代工厂商中亦处于第一梯队。公司自 2016 年收购瑞典 Sillex 至 2025 年 7 月完成控制权出售，累计持有、运营、管理瑞典 Sillex 近十年，本起跨境产业并购实现了多方共赢，一方面瑞典 Sillex 实现了优异发展，公司也通过该次国际并购取得了良好的财务收益回报；另一方面，该次国际并购成功助力公司实现战略转型并通过长期奋斗有力地推动了国内 MEMS 产业的自主发展。此外，IC 设计服务业务方面，公司积极搭建境外运营分支机构，提升了全球化布局运营能力。

（十一）境内外业务“双循环”体系优势

MEMS 属于集成电路行业中的特色工艺，公司 MEMS 业务经营采用“工艺开发+晶圆制造”的模式。由于近年来国际局势紧张及日趋复杂化，经济全球化与国际产业链分工协作面临挑战，2021 年 10 月公司瑞典子公司向公司中国子公司提供 MEMS 生产制造技术支持的许可申请被瑞典战略产品检验局（the Swedish Inspectorate of Strategic Products，简称为 ISP）否决。虽然公司当前 MEMS 业务仍面向全球市场，但为应对未来可能的不利挑战，公司正继续尝试同时在境内外布局兼具“工艺开发”与“晶圆制造”功能的代工服务体系。

在中国境外，瑞典 Sillex 基于成熟的中试线，积极扩充产线，继续推动当地升级改造完成后产能的逐步磨合，并收购了产线所在的半导体产业园区，其自身的 MEMS 工艺开发及晶圆制造业务的产能保障能力均得到加强，在 2025 年 7 月出表之后瑞典 Sillex 仍有望成为公司促进 MEMS 业务整体发展的一个协作支点。在中国境内，依托于已建成并持续扩充产能的北京亦庄 MEMS 量产线，规划在中国境内继续建设独立自主、面向现实及未来需求的 MEMS 中试线，通过提供工艺开发及小批量代工服务，为境内外 MEMS 规模量产线储备并导入相应的客户及产品，最终同时提高境内外外的工艺开发及规模量产能力。

四、主营业务分析

1、概述

（一）整体经营情况概述

报告期内，公司继续聚焦发展主营业务 MEMS（微机电系统），并持续为下一步的产能扩充及爬坡做好准备；同时根据公司发展战略，延伸并购展诚科技，布局 IC 设计服务。

对于北京亦庄 MEMS 量产线，报告期内继续处于产能爬坡阶段，具有导入属性的工艺开发业务继续开展，带动着公司从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆产品类别持续增加。但由于部分原有量产客户订单在报告期内因下游市场需求变化产生较大波动，北京亦庄 MEMS 量产线的收入出现下滑。此外，北京亦庄 MEMS 量产线研发投入依然保持较高强度，运营支出存在刚性，叠加折旧摊销等因素，亏损较上年扩大。

对于瑞典 MEMS 产线（2025 年 7 月出表成为公司参股子公司），报告期内订单、生产与销售状况良好（尤其是 MEMS-OCS 晶圆的生产销售在本报告期实现大幅增长），继续实现了整体业务增长，保持了良好的盈利能力。

近年来，国际地缘政治环境发生深刻变化，同时半导体产业在全球地缘政治博弈中的战略地位日益凸显，经济全球化与国际产业链分工协作面临挑战。由于国际局势的日趋紧张及复杂化，瑞典 Sillex 面临的不确定性因素显著增加。若公司继续维持对瑞典 Sillex 的控股地位，其业务运营与发展面临的地缘政治相关风险及不确定性可能上升，包括但不限于其与关键客户及供应商伙伴持续稳定合作的潜在挑战，以及由此可能导致的瑞典 Sillex 经营风险和价值受损风险。为审慎应对复杂多变的国际形势，最大程度缓解地缘政治环境变化带来的系统性风险，切实维护上市公司及全体股东的长远利益，经公司慎重研究，决定出售瑞典 Sillex 控制权，同时保留部分少数股权，继续享有瑞典 Sillex 业务增长收益、保持境内外协作沟通纽带，并为海外业务运营创造更具韧性的发展条件。本次重大资产出售已于 2025 年 7 月完成交割，瑞典 Sillex 从公司的全资子公司转变成为公司的重要参股子公司。

2025 年 9 月，公司完成对展诚科技 56.24% 股权的收购。本次交易完成后公司合计持有展诚科技 61.00% 股权，展诚科技成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。报告期内，展诚科技 IC 设计服务保持良性发展，实现盈利。

报告期内，公司及相关子公司基于存量设备仍适度开展半导体设备业务，贡献了一定的营业收入，但由于缺乏上年的大客户销售，且国内半导体设备市场竞争加剧，公司 2025 年半导体设备业务较上年大幅下降了 82.69%。

与此同时，报告期内公司管理费用大幅增长，主要系确认瑞典 Sillex 因控制权出让交易触发的大额股权激励费用，剔除该因素影响后，管理费用较上年小幅增加；财务费用上升，主要系因报告期汇兑损失较上年同期增加；销售费用略有下降；资产减值损失大幅增加；研发费用略有下降但继续处于较高投入水平。

报告期内，公司实现营业收入 82,410.59 万元，较上年下降 31.59%；实现营业利润 138,017.82 万元，较上年大幅增长 642.79%；实现利润总额 138,010.57 万元，较上年大幅增长 642.78%；实现净利润 138,843.48 万元，较上年大幅增长 643.94%；归属于上市公司股东的净利润 147,345.41 万元，较上年大幅增长 966.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,195.01 万元，较上年大幅下降 79.30%。

报告期内，公司基本每股收益 2.0123 元，较上年大幅增长 966.62%；加权平均净资产收益率 25.27%，较上年优化 28.64%（绝对数值变动），主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润较上年大幅增长 966.77%。

本报告期末，公司总资产 893,942.24 万元，较期初上升 27.50%；归属于上市公司股东的所有者权益 673,438.65 万元，股本 732,213,134.00 元，归属于上市公司股东的每股净资产 9.20 元，较期初上升 36.90%。

报告期内，公司 2025 年 7 月完成对原全资子公司瑞典 Sillex 控制权的出售，本次股权交易完成后，瑞典 Sillex 由公司全资子公司转变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，由此产生的非经常性损益对本报告期归属于上市公司股东的净利润产生重大影响；上述股权交易是公司营业收入下降、归属于上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因。报告期内，非经常性损益对公司当期归母净利润的影响为 181,540.42 万元（主要影响因素为瑞典 Sillex 控制权的出售），上年同期非经常性损益对当期净利润的影响为 2,072.18 万元（主要影响因素为政府补助）。

（二）主要业务情况

1、MEMS 纯代工业务发展情况

报告期内，公司 MEMS 业务收入下降，主要系公司 2025 年 7 月完成对原全资子公司瑞典 Sillex 控制权的出售，本次股权交易完成后，瑞典 Sillex 由公司全资子公司转变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围；另一方面公司北京亦庄 MEMS 量产线的产能爬坡持续推进，除继续开展具有导入属性的工艺开发业务外，从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆代工品类持续增加，报告期内北京亦庄 MEMS 量产线工厂实现 MEMS 硅晶振及 OCS（Optical Circuit Switch 的缩写，即光链路交换器件）从工艺开发到小批量试生产的推进，但由于部分原有量产客户订单在报告期内因下游市场需求变化产生较大波动，北京亦庄 MEMS 量产线工厂的收入出现下滑。

报告期内，公司 MEMS 业务实现收入 68,409.97 万元，较上年下降 31.46%；其中，MEMS 晶圆制造实现收入 39,373.85 万元，较上年同期下降 39.98%，MEMS 工艺开发实现收入 29,036.12 万元，较上年同期下降 15.09%，上述变化的主要原因是：瑞典 Sillex 2025 年 7 月由公司全资子公司转变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。与此同时，由于北京亦庄 MEMS 量产线仍处于产能爬坡阶段，营收规模体量以及量产产品类别仍相对较少，部分原有量产客户订单在报告期内因下游市场需求变化产生较大波动，北京亦庄 MEMS 量产线工厂的收入出现下滑，但持续累积各领域客户及晶圆产品类别。

报告期内，公司 MEMS 业务的综合毛利率为 37.86%，较上年同期上升 2.37%；其中 MEMS 晶圆制造毛利率为 34.50%，较上年同期基本持平，MEMS 工艺开发毛利率为 42.41%，较上年同期上升 2.51%，上述变化的主要原因是：对于 MEMS 晶圆制造，随着 MEMS 晶圆制造业务的逐步稳定发展，原材料、人工、制造费用等形成的成本结构日趋稳定，毛利率水平趋于稳定，未来需进一步释放规模效应；对于 MEMS 工艺开发，2025 年产品结构较上年同期有所变化，同时公司采取了有效的成本控制手段，毛利率较上年同期有所上升。整体而言，瑞典 MEMS 产线（2025 年 7 月出表成为公司参股子公司）的毛利率继续保持了较高水平，北京亦庄 MEMS 量产线仍处于产能爬坡阶段，其 MEMS 业务的综合毛利率较上年同期略有提升，公司 MEMS 业务最终在整体上保持了较好的毛利率水平。

报告期内，得益于 MEMS 应用市场的高景气度，并基于持续扩充的产线产能，公司积极开拓全球市场，并积极承接 MEMS 工艺开发及晶圆制造订单，持续服务于包括硅光子、激光雷达、运动捕捉、光刻机、DNA/RNA 测序、高频通信、AI 计算、ICT、红外热成像、计算机网络及系统、社交网络、新型医疗设备等厂商以及通信计算、生物医疗、工业汽车和消费电子等各细分领域的领先企业。

报告期内，公司瑞典 MEMS 产线升级改造完成后的产能逐步磨合且基于此前已收购的半导体产业园区，其自身的 MEMS 工艺开发及晶圆制造业务的产能保障能力均得到加强；公司北京亦庄 MEMS 量产线持续扩大覆盖不同的产品及客户，积极推进产能及良率爬坡，并适时逐步扩充产能。公司虽已于 2025 年 7 月完成瑞典 Sillex 控制权出售的交割，但随着北京产线整体运营状态的持续提升，以及公司正在推进的怀柔 MEMS 中试线布局，公司仍拥有不同定位的合格产能，不同产线在产能、市场等方面可以实现协同互补，公司有望在纯 MEMS 代工领域仍保持重要地位。

2、IC 设计服务业务发展情况

2025 年展诚科技实现营业收入 21,148.38 万元，归母净利润 2,216.41 万元，保障提升 IC 设计服务业务基本盘的同时，推进了 EDA 软件开发。报告期内，展诚科技紧抓算力及 AI 芯片发展的重要机遇期，优化自身技术，夯实绑定大客户战略，大力开发新客户，实现了技术优化升级与包括海外市场的业务开拓，并提前布局 3nm 以下技术储备与积累。同时，展诚科技积极延伸业务赛道，力争细分领域的突破，并不断打造自身在不同芯片领域从架构设计到版图验证的一站式服务能力和全方位服务体系，关注和兼容国际主流技术、工具、格式，积极捕捉商业机遇，为将来助力客户降低研发成本、缩短上市周期做好了扎实准备。报告期内展诚科技各业务模式的发展情况如下：

（1）off-site 模式发展情况

报告期内，展诚科技在 off-site 模式依托远程网络专业工具、安全远程协作体系的完善和普及，借助标准化的设计流程、跨地域的资源整合能力，在芯片设计、验证、标准化 IP 开发与验收、设计数据校验检查等项目流程中持续优化运营效率，有效降低了远程协作的沟通成本。off-site 模式是展诚科技服务众多客户、承接批量标准化需求的重要模式。

(2) on-site 模式发展情况

报告期内，展诚科技在 on-site 模式持续深化场景化适配能力，针对客户先进工艺节点芯片设计、高复杂度混合模块等对实时协同、工艺深度对接要求高的需求，进一步强化驻场团队的专业配比度，提升快速响应速度，通过与客户的无缝联动，在项目中实现了高效协作和高质量交付。on-site 模式是展诚科技 IC 设计服务业务发展的重要模式。

(3) odc 模式发展情况

报告期内，在 odc 离岸开发中心模式方面，展诚科技搭建专属化、定制化的离岸团队，推进规模化落地与精细化运营，围绕芯片设计客户的长期持续性需求，实现了团队与客户设计规范、工艺要求、工具链的深度适配，同时展诚科技通过建立远程管理体系、人才培养机制与数据安全防护体系，有效平抑了高端人才稀缺等问题，初步形成了成本优势与交付效率的双协同。

3、研发情况

报告期内，公司继续重视技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障。公司 MEMS 纯代工业务及 IC 设计服务业务均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，同时也需要公司进行重点、持续的研发投入。2025 年，公司共计投入研发费用 39,272.97 万元，占营业收入的 47.66%，金额在上年高基数的情况下有所下降，继续保持了较高的投入强度。具体详见本节“四、主营业务分析”之“研发投入”的相关内容。

4、投融资情况

报告期内，公司为实现产业目标、把握合作机遇、更好地服务于 MEMS 主业的发展，基于过往已有布局、根据长期发展战略继续开展投融资活动：（1）股权投资方面，根据公司业务发展战略和规划，公司进一步提高了对赛莱克斯北京的持股比例，收购了展诚科技 56.24% 股权，参与投资设立初芯微，收购芯东来部分股权，并小比例参与投资了多家半导体产业链相关公司、提升了光谷信息持股比例；（2）股权转让方面，基于地缘政治及国际局势的日趋紧张及复杂化，公司决策转让瑞典 Silex 控制权，同时保留部分少数股权；（3）产业基金方面，持续推动北京传感基金、深圳智能传感基金在智能传感领域的项目投资，继续跟踪半导体产业基金、北斗产业基金的投资与投后情况，关注赛微私募基金的运行情况；（4）融资租赁方面，赛莱克斯北京、赛积国际继续执行相关融资租赁交易；（5）银行授信及并购贷款方面，公司及子公司根据经营发展中的资金需求，积极向相关银行申请综合授信额度及并购贷款，扩大资金使用空间，降低财务资金成本。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2025 年		2024 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	824,105,934.18	100%	1,204,715,636.91	100%	-31.59%
分行业					
集成电路行业	777,903,482.66	94.39%	1,134,569,288.62	94.18%	-31.44%
其他	46,202,451.52	5.61%	70,146,348.29	5.82%	-34.13%
分产品					
MEMS 纯代工	684,099,670.59	83.01%	998,045,841.98	82.84%	-31.46%
IC 设计服务	69,730,562.41	8.46%	-	-	100.00%
半导体设备	23,625,221.25	2.87%	136,456,022.71	11.33%	-82.69%
其他	46,650,479.93	5.66%	70,213,772.22	5.83%	-33.56%
分地区					

中国境内	322,399,704.79	39.12%	490,540,766.29	40.72%	-34.28%
境外北美	277,218,229.19	33.64%	426,182,096.43	35.38%	-34.95%
境外欧洲	216,613,884.43	26.28%	264,765,033.86	21.98%	-18.19%
境外亚洲、中东及大洋洲	7,874,115.77	0.96%	23,227,740.33	1.92%	-66.10%
分销售模式					
直销	824,105,934.18	100.00%	1,204,715,636.91	100.00%	-31.59%

注：上述分行业中的集成电路行业主要包括 MEMS 纯代工、半导体设备、IC 设计服务、EDA 工具服务及封装测试等业务；分产品中的 MEMS 纯代工即为公司往期报告中的 MEMS 工艺开发及 MEMS 晶圆制造，IC 设计服务为公司控股子公司展诚科技开展的主要业务，下同。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路行业	777,903,482.66	497,029,376.92	36.11%	-31.44%	-33.98%	2.47%
分产品						
MEMS 纯代工	684,099,670.59	425,116,982.78	37.86%	-31.46%	-33.97%	2.37%
分地区						
中国境内	322,399,704.79	255,055,608.74	20.89%	-34.28%	-36.20%	2.39%
境外北美	277,218,229.19	190,231,895.02	31.38%	-34.95%	-22.06%	-11.35%
境外欧洲	216,613,884.43	73,055,948.77	66.27%	-18.19%	-40.40%	12.57%
分销售模式						
直销	824,105,934.18	531,542,520.46	35.50%	-31.59%	-32.01%	0.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路行业	1,134,569,288.62	752,902,351.05	33.64%	-5.46%	-8.62%	2.29%
分产品						
MEMS 纯代工	998,045,841.98	643,831,839.99	35.49%	16.63%	17.53%	-0.50%

变更口径的理由

公司 2025 年 9 月完成对展诚科技 56.24%股权的收购，本次交易完成后，公司合计持有展诚科技 61.00%股权，通过本次交易公司拓展了 IC 设计服务业务。为便于投资者更清楚了解公司主营业务，公司对分行业及分产品主营业务统计口径进行调整，分地区及分销售模式统计口径与上年保持一致。公司 2025 年年报中集成电路行业主要包括 MEMS 纯代工、半导体设备、IC 设计服务、EDA 工具服务及封装测试等业务，MEMS 纯代工为公司往期报告中的 MEMS 工艺开发及 MEMS 晶圆制造。同时 IC 设计服务为公司控股子公司展诚科技开展的主要业务。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☑是 ☐否

行业分类	项目	单位	2025 年	2024 年	同比增减
MEMS 纯代工	销售量	片	49,560	51,459	-3.69%
	生产量	片	54,670	58,125	-5.94%
	库存量	片	9,034	11,130	-18.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☐适用 ☑不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☑不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2025 年		2024 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集成电路行业	营业成本	497,029,376.92	93.51%	752,902,351.05	96.30%	-33.98%

说明

报告期内，MEMS 纯代工和 IC 设计服务是公司的主要业务，因此该部分主要分析其成本构成。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求

产品的产销情况

单位：元

产品名称	2025 年			2024 年			同比增减		
	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率
MEMS 纯代工	425,116,982.78	684,099,670.59	产线口径	643,831,839.99	998,045,841.98	产线口径	-33.97%	-31.46%	-
IC 设计服务	55,317,452.71	69,730,562.41	-	-	-	-	100.00%	100.00%	-

主营业务成本构成

单位：元

产品名称	成本构成	2025 年		2024 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
MEMS 纯代工	直接材料	149,979,622.99	35.28%	243,105,278.99	37.76%	-38.31%
	直接人工	138,854,430.14	32.66%	193,810,421.24	30.10%	-28.36%
	制造费用	136,282,929.65	32.06%	206,916,139.76	32.14%	-34.14%
MEMS 纯代工合计	营业成本	425,116,982.78	100.00%	643,831,839.99	100.00%	-33.97%
IC 设计服务	人工	25,243,365.22	45.63%	-	-	100.00%
	外协费	16,258,519.65	29.39%	-	-	100.00%

	材料	8,055,930.71	14.56%	-	-	100.00%
	其他	5,759,637.13	10.41%	-	-	100.00%
IC 设计服务合计	营业成本	55,317,452.71	100.00%	-	-	100.00%

同比变化 30%以上

适用 不适用

报告期内 MEMS 纯代工相关成本较上年减少，主要因公司出售瑞典 Sillex 股权，丧失对其控制权不再纳入合并报表范围；新增 IC 设计服务相关成本，主要因为公司收购展诚科技股权，取得其控制权纳入合并范围，新增 IC 设计服务业务所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、转让瑞典 Sillex 控制权

公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈北京赛微电子股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司向 Bure Equity AB、Creades AB(publ)等七名交易对方转让全资子公司瑞典 Sillex 控制权。本次交易前，瑞典 Sillex 为公司全资子公司，公司通过运通电子持有瑞典 Sillex 87.80%的股份，通过全资子公司赛莱克斯国际持有瑞典 Sillex12.20%的股份。本次交易完成后，公司通过全资子公司赛莱克斯国际、运通电子合计持有瑞典 Sillex45.24%股份，瑞典 Sillex 成为公司参股公司。

2、收购展诚科技 56.24%股权

公司于 2025 年 8 月 19 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购青岛展诚科技有限公司 56.24%股权的议案》，公司拟以 15,747.20 万元收购展诚科技 56.24%股权。本次交易前，公司全资子公司微芯科技持有展诚科技 4.76%股权，本次交易完成后，公司合计持有展诚科技 61.00%股权。2025 年 9 月，本次股权交易事项已完成工商变更登记，展诚科技成为公司控股子公司。

报告期内，公司依据业务发展而进行，但未对公司总体产生重大影响的其他合并范围变动详见“财务报告-合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

1、公司 2025 年 7 月完成对原全资子公司瑞典 Sillex 控制权的出售，本次股权交易完成后，瑞典 Sillex 由公司全资子公司转变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，由此产生的非经常性损益对本报告期归属于上市公司股东的净利润产生重大影响；上述股权交易是公司报告期内营业收入下降，归属于上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因。出售瑞典 Sillex 控制权后，公司将面临 MEMS 业务收入下降的风险，相关风险及应对措施详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望”章节中“MEMS 业务收入下降的风险”

2、公司 2025 年 9 月完成对展诚科技 56.24%股权的收购，本次交易完成后，公司合计持有展诚科技 61.00%股权，通过本次交易公司拓展了 IC 设计服务业务，同时公司少量从事寄生参数提取 EDA 软件研发并向客户提供寄生参数提取与分析相关技术支持。报告期内，展诚科技对公司业绩产生一定正向影响。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	326,071,283.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	124,719,351.77	15.13%
2	客户 2	103,290,587.60	12.53%
3	客户 3	35,861,479.17	4.35%
4	客户 4	31,686,087.58	3.84%
5	客户 5	30,513,777.68	3.70%
合计	--	326,071,283.80	39.57%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	83,061,784.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	31,288,751.21	11.74%
2	供应商 2	16,424,172.54	6.16%
3	供应商 3	12,157,429.65	4.56%
4	供应商 4	11,778,366.60	4.42%
5	供应商 5	11,413,064.24	4.28%
合计	--	83,061,784.24	31.16%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,617,804.22	29,304,870.92	-29.64%	主要因报告期出售瑞典 Sillex 股权，丧失对其控制权不再纳入合并范围。
管理费用	544,849,986.96	148,281,360.25	267.44%	主要因报告期确认瑞典 Sillex 因控制权出让交易触

				发的瑞典股权激励费用所致。
财务费用	67,113,883.48	12,008,719.43	458.88%	主要因报告期汇兑损失较上年同期增加所致。
研发费用	392,729,653.21	454,830,833.84	-13.65%	无重大变动。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
MEMS 硅麦克风制造技术	掌握硅麦克风系统制造方案，以 MEMS 工艺技术实现小体积、高性能硅麦克风的制造。	推进技术攻关与基础应用研发、推进产品器件制造。已经实现中低端产品的量产，正在开发高端产品。	提高 MEMS 硅麦克风的工艺开发及晶圆制造水平，服务并满足来自消费电子等领域客户的制造需求。	充分发挥 MEMS 硅麦克风尺寸小、性能优良、一致性高等特点，促进公司 MEMS 硅麦克风制造业务的发展。
MEMS 微压差制造技术	掌握微压差系统制造方案，以 MEMS 工艺技术实现小体积、高性能微压差产品的制造。	初步技术方案正在客户的终端产品上验证。	基于目前 fab 的工艺基础，实现微压差产品的大规模量产。	充分发挥 MEMS 微压差尺寸小、性能优良、一致性高等特点，促进公司 MEMS 微压差制造业务的发展。
MEMS 射频滤波器制造技术	掌握适用高频段的体声波（BAW）滤波器的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现小体积、高性能滤波器的制造。	继续推进基础单步工艺研发及集成工艺整合。已实现多个波段以及掺铌 BAW 滤波器的量产。2024 和 2025 年持续推进双工器、四工器等多款高端滤波器的量产。	形成 BAW 滤波器的商业化、规模化 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自国内滤波器设计厂商的本土制造需求。	继续开辟 5G 通信市场的新产品领域，促进公司 BAW 滤波器制造业务的发展。
MEMS 射频谐振器制造技术	掌握谐振器集成制造技术，以 MEMS 工艺技术实现小体积、高性能谐振器的制造。	已完成薄膜沉积工艺、薄膜刻蚀工艺研发，谐振器设计参数提取优化，器件性能达到客户需求。	形成面向谐振器的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	继续开辟 5G 通信市场的新产品领域，促进公司 MEMS 滤波器、谐振器制造业务的发展。
MEMS 微波前端模块制造技术	掌握微波前端模块的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现小体积、高性能微波前端模块的制造。	基本完成基于 MEMS 工艺的微波/毫米波器件关键制造技术优化；进一步提高了高频前端模块的晶圆级异质异构集成技术的工艺水平。能够制备较高质量的毫米波模块样品。	形成面向射频/毫米波前端器件、射频/毫米波前端模块的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备市场潜力的 6G、太赫兹通信新产品领域，促进公司在高频通信、汽车雷达 MEMS 器件制造业务的发展。
MEMS 微波功分器制造技术	掌握高频通信器件的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现小体积、高性能微波功分器的制造。	解决了基于 MEMS 技术的毫米波功分器制造工艺难点，深入优化了毫米波功分器的硅晶圆制造技术。新设计（ver4）正在流片	形成面向高频通信器件的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的 6G、太赫兹通信产品领域，促进公司高频通信器件制造业务的发展。
激光雷达 MEMS 微振镜制造技术	掌握激光雷达振镜的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现激光反射镜与电磁二维驱动器的集成，实现小型化、低成本、高精度微振镜的制造。	已实现车规级产品量产，包括多款振镜产品均进入量产阶段。目前工艺稳定，良率达到客户要求并在进一步提升中。	形成面向激光雷达振镜的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，促进公司微振镜制造业务的发展。

MEMS 气体传感器芯片制造技术	掌握气体传感器件的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现低功耗、高可靠性气体传感器的制造。	已经完成多种结构和多种气体敏感的气体传感器的研制，完成关键单步工艺及集成技术的开发。已实现多款气体传感器的风险生产。目前产品在终端客户处已经在白色家电和工业上实现了应用。	形成面向气体传感器件的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，促进公司气体传感器制造业务的发展。
MEMS 生物芯片制造技术	掌握生物芯片的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现硅衬底与玻璃衬底的兼容，实现生物微机电系统的低成本、大批量制造。	持续小批量生产中，包括多款微流控传感器。同时针对不同市场需求，持续研发新产品。	形成面向生物芯片的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，在芯片表面构建微型生物化学分析系统，实现生物基因信息的准确、快速、大量检测，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，促进公司生物芯片制造业务的发展。
MEMS 加速度计制造技术	掌握面向第三代惯性器件的低成本制造技术，解决稳定性、可量产性、可迭代性等方面的问题。	部分型号加速度计产品已实现试产，目前正在推进集成工艺整合，提高良率。同时迭代产品，针对消费级市场做新的设计开发。	提高 MEMS 惯性传感器的工艺开发及晶圆制造水平，服务并满足来自消费电子领域客户的制造需求。	有利于发挥公司原有技术积累，促进公司 MEMS 惯性传感器制造业务的发展，带动相关封装测试业务。
MEMS 惯性 IMU 制造技术	掌握面向第三代惯性器件的低成本制造技术，解决稳定性、可量产性、可迭代性等方面的问题。	完成了 FT、RE 和性能的所有验证，正在小批量生产。	提高 MEMS 惯性传感器的工艺开发及晶圆制造水平，服务并满足来自消费电子、工业汽车领域客户的制造需求。	有利于发挥公司原有技术积累，促进公司 MEMS 惯性传感器制造业务的发展，带动相关封装测试业务。
车用 MEMS 惯性传感制造技术	掌握车用惯性传感器件制备工艺，基于已有经验进一步研发车用 MEMS 惯性传感器件生产制造工艺。	单步工艺和初步验证已经完成，已经敲定量产设计。正在针对不同的需求进行流片。	提高 MEMS 惯性传感器的工艺开发及晶圆制造水平，服务并满足来自消费电子、工业汽车领域客户的制造需求。	有利于发挥公司原有技术积累，促进公司 MEMS 惯性传感器制造业务的发展。
MEMS 硅光子通信芯片制造技术	掌握硅光子芯片的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术芯片上构建高性能光子组件的集成与大规模扩展，实现硅光子芯片的标准化工艺制造。	继续推进相关技术攻关与基础应用研发。	形成面向硅光子通信芯片的 MEMS 工艺开发及 CMOS 晶圆再加工的 MEMS 制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，促进公司硅光子制造业务的发展，为公司增加新的业务增长点。
MEMS 振荡器制造技术	掌握 MEMS 硅基振荡器的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术在硅基晶圆上实现全温频率稳定的振荡器结构，以取代传统的石英振荡器。	初步全流程已经完成，已经测出基本性能，正在提高产品性能。	形成面向硅基振荡器的 MEMS 工艺研发及晶圆制造能力，服务并满足设计厂商需求，共同促进对传统石英振荡器的替代应用。	开辟时钟类产品新领域，促进公司 MEMS 振荡器制造业务的发展，为公司增加新的业务增长点，实现该类产品制造的国产替代。
MEMS 压力传感器芯片制造技术	掌握气体压力传感器件的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现高灵敏度，宽检测量程，高可靠性的压力传感器的制造。	已经完成电容式和压阻式压力传感器的研制，完成不同类型传感器的正面和背面工艺开发。	形成面向压力传感器件的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，促进公司压力传感器制造业务的发展，为公司增加新的业务增长点。
MEMS 热汽泡喷墨打印制造技术	掌握 MEMS 热汽泡喷墨打印头的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术在硅基晶圆上实现精准	完成了深刻蚀、镀膜、填充等关键工艺开发，正在全流程验证中，后续将进一步提升相关性	提高 MEMS 热汽泡喷头的工艺开发及晶圆制造水平，服务并满足来自消费电子、工业汽车领	有利于发挥公司技术积累，开拓新的 MEMS 应用领域，促进公司相应代工业务发展，为公司

	微流控结构，实现新一代喷墨打印技术的产品化。	能及可靠性。	域客户的制造需求。	增加新的业务增长点。
霍尔/磁隧穿磁性传感器制造技术	开发消费类、工业、车载霍尔/磁隧穿磁性传感器，以实现国产化的高精度的霍尔磁性传感器。	已完成全工艺流程片，且在客户端已经与 ASIC 搭配测试出优异的性能，目前正在进行重复性验证。	实现高灵敏度的 MEMS 磁性传感器的量产，服务满足工业的需求。	发挥公司原有技术积累，促进公司 MEMS 磁性传感器制造业务的发展。
8 英寸硅基 GaN 制造技术	实现大功率硅基 GaN 芯片的量产，结合目前 Fab 的基础工艺，增加部分 GaN 特色工艺	已完成所有的关键工艺和全流程的开发，全流程晶圆初步测试已达客户预期，正在针对全流程晶圆的性能部分在持续优化。	形成面向消费类和工业市场的 8 英寸硅基 GaN 芯片的量产。	开辟新的领域，促进公司硅基 GaN 业务模块的发展，实现该品类的全面发展，为公司增加新的业务增长点。
3D 电容 MEMS 器件制造技术	掌握 3D 电容 MEMS 产品的关键制造和生产技术，以 MEMS 工艺为基础实现大容量、小体积 3D 电容的制造，以取代传统的陶瓷电容。	产品全流程晶圆已经开发完成，初步达到客户预期，通过了客户的晶圆级和性能测试，正在进行可靠性验证。	服务并满足来自消费电子领域客户的制造需求，实现国产 3D 电容芯片的量产。	有利于发挥公司技术积累，开拓新的 MEMS 应用领域，促进公司相应代工业务发展，为公司增加新的业务增长点。
MEMS 光交换器件制造技术	掌握微镜阵列器件的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现高灵敏度、高可靠性的微镜阵列集成。	第一款产品已通过验证，已经进入小规模试产阶段。其余不同规格的 2 款产品全流程晶圆已经开发完成，初步达到客户预期，正处于工艺优化阶段。	形成面向微镜阵列的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，促进公司 OCS 光交换器件领域相关业务的发展。
新型 MEMS 硅光子器件制造技术	基于已有经验进一步研发针对新型硅光子器件的生产制造工艺。	已实现 MEMS-OCS 的量产，正结合不同市场的客户需求进行工艺迭代开发。	丰富 MEMS 硅光子器件工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自通信、消费电子领域设计厂商的代工需求。	进一步巩固公司在 MEMS 硅光子器件代工领域的竞争优势，促进公司相应代工业务的发展。
新型 MEMS 医学器件制造技术	基于已有经验进一步研发针对超声、压力、微针、芯片实验室等医学器件的生产制造工艺。	风险生产阶段。	丰富 MEMS 医学器件工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自生物医疗各细分领域设计厂商的代工需求。	进一步巩固公司在 MEMS 医疗器件代工领域的竞争优势，促进公司相应代工业务的发展。
新型 MEMS 红外器件制造技术	基于已有经验进一步研发针对新型红外器件的生产制造工艺。	风险生产阶段。	丰富 MEMS 红外器件工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自生物医疗、工业汽车领域设计厂商的代工需求。	进一步巩固公司在 MEMS 红外器件代工领域的竞争优势，促进公司相应代工业务的发展。
新型 MEMS 超声波换能器件制造技术	基于已有经验进一步研发针对新型超声波换能器件的生产制造工艺。	风险生产阶段。	丰富 MEMS 超声波换能器件（包括电容式 CMUT 和压电式 PMUT）工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自生物医疗、工业汽车、消费电子领域设计厂商的代工需求。	进一步巩固公司在 MEMS 超声波换能器件代工领域的竞争优势，促进公司相应代工业务的发展。
新型 MEMS 惯性器件制造技术	基于已有经验进一步研发针对新型惯性器件的生产制造工艺。	风险生产阶段。	丰富 MEMS 惯性器件（包括加速度计和陀螺仪）工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自消费电子、工业汽车领域设计厂商的代工需	进一步巩固公司在 MEMS 惯性器件代工领域的竞争优势，促进公司相应代工业务的发展。

			求。	
MEMS 气体传感器研发	验证气体传感器全链条的关键技术，开发低功耗高灵敏度的气体传感器。	进一步优化了微加热板加工工艺；继续对气敏材料在微加热板上的不同沉积方法进行试验、优化，开展相应的传感器性能测试。	完成与合作单位申请的气体传感器项目，将开发的气体传感器给应用方送样验证。	为其最终实现产业化铺垫基础，推进公司与高校对气体传感器的联合研发和成果转化。
MEMS 气体流量开关制造技术	掌握 MEMS 气体流量开关的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现低功耗、高灵敏度的气体流量开关传感器的制造。	根据腔体厚度、器件尺寸等新版设计，对器件工艺大流程进行工艺设计，参数调整，并开始制备样品晶圆。	提高 MEMS 气体流量开关的工艺开发及晶圆制造水平，服务并满足来自消费电子等领域客户的制造需求。	充分发挥 MEMS 尺寸小、性能优良、一致性高等特点，促进公司在 MEMS 气体流量开关制造业务的发展。
基于 MEMS 工艺的微型天线制造技术	基于高频微空腔传输结构技术，研发用于高频通信的微型天线/阵列天线。	在基于 MEMS 技术的微型天线电磁仿真完成、MPW 掩模版设计完成后，正在进行流片。	进一步形成面向高频通信器件的多系列 MEMS 高频微型天线；服务并满足来自设计厂商对高频微器件的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的 5G 毫米波、6G 和太赫兹通信产品领域，促进公司高频通信器件制造业务的发展，为公司增加新的业务增长点。
高性能氮化镓器件产业化应用	解决目前制约氮化镓器件在服务器、数据中心以及消费电源端产业化应用面临的技术难题。	继续在功率器件的推广应用方面推进。	建设高性能氮化镓器件制造平台，开发出具有自主知识产权的氮化镓功率器件和电源模块。	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，促进公司氮化镓器件制造业务的发展，为公司增加新的业务增长点。
持续性研发活动-MEMS 工艺研发	根据行业发展趋势及客户需求，围绕硅/金属通孔、晶圆键合及深反应离子刻蚀工艺以及压电材料、磁性材料及聚合物材料等进行研发。	聚焦于多晶圆永久键合工艺温度梯度、应力控制等。	进一步提高 MEMS 代工领域技术壁垒，巩固竞争优势，不断提高工艺开发及晶圆制造水平。	有利于公司 MEMS 业务的继续增长。
先进 MEMS 工艺设计与服务（北京市工程研究中心）	开展共性关键单点工艺技术研发、共性关键集成工艺技术研发、MEMS 晶圆级生产制造工艺技术研发，推动 6 寸 MEMS 产品中试到 8 寸 MEMS 产品量产的连贯衔接。	MEMS 器件的晶圆级剥离技术开发取得重大进展，剥离工艺流程进一步优化。在此基础上，器件的整晶圆剥离方案（2 种）已提出，并设计在 MEMS 毫米波器件的第四板设计里。	搭建先进 MEMS 工艺研发体系，打造中试公共服务中心，引进吸收国际先进 MEMS 代工技术，为国家、北京市相关重大战略任务、重点工程提供研发和试验条件，推动重大科技成果在京转化落地。	推动公司 MEMS 晶圆级生产制造工艺技术研发，提供多品种小批量 MEMS 工艺定制化服务平台，为公司增加新的业务增长点。
MEMS 器件晶圆级集成封装制造技术	开展三维多轴 MEMS 器件的晶圆级集成封装制造技术的研究，建立相应的技术创新平台，以获得大规模三维多轴（多个）异质 MEMS 器件晶圆级集成封装制造生产能力。	MEMS 器件的 3D 集成封装设计已完成。新设计改善了器件在整个晶圆的分布，结构布局、应力分布更加合理。这将利于晶圆集成工艺（特别是电镀工艺）的实施。	形成 MEMS 器件及晶圆级集成封装制造能力，服务并满足来自封装客户的制造需求。	开辟公司在 MEMS 器件及晶圆级集成封装的新业务领域，促进公司相应封装业务的发展。
MEMS 多高频器件三维晶圆级异质异构集成关键技术开发	开展 MEMS 多高频器件三维晶圆级异质异构集成关键技术（厚硅高频 TSV、晶圆级共晶永久键合等）研发，形成相关晶圆级异质异构集成的成套工艺。	完成复杂多 MEMS 高频器件异质异构集成设计。相应制造工艺流程和优化完成，正在进行验证流片。	建立公司三维 MEMS 高频器件晶圆级异质异构集成工艺平台；制备相应的集成样品晶圆。	建立 MEMS 高频器件制造平台；拓展公司 MEMS 相关技术积累，为公司 5G+、6G 和太赫兹通讯时代到来，做好相应工艺技术准备。
集成电路数字单元版图自动化设计项目研发	开发提高集成电路设计效率的集成电路数字单元版图自动化设计工	已经完成了常用数字单元的收集整理，基于这些单元实现了版图的自	针对复用性比较高的数字单元，进行版图特征的抽象提取，开发工具	有利于发挥公司的技术积累，赋能公司的集成电路后端设计服务业

	具。	动生成功能。	自动生成版图。	务，促进公司业务增长。
集成电路鳍栅及围栅器件的 RC 寄生参数提取 EDA 软件研发	掌握基于鳍栅及围栅器件的电阻电容建模方法学，实现对集成电路后端版图设计中的鳍栅器及围栅器件的寄生电阻和电容的抽取。	实现了对特定工艺下鳍栅及围栅器件的后端寄生参数提取。	完善公司的寄生参数提取 EDA 软件功能，支持更多的集成电路制造工艺。	开辟具备巨大市场潜力的集成电路 EDA 设计工具领域，促进公司 EDA 业务领域的发展。
C341B 高压降压开关控制器的研发	掌握基于高压工艺的集成电路后端设计关键技术，结合已有的设计经验，完善公司的技术储备。	实现了整个功能的完整开发，通过了最终的物理验证。	支持宽输入的电压范围，并且在此基础上有精确电压控制和快速的动态响应。	有利于发挥公司技术积累，开拓新的设计服务领域，促进公司相应业务发展。
基于先进 RDL 工艺的射频集成无源芯片设计与制备	开发亚微米级 RDL 工艺技术，实现高品质精细线路制作，设计兼容 RDL 工艺的多功能集成无源器件，满足下一代通信对小型化、低损耗射频电路的需求。	已完成亚微米 RDL 工艺金属层、介质层沉积与布线图形形成的核心技术路线论证，完成多功能集成无源器件的原理设计与仿真验证，后续研究基于三维 RDL 互连的异质集成方案预研，完成关键互连结构的可行性分析。	实现高品质亚微米 RDL 工艺设计能力，建立基于 RDL 的异质集成射频芯片封装技术研究平台。	有助于公司在先进封装与射频集成领域形成核心技术壁垒，促进业务规模与盈利能力持续增长。
集成电路模拟 IP 版图 AI 自动布局技术研发	开发基于 AI 的集成电路模拟 IP 版图自动布局技术，解决传统模拟版图设计依赖人工经验、效率低、周期长的痛点，提升模拟 IP 版图设计的自动化水平与设计效率，缩短产品研发周期。	已完成模拟版图布局规则与约束的数字化建模，搭建了基于深度学习的版图布局预测模型，可对特定模拟 IP 模块进行初步自动布局生成。	实现对特定模拟 IP 模块的 AI 自动布局生成，布局结果接近人工水平，降低人力成本，形成可复用的 AI 布局技术平台。	有助于公司在模拟集成电路设计领域建立核心技术优势，提升项目交付效率与客户满意度，增强市场竞争力与可持续发展能力。
集成电路高性能工艺库的开发	本项目针对 FinFET 和 SOI 不同的工艺节点，开发高性能的工艺库，解决国内集成电路设计领域在低功耗、高性能芯片设计中的迫切需求。	已完成特定工艺 SOI 及 FinFET 工艺节点的工艺参数采集与建模，搭建了工艺库特征化提取平台，启动 STD 标准库核心单元的电路设计与版图绘制。	完成高性能 STD 库的全流程开发与验证，库单元的关键指标达到先进主流水平，支持主流 EDA 工具。	助力公司突破先进制程工艺库核心技术壁垒，拓展先进制程设计服务市场，促进公司业务增长。
集成电路数字标准单元设计自动优化系统	开发一套提升数字电路设计性能的自动化流程，通过数据仿真、算法优化与对比分析，提升数字单元性能，达成产品性能更优、尺寸更紧凑的设计目标，增强产品竞争力。	已完成特定工艺下数字标准单元的基础数据采集与仿真建模，搭建了自动优化算法框架，实现对单元延迟、功耗、面积的多目标优化迭代。	完成一套集成电路数字标准单元设计自动优化系统，形成可复用的优化流程与工具链，可快速移植到其他工艺节点，提升数字单元设计的整体效率与性能。	有助于公司在成熟工艺平台上建立数字标准单元优化的核心技术优势，促进公司数字设计业务增长。

公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量（人）	391	376	3.99%
研发人员数量占比	37.78%	38.17%	-0.39%
研发人员学历			
本科	146	85	71.76%

硕士	80	169	-52.66%
博士及以上	48	63	-23.81%
大专及其他	117	59	98.31%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	130	88	47.73%
30~40 岁	194	162	19.75%
40~50 岁	52	71	-26.76%
50 岁以上	15	55	-72.73%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2025 年	2024 年	2023 年
研发投入金额（元）	392,729,653.21	454,830,833.84	356,656,207.29
研发投入占营业收入比例	47.66%	37.75%	27.44%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

报告期内，公司完成对瑞典 Silex 控制权的出售及对展诚科技的收购，研发人员构成发生变动。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司研发投入虽有所下降，但北京亦庄 MEMS 量产线依然保持了较高的投入强度；此外，报告期内公司完成全资子公司瑞典 Silex 控制权的出售，营业收入规模下降，综合导致报告期内研发投入总额占营业收入的比重上升。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求：

截至报告期末，公司已注册集成电路商标 14 件；累计拥有/享有集成电路软件著作权 52 项，各项集成电路专利 66 项；正在申请的集成电路专利 146 项，具体如下：

1、集成电路商标

序号	商标名称	商标注册号	核定使用商品/服务项目类别	商标有效期	所有权人
1		31817421	42	2029.05.20	赛莱克斯国际
2		31814417	42	2029.05.20	赛莱克斯国际
3	展诚	31381278	09	2029.5.20	展诚科技
4	Z-xchip	37879496	09	2029.12.20	展诚科技
5	N-chip	37895990	09	2030.3.13	展诚科技
6	Z-chip	56761236	09	2032.10.13	展诚科技
7	ZapRC	66998746	09	2033.3.6	展诚科技

8	Zcad	67010993	09	2033.2.27	展诚科技
9	Zchip	67011095	09	2033.2.27	展诚科技
10	Zealayout	67059914	09	2033.7.6	展诚科技
11	ZapeRC	81461116	42	2035.4.13	展诚科技
12	ZapeRC	81463575	09	2035.4.13	展诚科技
13	ZappeRC	81459266	09	2035.4.13	展诚科技
14	ZappeRC	81463567	42	2035.4.13	展诚科技

2、集成电路软件著作权

序号	软件著作权名称	取得方式	所有权人
1	集成电路组件版图电流信息优化系统	原始取得	展诚科技
2	集成电路芯片版图设计参数提取系统	原始取得	展诚科技
3	集成电路版图设计工艺规则验证系统	原始取得	展诚科技
4	集成电路芯片版图设计信息提取系统	原始取得	展诚科技
5	集成电路后端版图自动产生 LOGO 标示系统	原始取得	展诚科技
6	集成电路后端版图自动产生 padlist 系统	原始取得	展诚科技
7	集成电路后端版图十字标尺测距系统	原始取得	展诚科技
8	集成电路后端版图可移植工艺分析系统	原始取得	展诚科技
9	集成电路后端布局电阻设计优化系统	原始取得	展诚科技
10	集成电路后端电压信号检测分析系统	原始取得	展诚科技
11	集成电路后端元件设计工艺分析系统	原始取得	展诚科技
12	集成电路后端设计批量验证系统	原始取得	展诚科技
13	集成电路后端内部电流走向分析设计系统	原始取得	展诚科技
14	集成电路后端器件自动标示系统	原始取得	展诚科技
15	集成电路后端内部对称电路设计系统	原始取得	展诚科技
16	集成电路版图图形面积提取系统	原始取得	展诚科技
17	集成电路版图图形周长提取系统	原始取得	展诚科技
18	集成电路 CMOS 工艺文件移植系统	原始取得	展诚科技
19	集成电路失效检测及模拟仿真软件	原始取得	展诚科技
20	展诚集成电路阵列设计系统	原始取得	展诚科技
21	展诚集成电路测试优化软件	原始取得	展诚科技
22	展诚集成电路工艺格点验证及复位系统 V1.0	原始取得	展诚科技
23	展诚集成电路批量处理多通道线路系统 V1.0	原始取得	展诚科技
24	展诚集成电路区域密度修复系统 V1.0	原始取得	展诚科技
25	集成电路自动更改 ESD 参数与 layers 系统	原始取得	展诚科技
26	集成电路版图冗余金属高效处理系统 V1.0	原始取得	展诚科技
27	集成电路版图 label 格点检查系统 V1.0	原始取得	展诚科技
28	集成电路器件信息可视化显示系统 V1.0	原始取得	展诚科技
29	集成电路后端触发器版图自动生成系统 V1.0	原始取得	展诚科技

30	集成电路版图单元智能随机排列系统 V1.0	原始取得	展诚科技
31	集成电路寄生参数提取系统 V1.0	原始取得	展诚科技
32	Z-RC 寄生参数提取软件 V1.2	原始取得	展诚科技
33	Z-Layout 集成电路物理设计自动化软件 V1.0	原始取得	展诚科技
34	芯诚集成电路区域 layer 密度测量系统	原始取得	展诚科技
35	芯诚集成电路 path 线批量切除系统	原始取得	展诚科技
36	集成电路后端版图 path 走线自动连接系统	原始取得	展诚科技
37	DRC 比较分析系统	原始取得	展诚科技
38	半导体物理知识智能考评系统	原始取得	展诚科技
39	电路模块信息记录系统软件	原始取得	展诚科技
40	电容抽取的回归测试系统	原始取得	展诚科技
41	电阻抽取的回归测试系统	原始取得	展诚科技
42	基于网页的学习测试系统	原始取得	展诚科技
43	基于知识图谱的习题智能推送系统	原始取得	展诚科技
44	晶体管多晶硅的电阻网络计算系统	原始取得	展诚科技
45	客户需求寄存器表自动检查系统	原始取得	展诚科技
46	宁芯微测试系统	原始取得	展诚科技
47	宁芯微基于 ICC 平台的 TIO 检测工具软件	原始取得	展诚科技
48	宁芯微接口控制器系统	原始取得	展诚科技
49	宁芯微数字仿真系统	原始取得	展诚科技
50	宁芯微数字设计系统软件	原始取得	展诚科技
51	通讯配置信息系统软件	原始取得	展诚科技
52	自动比较不同系统电容电阻抽取差异系统	原始取得	展诚科技

3、集成电路专利

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	专利权人	注册国家/地区
1	一种在 MEMS 结构中制造金属引脚垫的方法	2018104905190	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
2	一种接触窗的形成方法	2018104890301	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
3	一种空气芯微同轴传输线的制造方法及生物传感器	2021114533425	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
4	一种电镀设备以及电镀生产线	2021112772991	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
5	用于 TSV 微孔电沉积铜填充工艺的添加剂和电解液	2021108381247	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
6	一种微同轴工艺误差的补偿方法及微同轴	2021111985755	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
7	微同轴传输结构及其制备方法、电子设备	2021111995422	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
8	微同轴传输结构及其制备方法、电子设备	2021111995598	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
9	高频传输微结构的平坦化方法、装置及电子设备	2022108110057	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国

10	抛光垫修整器、化学机械抛光装置和方法	202210412559X	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
11	一种谐振器的调频方法	2021107896960	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
12	一种微机电毫米波天线	202210546500X	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
13	一种微同轴传输线的阻抗匹配结构	2022105635424	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
14	振膜、MEMS 麦克风及 MEMS 传感器	2023218772896	实用新型	原始取得	赛莱克斯北京	中国
15	一种薄膜体声波谐振器和高频射频器件	2021107800934	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
16	一种晶圆电镀回液管及晶圆电镀设备	2022106416509	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
17	一种晶圆传送装置和电镀系统	2022106416922	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
18	一种图形化方法	2024102524842	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
19	一种 MEMS 微同轴功分器	2022105604356	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
20	一种三维晶圆集成结构及其制备方法、电子设备	2020113927529	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
21	一种薄膜体声波谐振器及其制备方法	202011402902X	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
22	一种高频器件集成模块和模组	2021107889878	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
23	一种晶圆运输机械手	2021112772900	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
24	一种晶圆临时键合方法及解键合方法	2022105229967	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
25	一种晶圆电容的制作方法、晶圆电容及电子设备	2020114024346	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
26	一种微系统薄膜平坦化方法	202210411851X	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
27	一种基于光刻胶的金属薄膜沉积方法及相关设备	2022116044697	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
28	一种半导体器件的制备方法及半导体器件	2022106178229	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
29	一种微同轴及其制备方法	2021115132906	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
30	一种微系统薄膜平坦化方法	2022104118505	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
31	一种射频模块、制作方法及电子设备	2021114476051	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
32	一种射频模组及射频器件	2021114532831	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
33	一种新型射频模块、制作方法及电子设备	2021114476155	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
34	一种半导体器件器件及制作方法	2021111838440	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
35	一种半导体器件的制造方法	2021111984517	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
36	芯片 ID 版图的确定方法、装置、设备及存储介质	2024116985238	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
37	导电结构制备方法、导电结构及微机电系统	2024119436302	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
38	一种氮化镓充电座	2022100435722	发明专利	原始取得	海创微芯	中国
39	一种散热氮化镓充电座	2022100729321	发明专利	原始取得	海创微芯	中国
40	一种晶圆的键合方法	2022106178125	发明专利	原始取得	海创微芯	中国
41	厚胶光刻方法及微结构器件	2022107732486	发明专利	原始取得	海创微芯	中国
42	一种制作带有沟道或空腔的半导体结构的方法	2018104905129	发明专利	受让取得	赛微电子	中国

43	一种 MEMS 气体传感器及制作方法	2021108199668	发明专利	受让取得	赛微电子	中国
44	一种微机电器件制备方法及装置	2018113569288	发明专利	受让取得	赛微电子	中国
45	用于单斜 ADC 的高线性度电压-时间转换方法及转换器	201510690775	发明专利	受让取得	展诚科技	中国
46	带失调消除的动态范围增强型读出方法及电路	201510695430	发明专利	受让取得	展诚科技	中国
47	基于矩匹配的 TDI-CMOS 图像传感器 FPN 校正方法	201610910923X	发明专利	受让取得	展诚科技	中国
48	用于 AER 前馈分类系统的脉冲神经元硬件架构	201611190874	发明专利	受让取得	展诚科技	中国
49	用于延迟锁相环的单端负反馈电荷泵	201710750618	发明专利	受让取得	展诚科技	中国
50	一种集成电路对准精度测试装置	202121958547	实用新型	原始取得	展诚科技	中国
51	一种半导体集成电路测试装置	202121959107	实用新型	原始取得	展诚科技	中国
52	集成电路 FinFET 复杂三维结构描述文件的生成方法和系统	202210010289	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
53	基于并行算法的集成电路电阻抽取方法	202210618094	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
54	随机行走在电容抽取中的细粒度的并行处理方法	202311108381	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
55	一种寄生参数压缩提取系统及方法	202311206468	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
56	一种基于 OPC 的图像边缘优化方法	202311214534	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
57	一种集成电路版图图形切割方法	202311322557	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
58	用于集成电路的螺旋电感自动生成方法	202311322557	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
59	一种基于 Mini-batch 梯度下降法的 3D 寄生参数的优化方法	202311322560	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
60	基于 nfs 协议实现集成电路设计的多路同步共享数据系统	202311401883	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
61	一种优化收敛 EDA 工具寄生参数提取及多场景仿真方法	202410338973	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
62	基于电气规则检测实现定位集成电路设计缺陷的方法	2024108705714	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
63	一种人工智能寄生参数分析和自动优化方法	2024108649413	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
64	基于共享器件的集成电路高效设计方法	2024108704425	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
65	基于 RDL 工艺的射频电阻器校准结构及制造方法	202510779406	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
66	基于大数据与数理统计的多情况电容决策因子处理方法	2025109187543	发明专利	原始取得	展诚科技	中国

4、集成电路专利（正在申请）

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日期	取得方式	专利权人	申请注册国家/地区
1	一种射频模组芯片的集成方法	2022106384207	发明专利	2022/6/7	原始取得	赛莱克斯北京	中国
2	气体传感器及其气敏膜	202011392870X	发明专利	2020/12/2	原始取得	赛莱克斯北京	中国

	的制造方法						
3	一种硅通孔铜电镀液及其电镀方法	2021108419066	发明专利	2021/7/23	原始取得	赛莱克斯北京	中国
4	空腔型薄膜体声波谐振器的制造方法	2022104125617	发明专利	2022/4/19	原始取得	赛莱克斯北京	中国
5	一种芯片、制备方法及电子设备	2022104924696	发明专利	2022/5/7	原始取得	赛莱克斯北京	中国
6	一种微波集成电路封装总成及其封装工艺	2022106735468	发明专利	2022/6/14	原始取得	赛莱克斯北京	中国
7	一种微同轴结构的制备方法	2022107681997	发明专利	2022/6/30	原始取得	赛莱克斯北京	中国
8	一种流速平稳的湿法设备槽	2022115065200	发明专利	2022/11/28	原始取得	赛莱克斯北京	中国
9	一种液位检测方法及其检测系统	202211505487X	发明专利	2022/11/28	原始取得	赛莱克斯北京	中国
10	一种双频微机电毫米波天线	2022115591367	发明专利	2022/12/6	原始取得	赛莱克斯北京	中国
11	一种晶圆光阻涂布方法	2022115785748	发明专利	2022/12/9	原始取得	赛莱克斯北京	中国
12	一种含光刻胶晶圆的平坦化方法	2022115784675	发明专利	2022/12/9	原始取得	赛莱克斯北京	中国
13	空腔型薄膜体声波谐振器的制造方法	2022115973272	发明专利	2022/12/12	原始取得	赛莱克斯北京	中国
14	半导体器件和晶圆表面沉积层的去除方法	2022115996772	发明专利	2022/12/12	原始取得	赛莱克斯北京	中国
15	一种 MEMS 器件及其制备方法	2022115965986	发明专利	2022/12/12	原始取得	赛莱克斯北京	中国
16	一种刻蚀设备及其控制方法	2022115966048	发明专利	2022/12/12	原始取得	赛莱克斯北京	中国
17	一种芯片堆叠结构	2022116007306	发明专利	2022/12/13	原始取得	赛莱克斯北京	中国
18	光刻胶刻蚀液、微同轴光刻胶牺牲层释放方法及相关设备	2022116006888	发明专利	2022/12/13	原始取得	赛莱克斯北京	中国
19	一种单片微波集成电路的晶圆级封装方法	2022116639927	发明专利	2022/12/23	原始取得	赛莱克斯北京	中国
20	卫星通信终端天线、仿真方法及相关设备	2023100622827	发明专利	2023/1/17	原始取得	赛莱克斯北京	中国
21	一种针对湿法去胶后的晶圆的处理方法	2023100821784	发明专利	2023/1/19	原始取得	赛莱克斯北京	中国
22	微同轴结构和微同轴结构的制造方法	2023100962231	发明专利	2023/1/19	原始取得	赛莱克斯北京	中国
23	一种微波天线	2023101082597	发明专利	2023/1/20	原始取得	赛莱克斯北京	中国
24	一种芯片、制备方法以及传感器	2023105745908	发明专利	2023/5/22	原始取得	赛莱克斯北京	中国
25	MEMS 传感器的制备方法以及传感器	2023105967284	发明专利	2023/5/24	原始取得	赛莱克斯北京	中国
26	一种芯片测试方法	2023107218302	发明专利	2023/6/19	原始取得	赛莱克斯北京	中国

27	MEMS 器件的制造方法	2023107605447	发明专利	2023/6/26	原始取得	赛莱克斯北京	中国
28	一种 MEMS 干法刻蚀方法、设备及 MEMS 器件	2023107923863	发明专利	2023/6/30	原始取得	赛莱克斯北京	中国
29	台阶微结构的制备方法	2023108438441	发明专利	2023/7/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
30	具有深槽结构的 MEMS 器件的表面图形制备方法	2023109470834	发明专利	2023/7/31	原始取得	赛莱克斯北京	中国
31	MEMS 器件的制备方法	2023109522260	发明专利	2023/7/31	原始取得	赛莱克斯北京	中国
32	一种微同轴结构及制备方法	2023109975858	发明专利	2023/8/9	原始取得	赛莱克斯北京	中国
33	一种基于硅通孔的片上变压器	2023109976456	发明专利	2023/8/9	原始取得	赛莱克斯北京	中国
34	半导体器件、制备方法 及微机电系统 MEMS	2023110080406	发明专利	2023/8/10	原始取得	赛莱克斯北京	中国
35	晶圆电镀膜厚均匀性调整的 阳性膜卡具装置	2023110133403	发明专利	2023/8/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
36	一种基于微同轴技术的 毫米波器件制作方法及 毫米波器件	2023110311896	发明专利	2023/8/16	原始取得	赛莱克斯北京	中国
37	一种同轴线 GSG 接头的 制作方法及同轴线 GSG 接头	2023110368269	发明专利	2023/8/17	原始取得	赛莱克斯北京	中国
38	一种换能器、换能器阵列 及换能器阵列的制作方法	2023110576204	发明专利	2023/8/22	原始取得	赛莱克斯北京	中国
39	一种转接件、制作方法 及芯片封装结构	2023110619407	发明专利	2023/8/23	原始取得	赛莱克斯北京	中国
40	通信终端天线以及通信 终端	2023111102506	发明专利	2023/8/30	原始取得	赛莱克斯北京	中国
41	一种三维谐振器件及其 制作方法	2023111208943	发明专利	2023/8/31	原始取得	赛莱克斯北京	中国
42	一种硅基芯片的平坦化 方法及硅基芯片	2023111263230	发明专利	2023/9/1	原始取得	赛莱克斯北京	中国
43	一种混液装置	2023111553619	发明专利	2023/9/8	原始取得	赛莱克斯北京	中国
44	一种芯片制备方法	2023113174335	发明专利	2023/10/12	原始取得	赛莱克斯北京	中国
45	一种微机电器件的制备 方法、及微机电器件	2023115497355	发明专利	2023/11/20	原始取得	赛莱克斯北京	中国
46	微机电器件空腔结构的 制作方法、及微机电器 件	2023115496206	发明专利	2023/11/20	原始取得	赛莱克斯北京	中国
47	一种微机电器件的制备 方法、及微机电器件	2023115495311	发明专利	2023/11/20	原始取得	赛莱克斯北京	中国
48	一种晶圆刻蚀方法及晶 圆	202311600034X	发明专利	2023/11/28	原始取得	赛莱克斯北京	中国
49	双层金属引线的制造方 法及 MEMS 器件	2023116386383	发明专利	2023/12/1	原始取得	赛莱克斯北京	中国
50	微机电器件硅通孔结构	2023117195773	发明专利	2023/12/14	原始取得	赛莱克斯北京	中国

	的制备方法、及微机电器件						
51	MEMS 微镜及其制备方法	2024100347735	发明专利	2024/1/9	原始取得	赛莱克斯北京	中国
52	一种光刻方法	2024100566107	发明专利	2024/1/15	原始取得	赛莱克斯北京	中国
53	微机电器件硅通孔的制作方法、及微机电器件	2024100748482	发明专利	2024/1/18	原始取得	赛莱克斯北京	中国
54	一种图形化金属层制备方法	2024100807086	发明专利	2024/1/19	原始取得	赛莱克斯北京	中国
55	一种晶圆键合方法、芯片及电子设备	2024101082271	发明专利	2024/1/25	原始取得	赛莱克斯北京	中国
56	MEMS 器件的制造方法	2024101152255	发明专利	2024/1/26	原始取得	赛莱克斯北京	中国
57	一种芯片的制备方法及一种芯片	2024101149549	发明专利	2024/1/26	原始取得	赛莱克斯北京	中国
58	MEMS 微振镜的导线结构及制备方法、MEMS 微振镜	2024102270920	发明专利	2024/2/29	原始取得	赛莱克斯北京	中国
59	微机电器件的制作方法、及微机电器件	2024102737139	发明专利	2024/3/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
60	一种电子器件的制备方法及电子器件	2024102736386	发明专利	2024/3/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
61	MEMS 硅腔的刻蚀装置及刻蚀方法	2024102737891	发明专利	2024/3/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
62	一种光刻机的工艺控制方法及光刻机	2024102735877	发明专利	2024/3/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
63	一种晶片膜层表面处理方法、晶圆的制备方法及晶圆	2024104270770	发明专利	2024/4/10	原始取得	赛莱克斯北京	中国
64	基于聚酰亚胺的光刻工艺参数确定方法	2024104591428	发明专利	2024/4/17	原始取得	赛莱克斯北京	中国
65	一种电子器件的制备方法及电子器件	2024108329222	发明专利	2024/6/25	原始取得	赛莱克斯北京	中国
66	一种平板电容器及其制备方法	2024108234167	发明专利	2024/6/25	原始取得	赛莱克斯北京	中国
67	一种晶圆的键合切边方法及键合晶圆	2024104844347	发明专利	2024/6/26	原始取得	赛莱克斯北京	中国
68	微同轴结构腔体释放方法及微同轴结构晶片	2022115866251	发明专利	2022/12/9	原始取得	赛莱克斯北京	中国
69	一种芯片的制备方法	2023117878811	发明专利	2023/12/22	原始取得	赛莱克斯北京	中国
70	高灵敏度嵌套轮环单片三轴 MEMS 陀螺芯片	2024108125564	发明专利	2024/6/22	原始取得	赛莱克斯北京	中国
71	全解耦四质量对称单片三轴 MEMS 陀螺芯片	2024108125899	发明专利	2024/6/22	原始取得	赛莱克斯北京	中国
72	MEMS 芯片的制备方法	2024108634352	发明专利	2024/6/29	原始取得	赛莱克斯北京	中国
73	一种电子器件的制备方法及电子器件	2024112907850	发明专利	2024/9/14	原始取得	赛莱克斯北京	中国
74	一种电子器件的制备方	2024112909165	发明专利	2024/9/14	原始取得	赛莱克斯北京	中国

	法及电子器件						
75	一种晶圆腔体制备方法及晶圆	2024113081814	发明专利	2024/9/19	原始取得	赛莱克斯北京	中国
76	一种晶圆加工工装	2024113113105	发明专利	2024/9/20	原始取得	赛莱克斯北京	中国
77	一种图形化的方法及晶圆掩膜版	2024114118784	发明专利	2024/10/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
78	一种均匀分布应力的多晶硅薄膜的制备方法	2024114130023	发明专利	2024/10/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
79	一种电子器件的制备方法	2024114179538	发明专利	2024/10/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
80	多晶硅薄膜沉积设备、制备方法	2024114496580	发明专利	2024/10/17	原始取得	赛莱克斯北京	中国
81	晶片退火装置及晶片退火工艺方法	202411550464X	发明专利	2024/11/1	原始取得	赛莱克斯北京	中国
82	硅通孔晶圆的制造方法以及半导体制造方法	2024119435193	发明专利	2024/12/27	原始取得	赛莱克斯北京	中国
83	微机电系统器件及其制造方法	2025101333645	发明专利	2025/2/6	原始取得	赛莱克斯北京	中国
84	防止掺杂元素析出的多晶硅及其制备方法	2025102026540	发明专利	2025/2/24	原始取得	赛莱克斯北京	中国
85	半导体结构及其制备方法	2025104320401	发明专利	2025/4/8	原始取得	赛莱克斯北京	中国
86	一种掺铈氮化铝薄膜的制备方法	202510971666X	发明专利	2025/7/15	原始取得	赛莱克斯北京	中国
87	MEMS 微镜的制备系统和制备方法	2025111173534	发明专利	2025/8/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
88	谐振器的制备方法及谐振器	2025112417216	发明专利	2025/9/2	原始取得	赛莱克斯北京	中国
89	谐振器的制备方法及谐振器	2025113176310	发明专利	2025/9/16	原始取得	赛莱克斯北京	中国
90	全解耦嵌套轮环单片三轴 MEMS 陀螺芯片	2025115763916	发明专利	2025/10/31	原始取得	赛莱克斯北京	中国
91	一种芯片散热装置及制作方法	2022106356635	发明专利	2022/6/6	原始取得	海创微芯	中国
92	一种 MEMS 微同轴功分器及天线阵列	2022115591193	发明专利	2022/12/6	原始取得	海创微芯	中国
93	一种光刻胶显影方法	2022115785733	发明专利	2022/12/9	原始取得	海创微芯	中国
94	一种氮化镓晶体管	2023108223810	发明专利	2023/7/5	原始取得	海创微芯	中国
95	一种氮化镓晶体管动态导通电阻测试电路及测试方法	2023108342237	发明专利	2023/7/7	原始取得	海创微芯	中国
96	一种集成氮化镓及驱动系统的封装结构及电路组件	2023110298001	发明专利	2023/8/16	原始取得	海创微芯	中国
97	一种通孔结构的填充方	2024100506680	发明专利	2024/1/12	原始取得	海创微芯	中国

	法、及通孔结构						
98	一种半导体器件的制备方法 及半导体器件	2024101308418	发明专利	2024/1/30	原始取得	海创微芯	中国
99	微同轴传输结构、制备 方法及电子器件	2024114520791	发明专利	2024/10/17	原始取得	海创微芯	中国
100	传输线结构及其制备方 法	2025101195310	发明专利	2025/1/24	原始取得	海创微芯	中国
101	印刷电路板及其制备方 法	2025101195255	发明专利	2025/1/24	原始取得	海创微芯	中国
102	一种功率分配器、分配 方法、组装方法和分配 装置	2025101310412	发明专利	2025/2/6	原始取得	海创微芯	中国
103	印制电路板及其制备方 法	2025105348813	发明专利	2025/4/27	原始取得	海创微芯	中国
104	系统级封装结构及其制 备方法	2025105350777	发明专利	2025/4/27	原始取得	海创微芯	中国
105	多层电路板及其制备方 法	2025105350349	发明专利	2025/4/27	原始取得	海创微芯	中国
106	一种射频芯片与天线的 一体化封装结构	2024111389267	发明专利	2024/8/19	原始取得	赛莱克斯国际	中国
107	一种差分传输结构及其 组合产品	202411195639X	发明专利	2024/8/29	原始取得	赛莱克斯国际	中国
108	一种差分传输结构的制 备方法	2024111956968	发明专利	2024/8/29	原始取得	赛莱克斯国际	中国
109	一种可重构的芯片到晶 圆的键合方法及器件芯 片	2024112220256	发明专利	2024/9/2	原始取得	赛莱克斯国际	中国
110	一种高频集成 PCB 板及 制备方法	2024112386868	发明专利	2024/9/5	原始取得	赛莱克斯国际	中国
111	一种晶圆的对准系统、 对准方法及键合方法	2024112829993	发明专利	2024/9/13	原始取得	赛莱克斯国际	中国
112	一种晶圆的互联结构及 其制造方法	2024112896235	发明专利	2024/9/14	原始取得	赛莱克斯国际	中国
113	一种用于垂直互联晶圆 的方法	202411289511X	发明专利	2024/9/14	原始取得	赛莱克斯国际	中国
114	器件制备方法	2024113036433	发明专利	2024/9/19	原始取得	赛莱克斯国际	中国
115	曝光焦距确定方法	2024114903252	发明专利	2024/10/24	原始取得	赛莱克斯国际	中国
116	印刷电路板及其制备方 法	2024115068960	发明专利	2024/10/28	原始取得	赛莱克斯国际	中国
117	一种硅转接板的制备方 法、及硅转接板	202311830554X	发明专利	2023/12/28	原始取得	赛微电子	中国
118	基于硅通孔技术的功分 器	2024101037488	发明专利	2024/1/25	原始取得	赛微电子	中国
119	毫米波传输线的制造方 法	2024101149248	发明专利	2024/1/26	原始取得	赛微电子	中国
120	基于空气芯微同轴的皮	2024101166489	发明专利	2024/1/26	原始取得	赛微电子	中国

	肤癌检测器及其制造方法						
121	一种硅基衬底刻蚀方法及电子器件	202410121690X	发明专利	2024/1/29	原始取得	赛微电子	中国
122	声表面波谐振器及其制备方法	2024105169876	发明专利	2024/4/28	原始取得	赛微电子	中国
123	一种同轴电缆、同轴电缆的制造方法及传感器	2024111963340	发明专利	2024/8/29	原始取得	赛微电子	中国
124	一种三维互连传输线及制备方法	202411238636X	发明专利	2024/9/5	原始取得	赛微电子	中国
125	一种微同轴结构及制备方法	2024112486974	发明专利	2024/9/6	原始取得	赛微电子	中国
126	一种光敏传感器及其制备方法	2024119799306	发明专利	2024/12/31	原始取得	赛微电子	中国
127	易分离的阵列基底及其制备方法	2025107543859	发明专利	2025/6/6	原始取得	赛微电子	中国
128	一种三维互连结构及其制作方法	2025107490870	发明专利	2025/6/6	原始取得	赛微电子	中国
129	一种 MEMS 微镜器件、微镜矩阵及制备方法	2025108045456	发明专利	2025/6/17	原始取得	赛微电子	中国
130	压电谐振器及其控制方法	2025108242242	发明专利	2025/6/19	原始取得	赛微电子	中国
131	一种钛掺杂氧化镍纳米片气体传感器及其制备方法	2025108809879	发明专利	2025/6/27	原始取得	赛微电子	中国
132	一种气体传感器封装方法及传感器	202510880985X	发明专利	2025/6/27	原始取得	赛微电子	中国
133	MEMS 器件的制备方法及 MEMS 器件	2025110817553	发明专利	2025/8/4	原始取得	赛微电子	中国
134	一种气体检测系统	2025112507509	发明专利	2025/9/3	原始取得	赛微电子	中国
135	基于 RDL 工艺的多层螺旋电感结构及制备方法	202510779259.9	发明专利	2025/6/12	原始取得	展诚科技	中国
136	基于 RDL 工艺的射频集成电容结构及制备方法	202510780937.3	发明专利	2025/6/12	原始取得	展诚科技	中国
137	基于 FUZZ 测试的寄生参数结果自动化分析系统	202510937206.5	发明专利	2025/7/9	原始取得	展诚科技	中国
138	基于 RDL 工艺的带通滤波器结构封装方法	202511261399.3	发明专利	2025/9/5	原始取得	展诚科技	中国
139	基于 RDL 工艺的射频无源器件热管理结构制造方法	202511277193.X	发明专利	2025/9/9	原始取得	展诚科技	中国
140	Socket 接口多任务协调的寄生参数抽取方法及系统	202511261234.6	发明专利	2025/9/5	原始取得	展诚科技	中国
141	基于权重的分布式精度抽取方法	202511262445.1	发明专利	2025/9/5	原始取得	展诚科技	中国

142	一种带悬浮金属的电容网络精简方法	202511277056.6	发明专利	2025/9/9	原始取得	展诚科技	中国
143	一种高度并行化的阻容网络的优化方法	202511299663.2	发明专利	2025/9/12	原始取得	展诚科技	中国
144	一种用于电路参数优化的自适应保真度模型调度方法及系统	2025115169167	发明专利	2025/10/23	原始取得	展诚科技	中国
145	一种面向多工艺角的集成电路性能一致性自动优化方法	2025115251250	发明专利	2025/10/24	原始取得	展诚科技	中国
146	一种基于电路拓扑结构感知的集成电路自动化生成方法	2025115184449	发明专利	2025/10/23	原始取得	展诚科技	中国

5、现金流

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,053,905,993.89	1,588,055,611.06	-33.64%
经营活动现金流出小计	1,067,812,753.97	1,232,461,098.29	-13.36%
经营活动产生的现金流量净额	-13,906,760.08	355,594,512.77	-103.91%
投资活动现金流入小计	1,716,063,068.72	17,249,506.13	9,848.48%
投资活动现金流出小计	695,182,180.03	611,420,297.35	13.70%
投资活动产生的现金流量净额	1,020,880,888.69	-594,170,791.22	271.82%
筹资活动现金流入小计	1,167,639,598.50	392,325,077.56	197.62%
筹资活动现金流出小计	548,732,484.43	466,041,395.22	17.74%
筹资活动产生的现金流量净额	618,907,114.07	-73,716,317.66	939.58%
现金及现金等价物净增加额	1,628,915,955.46	-330,196,264.58	593.32%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 103.91%，主要是因瑞典 Sillex 自 2025 年 8 月起不再并表，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致；

2、本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 271.82%，主要是因公司处置子公司及其他营业单位（主要为瑞典 Sillex）收到的现金净额较上年同期增加所致；

3、本报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 939.58%，主要是因公司本年取得借款收到的现金较上年同期增加所致；

4、本报告期，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 593.32%，为以上因素共同作用的综合结果。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-13,906,760.08 元，本年度净利润为 1,388,434,832.63 元，两者差异-1,402,341,592.71 元；

1、影响净利润但不涉及经营活动现金流量的非经营性项目：此部分导致公司经营性现金流较净利润减少合计 2,129,216,217.87 元，主要为投资收益、财务费用等；

2、影响净利润但不涉及经营活动现金流量的经营性项目：此部分导致公司经营性现金流较净利润增加合计 684,255,495.89 元，主要为资产减值损失、信用减值损失、资产折旧与摊销、股权激励费用、递延所得税资产/负债增减变动等；

3、不影响净利润但涉及经营活动现金流量的经营性项目：此部分导致公司经营性现金流较净利润增加合计 42,619,129.27 元，主要为经营性应收应付项目的增减变动、存货的增减变动、递延收益的增减变动等。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,230,837,643.69	161.64%	主要因报告期出售瑞典 Sillex 股权产生收益所致。	否，公司出售全资子公司控制权产生的收益不具有可持续性。
公允价值变动损益	0.00	0.00%	不适用	不适用
资产减值	-120,117,683.96	-8.70%	主要因报告期计提存货跌价准备所致。	否，公司仍将严格按照相关会计准则及会计政策对公司资产进行减值测试，谨慎客观地反映资产情况。
营业外收入	43,416.55	0.00%	主要因报告期取得非经营性收入所致。	否，非经营性收入不具有可持续性。
营业外支出	115,893.69	0.01%	主要因报告期产生非经营性支出所致。	否，相关支出受公司实际经营环境及资产状况影响，不具有可持续性。
其他收益	9,954,770.69	0.72%	主要由与日常活动相关的政府补助产生。	否，能否获得政府补助需要根据相关政策及管理部门审批。
信用减值损失	-311,708.41	-0.02%	主要因报告期计提坏账准备所致。	否，公司仍将严格按照相关会计准则及会计政策对公司资产进行减值测试，谨慎客观地反映资产情况。
资产处置收益	255,635.05	0.02%	主要因报告期处置非流动资产产生收益所致。	否，相关收益受公司资产状况影响，不具有可持续性。

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2025 年末		2025 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,244,368,874.18	25.11%	616,222,918.72	8.79%	16.32%	主要因报告期收到出售瑞典 Sillex 股权全

						额交易价款所致。
应收账款	293,225,623.06	3.28%	512,242,749.28	7.31%	-4.03%	主要因报告期出售瑞典 Sillex 股权，丧失对其控制权不再纳入合并报表范围所致。
合同资产				0.00%	0.00%	无变动。
存货	290,157,341.34	3.25%	464,486,082.64	6.62%	-3.37%	主要因报告期出售瑞典 Sillex 股权，丧失对其控制权不再纳入合并报表范围所致。
投资性房地产				0.00%	0.00%	无变动。
长期股权投资	2,462,613,615.86	27.55%	580,845,635.71	8.28%	19.27%	主要因报告期出售瑞典 Sillex 股权，按照权益法核算持有的剩余股权，并在丧失控制权日按照公允价值进行重新计量所致。
固定资产	1,501,932,886.96	16.80%	1,799,636,378.42	25.67%	-8.87%	主要因报告期出售瑞典 Sillex 股权，丧失对其控制权不再纳入合并报表范围、融资租赁转出及计提折旧等共同所致。
在建工程	476,905,888.63	5.33%	891,261,115.57	12.71%	-7.38%	主要因报告期“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”达到预定可使用状态转固所致。
使用权资产	376,634,024.71	4.21%	497,325,434.25	7.09%	-2.88%	无重大变动。
短期借款	253,397,568.67	2.83%	109,851,280.96	1.57%	1.26%	主要因报告期短期银行借款增加所致。
合同负债	115,193,080.37	1.29%	98,116,457.55	1.40%	-0.11%	无重大变动。
长期借款	754,615,128.64	8.44%	620,488,083.37	8.85%	-0.41%	无重大变动。
租赁负债	171,525,401.71	1.92%	101,004,999.74	1.44%	0.48%	主要因报告期售后回租业务增加所致。
衍生金融资产	0.00	0.00%	7,101,460.29	0.10%	-0.10%	主要因报告期出售瑞典 Sillex 股权，丧失对其控制权不再纳入合并范围。
应收票据	34,338.00	0.00%		0.00%	0.00%	主要因报告期公司子公司接受票据结算应收款项所致。
预付款项	186,017,306.18	2.08%	42,562,070.05	0.61%	1.47%	主要因报告期收购展诚科技股权，取得其控制权纳入合并范围及业务预付款增加所致。
其他流动资产	67,833,625.07	0.76%	122,602,804.86	1.75%	-0.99%	主要因报告期收到应收退税款所致。
流动资产合计	3,206,766,840.01	35.87%	1,882,814,660.76	26.85%	9.02%	综合因素所致。
其他权益工具投资	148,857,235.47	1.67%	89,715,000.00	1.28%	0.39%	主要因报告期新增其他权益工具投资所致。
无形资产	109,251,627.57	1.22%	183,409,821.15	2.62%	-1.40%	主要因报告期出售瑞

						典 Sillex 股权，丧失对其控制权不再纳入合并报表范围所致。
商誉	131,227,814.14	1.47%	491,443,302.52	7.01%	-5.54%	主要因报告期出售瑞典 Sillex 股权丧失对其控制权，相关商誉进行转出；收购展诚科技股权取得其控制权确认相关商誉。
长期待摊费用	16,822,812.07	0.19%	7,256,735.70	0.10%	0.09%	主要因报告期待摊装修费用增加所致。
衍生金融负债	0.00	0.00%	1,572,738.32	0.02%	-0.02%	主要因报告期出售瑞典 Sillex 股权，丧失对其控制权不再纳入合并范围。
应付票据	3,759,529.24	0.04%	6,249,110.00	0.09%	-0.05%	主要因报告期使用票据结算应付款项较上年末减少所致。
应付账款	46,839,044.91	0.52%	81,699,853.49	1.17%	-0.65%	主要因报告期出售瑞典 Sillex 股权，丧失对其控制权不再纳入合并范围。
应付职工薪酬	34,897,273.94	0.39%	51,856,297.37	0.74%	-0.35%	主要因报告期出售瑞典 Sillex 股权，丧失对其控制权不再纳入合并范围；报告期收购展诚科技股权，取得其控制权纳入合并范围，且其年末计提年终奖综合所致。
应交税费	6,656,147.03	0.07%	19,075,211.59	0.27%	-0.20%	主要因报告期出售瑞典 Sillex 股权，丧失对其控制权不再纳入合并范围。
其他应付款	164,053,499.14	1.84%	81,301,309.96	1.16%	0.68%	主要因报告期确认应退回政府补助款所致。
其他流动负债	4,994,983.96	0.06%	2,037,392.24	0.03%	0.03%	主要为待转销项税额增加，因报告期合同负债增加所致。
流动负债合计	829,381,292.37	9.28%	605,402,274.17	8.63%	0.65%	综合因素所致。
长期应付款	31,494,400.00	0.35%	0.00	0.00%	0.35%	主要因报告期收购展诚科技股权，根据协议约定交易款按期支付，确认对被收购方的应付款。
递延收益	118,169,777.20	1.32%	194,756,556.69	2.78%	-1.46%	主要因报告期确认应退回政府补助款所致。
递延所得税负债	12,916,902.49	0.14%	100,522,072.65	1.43%	-1.29%	主要因报告期出售瑞典 Sillex 股权，丧失对其控制权不再纳入合并范围。
其他综合收益	34,319,994.62	0.38%	-137,984,750.19	-1.97%	2.35%	主要因报告期出售瑞典 Sillex 股权，丧失

						对其控制权不再纳入合并范围。
盈余公积	58,529,640.80	0.65%	26,899,277.77	0.38%	0.27%	主要因报告期提取盈余公积所致。
未分配利润	1,704,231,080.21	19.06%	254,074,064.86	3.62%	15.44%	综合因素所致。
归属于母公司所有者权益合计	6,734,386,456.42	75.33%	4,923,596,975.33	70.22%	5.11%	综合因素所致。
少数股东权益	286,933,069.57	3.21%	465,566,812.30	6.64%	-3.43%	主要因报告期收购赛莱克斯北京少数股东股权所致。
所有者权益合计	7,021,319,525.99	78.54%	5,389,163,787.63	76.86%	1.68%	综合因素所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2. 衍生金融资产	7,101,460.29	804,006.79	946,379.90				-8,851,846.98	0.00
上述合计	7,101,460.29	804,006.79	946,379.90				-8,851,846.98	0.00
金融负债	1,572,738.32	-170,652.11					-1,402,086.21	0.00

其他变动的内容

其他变动主要是因报告期出售瑞典 Silex 控制权，报告期末不再纳入合并报表范围。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司权利受限的资产主要包括通过融资租赁方式买入的产线机器设备及电子设备期末账面价值 37,447.21 万元，用于并购贷款质押的展诚科技 56.24% 股权和赛莱克斯北京 9.5% 股权。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
695,182,180.03	611,420,297.35	13.70%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求

公司在报告期内涉及的重大投资项目，主要是境内产线的产能扩充（相应的设备采购），相关投资随业务订单及产能扩

充需求处于持续发生状态，境内子公司的资金来源于自有及自筹资金。该等投资有利于公司提高半导体代工服务能力、促进公司半导体代工业务的发展。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	MEMS 工艺开发和晶圆制造	收购	323,709,600.00	9.50%	自有或自筹资金	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	长期	-	签署《产权交易合同》，支付全部交易价款，收到北京产权交易所出具的《产权交易凭证》	-	15,797,686.81	否	2025年07月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
青岛展诚科技有限公司	IC 设计服务	收购	157,472,000.00	56.24%	自有或自筹资金	青岛展诚微电子合伙企业（有限合伙）、青岛展诚半导体合伙企业（有限合伙）、孙延辉、袁鹏飞、刘斌、周静、李世密、刘晓颖	长期	-	已完成工商变更登记	-	13,070,211.65	否	2025年08月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	481,181,600.00	--	--	--	--	--	--	0.00	2,727,475.16	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	自建	是	MEMS	52,106,418.75	2,618,599,382.00	自筹及发行股份募集	84.54%	172,968,267.48	753,127,285.99	不适用		

MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目	自建	是	MEMS	8,063,901.22	921,944,645.12	自筹及发行股份募集	100.00%	73,500.11	73,500.11	不适用		
合计	--	--	--	60,170,319.97	3,540,544,027.12	--	--	173,041,767.59	753,200,786.10	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
金融衍生工具	0	552.88	97.47	94.64	0	0	0	0.00%
合计	0	552.88	97.47	94.64	0	0	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则上与上一报告期相比未发生重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	对公司本期实际损益影响金额较小。							
套期保值效果的说明	通过外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率风险，增强公司财务稳健性。							
衍生品投资资金来源	自有资金。							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	一、风险分析 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。 3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不够明确，将可能面临法律风险。							

	<p>二、控制措施</p> <p>1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东会审议批准的授权额度。</p> <p>2、公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。</p> <p>3、公司将审慎审查与合格金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</p> <p>4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。</p> <p>5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	外汇等衍生品的公允价值以该等衍生品报告期末在市场可获得的市场报价确定。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2025 年 03 月 20 日

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
Bure Equity AB、Creades AB (publ)、Aktiebolag Grens specialisten、Tham	Silex Micro systems AB 4,410,115	2025 年 07 月 23 日	178,978.07	7,948.57	本次交易完成后，瑞典 Silex 由公司全资子公司变	154.75%	采取竞争性谈判方式，并最终选取综合	否	不适用	是	是	2025 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

Special Investment AB、Tom Enterprise Private AB、Salénia AB、SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda Bankens Pens. Stif	股份				为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。		条件最优的交易方案						
--	----	--	--	--	------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
赛莱克斯北京（经营业绩构成影响）	子公司	MEMS 工艺开发及晶圆制造	210,526.32 万元	3,062,501,848.16	1,041,115,220.04	172,968,267.48	342,560,689.15	309,887,493.84
瑞典 Silex（经营业绩构成影响，2025 年 8-12 月）	参股公司	MEMS 工艺开发及晶圆制造	536.15 万瑞典克朗	1,710,447,906.27	1,086,864,832.93	500,718,323.80	137,992,965.91	115,298,854.29

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Silix Microsystems AB 及其 2 家子公司	股权转让	报告期内，公司 2025 年 7 月完成对原全资子公司瑞典 Silix 控制权的出售，本次交易完成后，瑞典 Silix 由公司全资子公司转变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，公司仍保留了瑞典 Silix 45.24%股份，能够持续获取稳定投资收益，并保留了参与重大事项决策的权利。由出售瑞典 Silix 控制权产生的非经常性损益对本报告期归属于上市公司股东的净利润产生重大影响；上述股权交易是公司营业收入下降，归属于上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因。未来，公司或将面临 MEMS 业务收入下降的风险，相关内容详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望”章节中“MEMS 业务收入下降的风险”。
青岛展诚科技有限公司及其 6 家子公司	股权收购	报告期内，公司 2025 年 9 月完成对展诚科技 56.24%股权的收购，本次交易完成后公司合计持有展诚科技 61.00%股权，通过本次交易公司拓展了 IC 设计服务。得益于集成电路行业总体行业的发展以及展诚科技在 IC 设计服务领域领先的行业地位，展诚科技 IC 设计服务业务发展势头良好。未来，公司将积极拓展与控股子公司展诚科技的业务协同效应，将展诚科技打造成为积极为公司贡献业务的经营主体基础上，发挥展诚科技在 IC 设计服务领域为公司 MEMS 芯片代工业务客户的拓展导入功能。
运通电子技术发展有限公司	新设成立	无重大影响。
无锡筑芯科技有限公司	新设成立	无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

1、瑞典 Sillex 是全球领先的 MEMS 纯代工企业，由公司于 2015-2016 年通过收购取得，受益于下游市场需求增长及公司有效整合，其自收购后至今营业收入及净利润整体呈持续增长态势，是公司近年来的主要业绩贡献实体。2025 年 6 月，公司决策出售瑞典 Sillex 控制权，2025 年 7 月，本次重大资产出售完成交割，瑞典 Sillex 成为公司参股子公司。

2、赛莱克斯北京由公司与国家集成电路产业基金共同投资建设，历经数年准备后于 2021 年 6 月启动正式生产。报告期内，赛莱克斯北京持续推动 MEMS 硅麦克风、惯性器件、气体流量开关、BAW（含 FBAR）滤波器、微振镜、气体、微流控、硅光子、振荡器、MEMS-OCS、3D 硅电容等不同类别、不同型号产品的工艺开发及产品验证，具有导入属性的工艺开发业务继续开展，带动着公司从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆产品类别持续增加，但报告期内由于赛莱克斯北京仍处于产能爬坡阶段，部分原有量产客户订单在报告期内因下游市场需求变化产生较大波动，收入出现下滑。此外，赛莱克斯北京研发投入依然保持较高强度，运营支出存在刚性，叠加折旧摊销等因素，亏损较上年扩大，若后续该产线的产能及良率实现持续提升，有望亏损收窄并最终实现盈利、成为公司重要的收入及利润来源。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

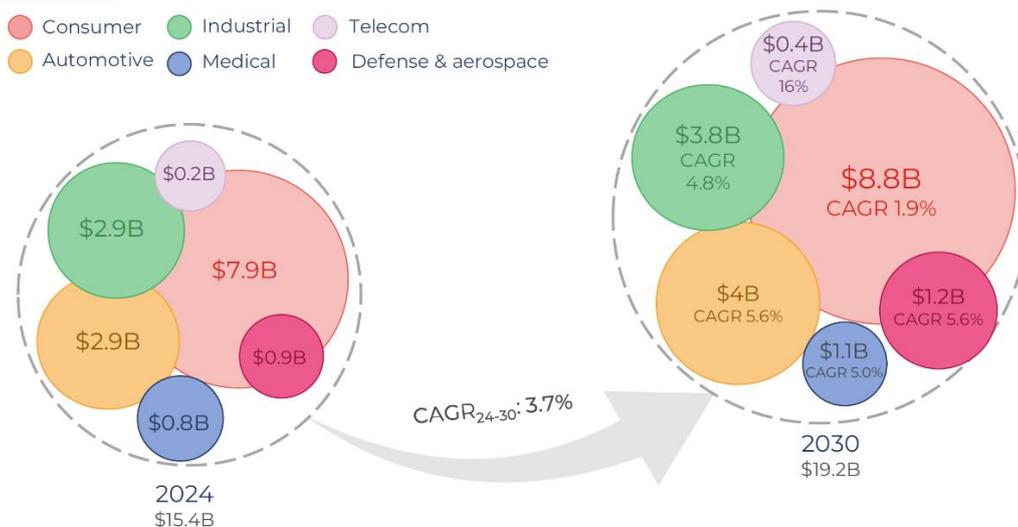
（一）行业格局和趋势

全球集成电路行业整体发展前景广阔、长期向好，AI 芯片、HBM 存储、先进封装正成为核心增长引擎，此外集成电路行业分工逐步细化，技术上也由单纯追逐先进制程转向 Chiplet、3D 堆叠、异构集成等系统集成创新。包含公司 MEMS 纯代工和 IC 设计服务在内的集成电路行业，成长预期明确，具备高确定性发展前景。

1、MEMS 行业格局和趋势

随着万物互联与人工智能的兴起，作为集成电路细分行业的 MEMS 获得了更广阔的市场空间和业务机会。传统的传感器、执行器和无源结构器件目前正逐步被替代，这使 MEMS 技术的渗透率得以进一步提高。根据世界权威半导体市场研究机构 Yole Development 发布的《Status of the MEMS Industry 2025》，全球 MEMS 市场规模将由 2024 年的 154 亿美元增长至 2030 年的 192 亿美元，CAGR（年均复合增长率）为 3.7%。

MEMS MARKET FORECAST, BY END-MARKET



图片来源: Yole Development

(1) 光学 MEMS 领域

在光学市场，人工智能对高速通信的需求，促进了硅光技术和 MEMS 硅光子产品的迅速发展。硅是集成电路制造中常见的材料，但硅材料发光性差，导致生产出的调制器占用空间较大。为了解决这一问题，业界探索基于环形谐振器的调制器，但光谱响应较窄，容易出现变化，需要额外的移相器来进行波长调谐，导致损耗过大。MEMS 技术可以通过构建紧凑、宽频、快速、低损耗、低功耗的模块解决以上问题，制造各类硅光子器件，助力硅光子实现广泛应用和市场突破，如可调谐激光器、耦合器、移相器、光开关等。随着 AI 技术的快速发展，Meta、Open AI、微软、谷歌、百度、阿里、科大讯飞、华为等公司等纷纷推出 LLM（大语言模型）等各类 AI 模型，引爆全球算力及相关芯片、服务器、数据中心需求。随着大型 AI 模型的参数数量级从百亿跃升到千亿级别，对计算能力和内存资源的需求也随之急剧增长，业界目前普遍采用构建算力集群的方式去满足相应需求，并使用数千个图形处理器（GPU）训练运行。相关训练可能耗费数周时间，价值高昂，因此找到提高训练效率的方法至关重要。与传统交换机方案相比，基于 MEMS 的光交换方案在 GPU 之间的数据交换速率及功耗等方面都具备突出优势，对于降低机器学习训练的时间和费用有很大帮助。随着谷歌在张量处理单元（TPU）OCS 的成功应用以及海量算力需求的持续释放，MEMS-OCS 有望在业界得到推广使用，包括新建及传统数据中心，这将催生新型 MEMS 硅光产品的巨量需求。根据 Yole 此前预测的数据，预计 2023-2028 年，光学 MEMS 市场将从 6.57 亿美元增长至 13.04 亿美元。

Optical MEMS market forecasts (\$M)
©Yole Intelligence, July 2023



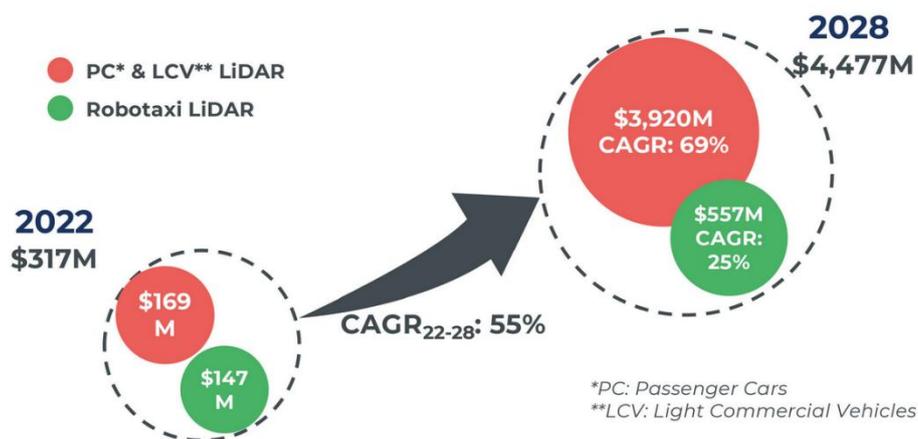
图片来源: Yole Development

(2) 汽车 MEMS 领域

在智能化、电动化、网联化发展的背景下，汽车 MEMS 市场将出现较为强劲的增长。中国新能源汽车产量快速增长，智能化程度不断提高，带动了激光雷达和微振镜等相关 MEMS 器件的需求。激光雷达又可分为机械式、混合固态等类别，采用 MEMS 技术的混合固态技术显著缩小了雷达体积和功耗，具备运动部件少、可靠性高、扫描频率快、规模化生产等优势，后者的核心扫描部件即为 MEMS 微振镜。根据 Yole 的数据预测，2022-2028 年全球汽车激光雷达市场预计将从 3.17 亿美元增长至 44.77 亿美元，CAGR（年均复合增长率）高达 55%。

2022-2028 LIDAR MARKET FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS

Source: LiDAR for Automotive 2023 report, Yole Intelligence, 2023



图片来源: Yole Development

(3) 通信 MEMS 领域

在通信市场, 信号之间的干扰问题需要滤波器进行解决, 且在发射及接收通路中都需要使用, 所以滤波器是射频系统中最重要元器件, 直接影响各频段信号通信质量。在 5G 及更高频通信时代, BAW 滤波器具有高频率和宽频带的技术优势, 可以提供更低的插入损耗, 更好的选择性, 更高的功率容量, 更大的运行频率, 更好的静电放电保护, 在高频应用场景有着更佳的表现。根据 Yole 发布的《BAW Filter Comparison 2022》, 2026 年滤波器市场将增长至 80 亿美元以上。2026 年, SAW 滤波器在智能手机市场的占比将从 2020 年的 64% 降至 50%, 同时 BAW 滤波器占比将增长至 45%。

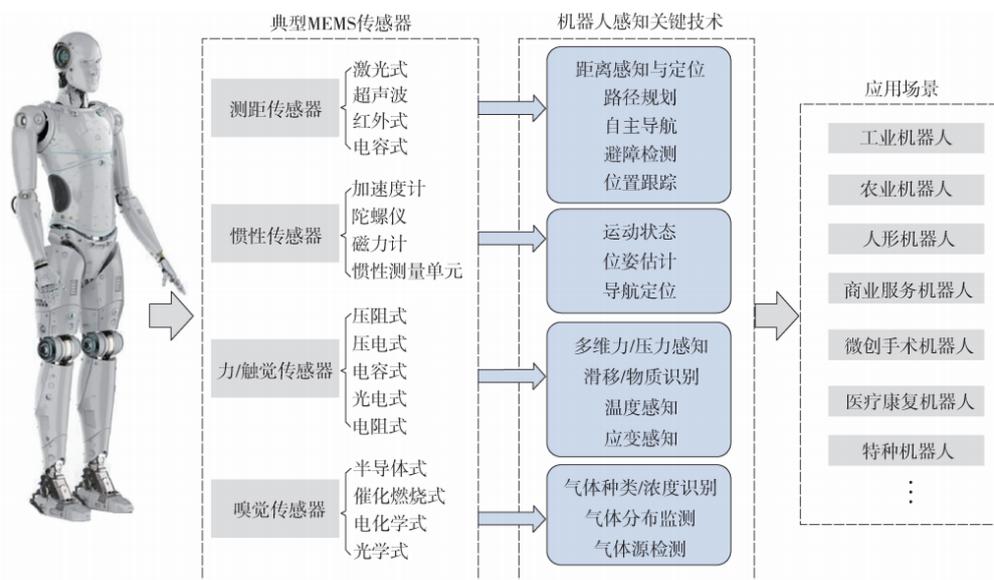


图片来源: Yole Development

(4) 机器人领域

在机器人领域, MEMS 传感器具有重要作用。MEMS 惯性测量单元、加速度计和陀螺仪, 能够帮助机器人精确感知自身姿态和运动轨迹; MEMS 测距传感器/激光雷达可以实时监控机器人的位置以及与障碍物的距离, 帮助机器人进行路径规划和避障; MEMS 力传感器有望应用于机器人手臂的力反馈控制, 帮助机器人感知物体抓取施加力量, 实现精细化操作; MEMS 温湿度、气体传感器, 也有望在机器人领域得到应用。对于手术机器人而言, MEMS 传感器能够提供精确的运动和力反馈, 帮助医生进行微创手术操作。对于工业机器人而言, MEMS 传感器有助于更好地进行装配、焊接及搬运等工作, 提高生产效率和精度。此外, 工信部在《人形机器人创新发展指导意见》中指出: “人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术, 有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品, 将深刻变革人类生产生活方式, 重塑全球产业发展格局。” 机器人市场有望带动相关 MEMS 传感器需求的持续增长。

典型 MEMS 传感器在机器人领域中的应用



图片来源：刘会聪, 王凤霞, 李东升, 迟文政, 孙立宁. 基于 MEMS 传感器的机器人感知技术研究现状与发展趋势[J]. 智能感知工程, 2024, 1(1):14-24.

(5) 商业航天领域

在商业航天领域，MEMS 惯性测量单元、加速度计和陀螺仪能够为商业火箭、卫星与航天器提供高精度姿态感知，保障入轨精度与在轨稳定运行；MEMS 压力、流量与液位传感器可实时监测推进剂状态、箭体/星体内环境参数，支撑动力系统与热控系统安全可靠工作；MEMS 微振传感器、射频 MEMS 器件可用于航天器结构健康监测、星间/星地通信链路与时空阵列天线调谐，提升信号质量与系统稳定性；MEMS 温度、真空传感器也广泛适配太空极端环境，保障平台与载荷长期稳定工作。MEMS 传感器有望以微型化、低功耗、高可靠与低成本优势，成为卫星大规模组网的基础器件，显著降低研制与发射成本；对于商业运载火箭而言，MEMS 传感器助力起飞、入轨与回收全流程精准控制，提升发射成功率与复用能力。商业航天的快速发展与大规模建设，将持续带动高可靠 MEMS 传感器需求高速增长。

典型 MEMS 传感器在商业航天领域中的应用



图片来源：赛微电子

与传统集成电路产业类似，从 MEMS 产业价值链来看，根据行业内企业提供的产品或服务，主要可以分为设计、制造和封测三个环节。其中，MEMS 制造处于产业链的中游。该行业根据设计环节的需求开发各类 MEMS 芯片的工艺流程并实现规模生产，兼具资金密集型、技术密集型和智力密集型的特征，对企业资金实力、研发投入、技术积累等均提出了极高要求。目前而言，IDM 企业凭借长期的行业积累、技术实力以及客户基础仍主导着 MEMS 加工制造，但也逐渐出现一些新的变化，一方面 IDM 企业受到来自升级产业线以及降低成本维持利润的双重压力，市场中已出现 IDM 企业将制造环节外包的情况；另一方面，MEMS 产品应用的爆发式增长需要不同领域、不同行业的新兴 MEMS 公司参与其中，但巨额的工厂建设投入、运维成本以及 MEMS 工艺开发、集成的复杂性形成了较高的行业门槛，阻碍了市场的持续扩张。而随着 MEMS 产业的大规模发展，各环节开始出现明显的分工趋势。参照 IC 产业的发展历程，尽管目前过半的 MEMS 业务仍然掌握在 IDM 企业中，但 MEMS 生产的大批量、标准化需求使得 MEMS 产业的专业化分工将成为重要的发展趋势。

MEMS 产业图示



图片来源：Yole Development

随着消费类电子和互联网的兴起，MEMS 产品种类增加、市场规模扩大，行业对产品生产周期的缩短及生产成本的降低提出了更高要求，同时 MEMS 工艺研发费用迅速上升以及未来建厂费用高企促使更多的半导体厂商将工艺开发及生产相关的制造环节外包，纯 MEMS 代工厂与 MEMS 产品设计公司合作开发的商业模式将成为未来主流行业业务模式。类似于传统集成电路行业发展趋势，MEMS 产业将逐步走向设计与制造分立、制造环节外包的模式。从趋势上看，全球 MEMS 代工业务，尤其是纯 MEMS 代工业务有望快速扩张；从结构上看，纯 MEMS 代工业务在 MEMS 代工业务中所占比重有望逐步升高。

2014 年底，国家集成电路基金成立，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，以充分发挥国家对集成电路产业发展的引导和支持作用。国家集成电路基金主要围绕国内细分领域龙头企业进行投资布局，期望以龙头企业为载体打造资源整合平台，协调产业链上下游融合。作为国内首支集成电路产业股权基金，国家集成电路基金对于半导体行业具备深刻的理解和专业认知，拥有充足资金、行业资源及专业的投资团队作为项目投资及投后管理的坚实后盾。除直接对公司控股子公司赛莱克斯北京增资 6 亿元并持股 30%外（后因极芯传感对赛莱克斯北京增资，该持股比例变更为 28.5%，目前持股比例 19%），国家集成电路基金参与公司 2019 年非公开发行股票约 10.28 亿元，以进一步支持公司推进建设“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”，打造整合国内外产业资源的平台型企业，提升公司 MEMS 行业的市场地位和全球影响力。

2、IC 设计服务行业格局和趋势

在全球化集成电路蓬勃发展过程中，随着芯片制程不断精进、系统复杂度呈指数级提升，芯片研发已演变为高度专业化、知识密集型的独立赛道——IC 设计服务与 EDA 工具服务由此成为产业链不可或缺的行业。IC 设计服务是连接技术、工艺与产品的桥梁，大幅降低了芯片研发门槛、缩短周期、控制成本与风险；EDA 是芯片设计的工业软件，决定设计效率与上限，二者共同支撑芯片从算法到流片的全流程实现，是集成电路芯片设计产业创新效率的关键保障。当前，IC 设计服务行业凭借全流程技术解决方案与定制化服务能力，深度渗透通信计算、消费电子、工业汽车等多个核心领域；而国内 EDA 市场虽然仍由新思科技（Synopsys）、楷登电子（Cadence）和西门子（Siemens）EDA 三大巨头主导，但国产力

量正加速突围态势，致力于实现国产替代。

通信计算领域是当下 IC 设计服务的前沿领域。通信计算领域的卫星通信普及和数据中心算力升级，推动着高性能计算 IC 设计服务需求激增。具体来讲，IC 设计服务通过先进制程（7nm 及以下）设计、异构集成技术突破，助力通信计算芯片实现算力提升与功耗优化；同时 IC 设计服务为量子计算、光电子芯片等前沿领域提供前瞻性设计解决方案，支撑数字基础设施建设，大力推动着通信计算领域向高速率、高算力、低延迟升级，已经成为通信计算领域高速发展不可或缺的重要力量。报告期内，展诚科技通过高质量的服务与国内通信计算大客户实现了深度绑定，为公司业绩提升提供了源源不断动力。

消费电子领域为 IC 设计服务的传统基础阵地。近年来，消费电子向智能化、高端化升级趋势明显，智能手机、智能家居、可穿戴设备等终端对芯片的高性能、低功耗、小型化需求日益迫切。IC 设计服务通过优化芯片架构、提升制程适配能力，助力终端厂商实现产品差异化竞争，无论是高端手机的影像芯片、快充芯片，还是智能家居的物联网连接芯片，都离不开 IC 设计服务的配套能力。伴随消费电子换新潮与物联网普及，该领域需求将持续稳定增长。报告期内，展诚科技在消费电子电源管理等方面持续服务相关客户，巩固了公司在消费电子领域的行业领先地位。

工业汽车领域是目前 IC 设计服务的重要增长极。随着汽车智能化、网联化转型，当前自动驾驶正向 L3+ 级别演进，工业汽车领域车规级芯片对功能安全、可靠性的严苛标准，要求 IC 设计服务向高安全性、高兼容性升级。众多 IC 设计服务公司当下正通过提供车规级 SoC 芯片全定制设计、Chiplet 异构集成方案及相关合规验证服务，提升自身在工业汽车芯片领域的话语权，助力车企突破自动驾驶感知、决策、控制核心芯片瓶颈，推动车载娱乐、车联网模块的轻量化设计，降低研发成本与周期。报告期内，展诚科技服务在工业汽车领域客户持续推进终端应用，包括但不限于汽车音频功放、电机驱动等。

除此之外，IC 设计服务在工业控制、物联网、航空航天等领域也发挥着不可替代的作用。在工业控制领域，IC 设计服务企业为工业 MCU、PLC 芯片提供设计服务，支撑智能制造转型；在物联网领域，通过轻量化芯片设计，IC 设计服务助力海量终端连接；在航空航天领域，提供高可靠性、抗干扰芯片设计方案，IC 设计服务保障航空航天设备稳定运行。

综上所述，公司主要业务所处行业呈现朝气蓬勃的发展趋势，拥有良好政策环境、广阔发展前景与巨大的发展潜能。公司将积极把握行业趋势，整合各项资源，力争实现业务的快速发展。

（二）公司的发展战略

公司的长期发展战略为：基于当前国际局势紧张及日趋复杂化的考量，对于经济全球化与国际产业链分工协作可能面临的挑战，推动一站式服务在客户拓展方面的重要作用，同时在境内外布局建立兼具“工艺开发”与“晶圆制造”功能的制造产线，以同时满足境内外客户的不同需求，致力于形成可支持“内循环”、兼顾“双循环”的一站式综合服务体系；同时积极进行产业投资布局，最终致力于成为一家立足本土、国际化经营的知名半导体专业服务厂商。

（三）公司的具体经营计划

2025 年，面向万物互联与人工智能时代，公司已形成以半导体为核心的业务格局，聚焦发展 MEMS 核心业务，并在报告期内稳健推进了各项工作，详细情况见本报告本节“四、主营业务分析”之“1、概述”，即公司 2025 年的发展战略和经营计划根据外部环境进行了适应性调整并得到有效执行。

2026 年，公司将继续落实总体发展战略及董事会制定的经营方针，以技术及市场为导向，聚焦发展主营业务，统筹各项资源，继续提高境内 MEMS 纯代工业务的承接能力，同时积极开拓 IC 设计服务及 EDA 工具服务，在研发、生产、市场等方面全面加强。2026 年，公司经营计划将继续围绕以下几个方面进行实施：

1、技术创新

为保持和提高技术水平及创新能力，公司将继续重视研发投入，加大力度研究可应用于人工智能、数据中心、光学

传输、高频通信、生物医药、工业汽车等领域的 MEMS 工艺制造技术和 IC 设计服务，为万物互联与人工智能时代提供更丰富的基础硬件支持；重视技术开发与创新向上游基础器件与下游终端设备的延伸；逐步建立整体研发体系，促进子公司之间的资源共享与技术互补，共同提高基础性及应用性研发工作的效率；积极参与产学研合作，组织实施重点研发计划项目。

2、生产制造

2026 年，公司将持续为客户提供高质量、高标准的产品和服务，提升良率及客户满意度；持续满足 ISO 9001 质量管理等体系要求和北京亦庄 MEMS 量产线 IATF 16949 认证；重视积累现有产品的生产经验，推动更多产品导入量产，不断提高工艺技术水平；加大职业健康安全风险识别与防范，严格管理有害物质，维持安全生产；在保障生产质量的前提下，推动降低采购成本和节能减排，减少碳排放和水资源消耗，保护生态环境。

3、市场营销

市场方面，在现有架构和业务布局的基础上，加强与客户的协调，继续完善 MEMS 产业生态，深化全国重点区域与海外重点市场布局；重视梯队建设，强化销售及技术支持人员的培训，提高业务水平；丰富产品资料及销售工具，加强市场推广，强化展会与行业联盟的纽带作用；继续建立整体市场营销体系，促进境内外子公司之间服务与销售网络资源的共享，提升整体市场营销实力。

4、人力资源

落实绩效评价体系和人才激励机制，持续提升工作效率；维护并强化高素质的人才队伍，重视梯队建设；加强重点岗位的招聘力度，积极做好高端人才引进和服务保障工作；构建科学的人才培养体系，提供个性化、多类别培训，充分发掘员工潜力；搭建多元沟通渠道，构建和谐、开放的职场环境，保障员工合法权益；关怀员工生活，增强员工归属感，营造积极向上、团结友爱的企业文化氛围。

5、财务与风险控制

积极主动对接资本市场，了解资本市场动态，获取推介机会，有效提升企业运营能力；继续推动重点业务子公司的债权融资、支持旗下参控股子公司融资；继续实施针对企业与基金的相关产业投资；严格实施内控管理制度，强化审计监督，强化法务培训，系统识别、分析和防范各类经营风险；通过制度完善、管理提升和规范运营，保障公司长期稳健发展。

6、内生与外延发展

公司将根据发展战略的需要，同等重视内生与外延发展。一方面，公司不断加大自主投入、推动内生发展，充分关注并促进各业务板块及各子公司的发展；另一方面，如出现新的合适标的，公司可考虑利用上市资本平台实施并购重组，提高产业链及业务拓展效率，实现跨越式发展。

7、产能储备及产业链延伸

一方面，公司将积极拓展 IC 设计服务、EDA 软件工具、MEMS 纯代工、MEMS 封装测试业务之间的协同效应，在面向芯片设计公司提供不同服务的同时，积极发挥其中单项业务为其他业务协助拓展业务的导入功能。

另一方面，公司将结合 MEMS 纯代工业务中“工艺开发”与“晶圆制造”紧密结合的特点，依托于已建成并持续扩充产能的北京亦庄 MEMS 量产线，继续建设面向现实及未来需求的规模量产线；同时推动建设怀柔 MEMS 中试线，通过提供工艺开发及小批量代工服务，为 MEMS 规模量产线储备并导入相应的客户及产品，最终提高公司的综合工艺开发及规模量产能力。

此外，基于公司既有 MEMS 制造业务基础、客户制造封装一体化需求，初步打造的 MEMS 封装测试能力，面向硅麦克风、压力、惯性、光学、RF、生物医药等 MEMS 器件提供集成封装与测试服务，最终目标是实现为客户提供包括 IC 设计

服务及 EDA 工具、工艺开发、晶圆制造、封装测试在内的一站式服务。

（四）可能面对的风险因素

1、MEMS 业务收入下降风险

公司重大资产出售交割完成后，瑞典 Sillex 由公司全资子公司变为参股子公司，不再纳入公司合并报表。2023-2025 年，瑞典 Sillex 业务收入占公司 MEMS 业务收入的比例分别为 85.56%、82.69%、77.72%，本次控制权出售后，瑞典 Sillex 的收入不再纳入公司合并范围，静态情形下将导致公司 MEMS 业务收入规模大幅下降。

应对措施：公司将拓展及巩固赛莱克斯北京 MEMS 纯代工业务及展诚科技 IC 设计服务业务，进一步聚焦和投入于国内核心业务，集中资源重点发展并深化运营北京亦庄 MEMS 量产线，持续深入推进研发创新、科技合作，并加快拓展下游市场，积极响应客户需求，全力推进工艺开发及产品验证，持续推动项目的落地和产出，通过多种方式实现公司总体的营收增长及高质量可持续发展。

2、业务协同不及预期风险

2025 年 9 月，公司完成对展诚科技 56.24% 股权的收购，本次交易完成后公司合计持有展诚科技 61.00% 股权，通过本次交易公司拓展了 IC 设计服务业务。得益于集成电路行业总体行业的发展以及展诚科技在 IC 设计服务领域领先的行业地位，展诚科技 IC 设计服务业务发展势头良好，但公司收购展诚科技还旨在进一步拓展和深化在 MEMS 纯代工、IC 设计服务领域的战略布局，即依托展诚科技在 IC 设计服务领域积累的产业资源，以“MEMS+”模式推动双方业务发展，促进公司半导体服务产业生态协同，进一步提升公司综合竞争实力、行业地位和竞争力。若公司未能有效应对与展诚科技在企业文化、技术体系差异、业务整合管理等可能的多重协同整合影响因素，双方业务或将难以高效协同，因此在未来一段时间内，存在公司与展诚科技业务协同不及预期的风险。

应对措施：其一，公司将推进企业文化融合，通过共同培训、团队共建、利益共享等，形成积极向上、团结互信、目标一致的企业文化，为后续强化技术协同、优化整合管理提供坚实的文化支撑；其二，公司将强化技术协同，推动 IC 设计服务与 MEMS 纯代工业务的有机结合，形成业务的相互促进及客户导入；其三，公司将优化整合管理，制定分层推进的整合计划，建立常态化沟通机制，通过派驻管理人员、调整董事会结构等方式强化管控，推动双方在业务流程、管理体系上的高效衔接。

3、国际局势及汇率波动风险

自二战之后，特别是上世纪八九十年代以来，全球化发展日益加速，已成为时代发展的重要特征和显著标志，国家之间在经济、政治、文化、社会等方面的交流程度大幅提升，在加速科技进步和生产力发展的同时，也使得民族国家的利益面临着多元化的冲击和挑战，最终导致民族主义情绪的累积并在近年来显著抬头，右翼民粹主义、反全球化主义、贸易保护主义、本土主义等主张在全球，尤其是欧美国家泛起，引发国际局势紧张及日趋复杂化，对跨国经营的企业提出诸多新的挑战。公司同时持有境内外资产及业务，近年来直接源自境外营业收入的比例较高，2023-2025 年的比例分别为 50.04%、59.28%、60.88%，虽然公司在报告期后已完成瑞典 Sillex 控制权出售的交割，但公司持有外币资产且部分原材料采购以及 MEMS 业务的部分机器设备采购仍涉及外币结算，日常涉及美元、欧元、瑞典克朗、日元、人民币等货币。因此，公司日常经营活动客观上面临着国际政治经济局势剧烈变化的风险，随之而来的还包括因汇率大幅波动对公司报表业绩（以人民币计算）产生较大影响的风险。

应对措施：公司将密切关注业务所涉及各主要币种的汇率变化，积极开展外汇衍生品交易进行风险对冲，尽可能地控制因汇率变动对公司财务及业务所造成的影响。

4、新兴行业的创新风险

公司 MEMS 主业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，同时也是国家“十五五”规划中的科技前沿攻关

领域，该产业技术进步及迭代迅速，要求行业参与者不断通过新技术/工艺的研究和新产品的开发以应对下游需求的变化。如公司对新技术/工艺、新产品的投入不足，或投入方向偏离行业创新发展趋势或未能符合重要客户需求的变化，将会损害公司的技术优势与核心竞争力，从而给公司的市场竞争地位和经营业绩带来不利影响；此外，近年来，公司研发费用支出的绝对金额以及占营业收入的比重均处于高位，2023-2025 年，公司研发费用分别高达 3.57 亿元、4.55 亿元、3.93 亿元，占营业收入的比重分别高达 27.44%、37.75%、47.66%，而研发活动本身存在一定的不确定性，公司还存在研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力的创新风险。

应对措施：公司将一如既往地重视创新，在创新决策环节充分论证，以市场为第一导向，重视平衡创新的前瞻性与风险性；在创新实施环节优化创新组织机制，充分发挥技术创新人员的创新积极性，提高实施过程中的管理效率，并重视财务资金的合理筹划与风险管理。

5、行业竞争加剧的风险

公司 MEMS 主业直接参与全球竞争，竞争对手既包括博世、惠普、意法半导体、德州仪器等 IDM 企业，也包括 Teledyne、台积电、X-FAB、索尼、Atomica 等境外代工企业，以及芯联集成、广州增芯、上海先进、华虹宏力、华润微、士兰微、华鑫微纳等含 MEMS 业务的境内企业；IC 设计服务及 EDA 工具服务竞争对手包括创意电子、智原科技、灿芯股份、创耀科技、芯原股份、华大九天、概伦电子、广立微、行芯科技等。MEMS 属于技术、智力及资金密集型行业，涉及电子、机械、光学、医学等多个专业领域，技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响企业核心竞争力的关键因素。若公司不能正确判断未来市场及产品竞争的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。

应对措施：公司将继续加大研发投入与人才建设，在优势业务领域不断优化产品性能及丰富产品品类，扩大竞争优势；在新进业务领域，充分利用资本平台，发挥融资及扩张优势，尽快取得竞争优势。同时，注重分析公司产品在不同应用领域的市场特点，提高市场响应效率，同等重视国内与国际市场。

6、业务转型引致的管理风险

近年来，公司进行了重大战略转型，并于报告期内完成 IC 设计服务为主要业务的展诚科技收购，形成以半导体为核心的业务格局，MEMS 成为分处不同发展阶段、聚焦发展的战略性业务，公司国际化程度也日益提升。虽然公司已积累一定的管理经验，努力建立适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度，根据变化持续补充、加强国际化经营管理团队，但上述战略与业务层面的转型幅度较大、速度较快，对公司运营管理水平提出了较高要求；随着资产、业务、机构和人员规模的结构化扩张，资源配置和内控管理的复杂度不断上升，公司现有管理架构、流程和团队可能无法完全适应业务发展所带来的变化。公司存在管理水平不能适应业务转型的风险，存在管理制度不完善导致内部约束不健全的风险。

应对措施：公司将根据发展现状，及时优化治理结构与制度，通过集团化管理，明确分工与授权，提升管理效率，不断完善各岗位职责，强化管理层的责任和担当意识，增强对各子公司的有效管控。公司将考虑采用行之有效的激励机制，吸引和留住优秀管理人才和核心骨干，并通过多种渠道引进人才，优化人才梯队结构，有效降低业务发展带来的管理风险。

7、投资并购风险

近年来，公司已完成多起投资并购，投资控股或参股了多家公司、参与了部分产业基金的投资，但同时一些收购境外产线资产的交易也因非商业因素而遗憾失败。根据发展战略的需要，公司未来可能会实施新的并购重组或投资，以提高产业链及业务拓展效率，实现跨越式发展。如果将来选择的投资并购标的不恰当、所投资公司发展方向偏差、所合作核心团队出现不利变动，或者投资并购完成后未能做好资源及业务整合，以及再次受到非商业因素的影响，将存在投资并购的目标不能实现或不能完全实现的风险，亦存在着可能的商誉减值风险。

应对措施：公司将立足于长期发展战略规划，围绕公司所处行业的特点，结合公司实际情况，制定符合可持续发展的投资规划，并选择合适的并购方式对公司现有业务补充完善、优化整合，同时，加强投后管理工作，对已有的经营制度、管理模式和管理团队进行提升，保证公司的管理水平有效的满足各项业务的发展需要，促进公司治理、生产经营的协同发展，实现公司及并购标的高质量发展。

8、政府补助风险

公司 MEMS 业务在国际上属于新兴科技创新领域，在我国也属于国家鼓励发展的高科技行业（于 2021 年 3 月被纳入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中的科技前沿攻关领域）。近年来，公司已陆续获得数笔与主营业务相关的政府补助。2023-2025 年，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 1.07 亿元、0.21 亿元、0.06 亿元，占当期利润总额绝对值的比例分别为 335.69%、8.27%、0.46%，对 2023-2025 年公司经营业绩构成重大影响。虽然通过政策支持、资金补贴、税收优惠和低息贷款等措施大力支持半导体行业（尤其是半导体制造环节）的发展属于国际通行做法，但公司在后续财务报告期间能否持续取得政府补助、涉及多少金额、会计处理方法等均存在不确定性，因此公司存在经营业绩受政府补助影响、影响大小不确定的风险。

应对措施：一方面，公司将努力提升产能及产能利用率、提升良率，扩大半导体业务体量，提高主营业务盈利能力；另一方面，公司将继续积极争取适用于主营业务的政府补贴及税收优惠。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025 年 01 月 24 日	赛微电子北京 MEMS 产业基地会议室	实地调研	机构	Obeikan Investment Group（沙特奥贝坎投资集团）、Imtiaz Mahtab（风投主管）	主要了解公司的概况和业务发展情况。	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/300456 赛微电子投资者关系管理信息 20250124
2025 年 03 月 21 日	北京经济技术开发区科创八街 21 号院赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司 205 会议室	实地调研	机构、个人	国信证券、海通证券、国君资管、鸿竹资产、个人投资者、银华基金、华福证券、华能信托、中电科投资、李蕊、周硕、孙博谦	主要了解公司的概况和业务发展情况。	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/300456 赛微电子投资者关系管理信息 20250321
2025 年 03 月 25 日	线上交流	网络平台线上交流	其他	参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者	主要了解公司的概况和业务发展情况。	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/300456 赛微电子投资者关系管理信息 20250325
2025 年 08 月 05 日	赛微电子北京 MEMS 产业基地五楼会议室	实地调研	机构	华福证券	主要了解公司的概况和业务发展情况。	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/300456 赛微电子投资者关系管理信息 20250805

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，并结合公司实际情况，公司已制定了《市值管理制度》。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为扎实提升公司质量和投资价值，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者，从聚焦主业发展，打造国际化经营的知名半导体制造领先企业；坚持自主研发，掌握核心技术；夯实公司治理，实现高质量发展；加强投资者沟通，提升信息披露质量；重视股东回报，共享发展成果五个方面制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

报告期内，公司继续聚焦 MEMS 主业发展，持续推动从工艺开发向验证、试产、量产阶段推进，涉及产品范围覆盖了通信计算、生物医药、工业汽车、消费电子等诸多应用领域。公司已初步构建 MEMS 封装测试能力，前瞻性布局 IC 设计服务与 EDA 工具服务，致力于为客户提供从设计服务及 EDA 工具、工艺开发、晶圆制造到封装测试的一站式综合服务，并将着重立足本土，拓展国际化运营；公司坚持自主创新战略，2025 年继续保持了较高的研发强度，未来，公司将继续重视技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障，努力实现在 MEMS 主业方面的技术及业务突破；公司不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度，持续提升规范运作水平；持续加强投资者关系管理，积极与投资者进行沟通交流，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念。

未来，公司将一如既往坚持以投资者为本的理念，积极落实“质量回报双提升”行动方案，促进公司长远健康可持续发展，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司的治理活动，进一步提高了公司治理水平并促进了公司的规范运作。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东与股东会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》以及深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范地召集、召开股东会，严格遵循表决程序。在报告期内，公司召开的股东会均邀请了见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。公司在召开股东会时，均做到平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东会提供便利，保证出席现场会议的各位股东有充分的发言权，使其充分行使股东权利，特别是保证中小股东能够充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人为自然人杨云春先生，担任公司的董事长。作为控股股东、实际控制人，杨云春先生严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求规范自己的行为，依法行使权力并承担相应的义务，不存在超越股东会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，亦无控股股东占用公司资金以及公司为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系，公司董事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会共有 7 名董事，其中包括 3 名独立董事，下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会及成员能够根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管理办法》《董事会议事规则》等制度运作并开展工作，出席董事会和股东会，忠实、勤勉尽责地履行职责和义务，并积极参加相关培训，不断提高履职能力，推动公司健康稳定发展。

4、绩效评价与激励约束机制

公司不断完善公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制，公司高管人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬体系。公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管规定和《公司章程》等制度的相关规定执行，符合法律、法规的规定。

5、信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保所有投资者公平获取公司信息，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》《证券日报》作为公司信息披露的报纸。根据《投资者关系管理制度》《公司章程》等有关规定，设立了电话专线与专用

邮箱，通过“互动易”、投资者电话以及召开业绩说明会、投资者调研等积极回复投资者关心的问题，加强与投资者的沟通，促进了投资者对公司的了解和认同。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东会讨论确定，不存在不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

1、业务独立情况

公司业务体系完整，独立自主经营，不依赖于控股股东、实际控制人及其他关联方，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间同业竞争的情形。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

2、人员独立情况

公司的董事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序进行，不存在控股股东、实际控制人越权作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3、资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

4、机构独立情况

公司建立健全了股东会、董事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司

不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
杨云春	男	57	董事长	现任	2011年09月23日	2026年09月21日	179,076,719				179,076,719	
杨云春	男	57	总经理	离任	2020年09月11日	2025年04月10日						
张帅	男	41	董事	现任	2021年08月25日	2026年09月21日						
王玮冰	男	49	董事	现任	2023年09月22日	2026年09月21日						
张阿斌	男	41	董事会秘书	现任	2015年09月15日	2026年09月21日	327,906		81,977		245,929	减持
张阿斌	男	41	董事	现任	2020年09月11日	2026年09月21日						
张阿斌	男	41	总经理	现任	2025年04月10日	2026年09月21日						
张阿斌	男	41	副总经理	离任	2015年09月15日	2025年04月10日						
张阿斌	男	41	财务总监	离任	2023年09月22日	2025年04月10日						
王玮	男	49	独立董事	现任	2023年09月22日	2026年09月21日						
刘婷	女	43	独立董事	现任	2020年04月27日	2026年04月26日						
付三中	男	58	独立董事	现任	2023年09月22日	2026年09月21日						
Yuan Lu	男	69	副总经理	现任	2023年09月22日	2026年09月21日						
周家玉	女	55	副总经理	现任	2020年09月	2026年09月	25,000		6,000		19,000	减持

					月 11 日	月 21 日						
刘波	男	40	副总经理	现任	2020 年 09 月 11 日	2026 年 09 月 21 日	255,784		63,900		191,884	减持
许骥	男	36	财务总监	现任	2025 年 04 月 10 日	2026 年 09 月 21 日						
合计	--	--	--	--	--	--	179,685,409	0	151,877		179,533,532	--

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

报告期内，为进一步聚焦公司发展战略及顶层设计，杨云春先生不再担任总经理职务；因工作调整，张阿斌先生不再担任公司副总经理、财务总监职务。

公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨云春	总经理	离任	2025 年 04 月 10 日	工作调动
张阿斌	副总经理、财务总监	离任	2025 年 04 月 10 日	工作调动
张阿斌	总经理	聘任	2025 年 04 月 10 日	工作调动
许骥	财务总监	聘任	2025 年 04 月 10 日	工作调动

2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、杨云春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 9 月出生，美国加州大学河滨分校电子工程博士。1993 年 7 月至 1998 年 2 月任央企工程师；1998 年 3 月至 2007 年 12 月在境外求学及工作；2008 年初归国创业，2008 年 5 月至 2015 年 9 月历任公司执行董事、总经理；2011 年 9 月至今任公司董事长；2020 年 9 月至 2025 年 4 月兼任公司总经理；现同时担任了公司下属参控股子公司董事长、执行董事兼总经理、董事，合伙企业投资委员会委员等职务，并同时兼任了其他单位的执行董事、经理等职务。

2、张帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月出生，英国南安普敦大学微电子系统设计专业硕士。2008 年至 2020 年任职于国家开发银行；2020 年 8 月至今任职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资一部副总经理、投资二部副总经理、业务二部总经理；2022 年 3 月至今任公司控股子公司赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司董事；2021 年 8 月至今任公司董事。

3、王玮冰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，中国科学院微电子研究所工学博士。2005 年至今历任中国科学院微电子研究所副研究员、研究员；2017 年 8 月至今任北京中科赛微电子科技有限公司董事、总经理；2023 年 9 月至今任公司董事。

4、张阿斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 11 月出生，天津财经大学经济学硕士(金融学专业)。2011 年 7 月至 2015 年 8 月任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部经理；2015 年 9 月至今任公司副总经理、投融资总监；2015 年 12 月至今任公司董事会秘书；2020 年 9 月至今任公司董事；2023 年 9 月至 2025 年 4 月任公司财务总监；2025 年 4 月至今任公司总经理。现同时担任了瑞典 Sillex 等公司下属参控股子公司董事、合伙企业执行事务合伙人代表、投资委员会委员等职务。

5、王玮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，清华大学航天航空学院博士，主要从事MEMS(微机电系统)、聚合物微纳加工方法、临床微纳系统相关研究。2005年4月至2007年4月，在北京大学信息科学技术学院从事博士后研究；2007年4月至2009年8月北京大学信息科学技术学院讲师；2009年8月至2016年8月任北京大学信息科学技术学院副教授；2016年8月至2021年7月任北京大学信息科学技术学院教授；2021年7月至今任北京大学集成电路学院教授；2020年12月至今任微米/纳米加工技术国家级重点实验室(现微米纳米加工技术全国重点实验室)主任；2022年4月至今任北京大学集成电路学院副院长；2022年12月至今任深圳硅基仿生科技有限公司独立董事；2023年9月至今任公司独立董事。

6、刘婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，中国人民大学博士。2010年7月至今历任北京工商大学商学院会计系讲师、副教授、教授，会计硕士专业学位(MPAcc)中心执行主任、国际交流与认证中心执行主任、国际认证中心主任；AAIA(国际会计师公会全权会员)，ESG高级分析师。现同时兼任财政部企业会计准则咨询委员会委员、中国会计学会政府及非营利组织专业委员会委员、中国管理现代化研究会管理思想与商业伦理专业委员会理事、教育部高校科学研究发展中心评审专家、中国卫生经济学会青年卫生经济分会常务理事、《财务管理研究》编委；2019年5月至2021年9月任正星科技股份有限公司独立董事；2022年11月至今任承德露露股份公司独立董事；2023年11月至2024年10月任北京德风新征程科技股份有限公司独立董事；2020年4月至今任公司独立董事。

7、付三中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，中国对外经济贸易大学工商管理硕士。1991年7月至1995年5月，在国家机电轻纺投资公司办公厅条法处工作；1995年5月至2002年10月，先后任职于国家开发投资公司办公厅、综合计划部、经营部、金融部、战略投资部等部门；2002年11月至2018年4月任北京观韬律师事务所高级合伙人；2018年4月至今任北京市兰台律师事务所高级合伙人；2023年9月至今任公司独立董事。

(二) 高级管理人员

1、杨云春，简历见“(一) 董事会成员”

2、Yuan Lu，男，美籍华人，1957年7月出生，美国韦恩州立大学材料科学与工程博士，一直从事半导体制造、MEMS与IC集成、三维晶圆级封装、超细间距IC互连，超高速光电器件与IC集成等研发工作。1983年9月至1991年8月在西南大学任教；1991年9月至2012年1月在美国求学及工作；2012年2月至2017年10月任中国科学院微电子研究所研究员；2017年11月至2023年9月任赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司首席科学家；2023年9月至今任公司副总经理、首席科学家。

3、张阿斌，简历见“(一) 董事会成员”

4、周家玉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，首都经贸大学企业管理专业硕士。1996年7月至1998年5月任中央电视台经济频道《经济半小时》栏目记者；1998年5月至2003年9月历任中国普天集团东方通信股份有限公司北京代表处政府关系经理、办事处主任；2003年10月至2007年10月任广东北电通信设备有限公司北京代表处主任；2007年10月至2015年5月历任合益管理咨询(上海)有限公司(Hay Group)公共关系总监、Back office leader，咨询总监；2009年8月至今任北京嘉阳信通科技发展有限公司执行董事、经理；2017年5月至今任公司人力资源总监；2020年5月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司董事；2020年9月至今任公司副总经理。

5、刘波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，清华大学与法国国立民用航空大学硕士；2010年10月至2023年9月任公司证券事务代表；2020年9月至今任公司副总经理；2024年4月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司董事，现同时担任了公司下属控股子公司董事等职务。

6、许骥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 8 月出生，复旦大学工商管理硕士，中国注册会计师。2012 年 10 月至 2018 年 5 月任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计部经理；2019 年 5 月至 2021 年 5 月任新希望集团有限公司财务部高级经理；2021 年 9 月至 2023 年 6 月在复旦大学攻读工商管理硕士学位(全日制)；2023 年 12 月至 2025 年 4 月历任公司财务高级经理、财务副总监，2025 年 4 月至今任公司财务总监。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨云春	武汉迈普时空导航科技有限公司	执行董事	2015 年 12 月 24 日		否
杨云春	烟台四季千人专家创业园有限公司	执行董事	2016 年 11 月 10 日		否
杨云春	北京新丝路创新科技有限公司	执行董事	2016 年 11 月 22 日		否
杨云春	青州锐达电子科技合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017 年 02 月 06 日		否
杨云春	青州锐达电子科技有限公司	执行董事	2017 年 02 月 27 日		否
杨云春	青州新丝路通用航空有限公司	执行董事	2017 年 04 月 19 日		否
杨云春	新丝路(天津)租赁有限公司	董事长	2017 年 04 月 25 日		否
杨云春	海创智能装备(烟台)有限公司	执行董事	2017 年 09 月 13 日		否
杨云春	海南四季协同创新研究院有限公司	董事	2017 年 10 月 13 日		否
杨云春	北京丝路通用航空有限公司	董事长	2017 年 10 月 26 日		否
杨云春	青岛千山创新科技有限公司	执行董事	2018 年 04 月 27 日		否
杨云春	北京海创新时代科技中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2018 年 06 月 06 日		否
杨云春	青岛聚能创芯微电子有限公司	董事长, 总经理	2018 年 07 月 02 日		否
杨云春	青岛创千投资管理有限公司	执行董事	2018 年 07 月 30 日		否
杨云春	北京海创新时代产业技术有限公司	董事	2018 年 10 月 26 日		否
杨云春	烟台晶格检测技术有限公司	董事长	2018 年 11 月 05 日		否
杨云春	潍坊星达信息科技有限公司	监事	2018 年 12 月 24 日		否
杨云春	北京世纪东晟科技有限公司	董事	2019 年 08 月 21 日		否
杨云春	久实融资租赁有限公司	董事	2020 年 06 月 18 日		否
杨云春	海南致静航空有限责任公司	董事	2020 年 09 月 18 日		否

	公司				
杨云春	海南依迈科技有限公司	执行董事	2020年09月22日		否
杨云春	北京耐威科技有限公司	执行董事	2021年12月23日		否
杨云春	广州海慧科金技术服务 有限公司	董事	2022年03月01日		否
杨云春	深圳赛莱创晶科技合 伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2023年05月17日		否
杨云春	四川华创芯源微电 子有限公司	执行董事	2023年12月08日		否
杨云春	北京芯东来半导体 科技有限公司	董事	2025年12月30日		否
杨云春	上海海桐合创科技 有限公司	董事	2024年11月13日		否
杨云春	湖州智韵科技有限 公司	董事	2024年11月18日		否
杨云春	北京海创众智科技 产业中心（有限合 伙）	执行事务合伙人	2025年12月19日		否
杨云春	海南巨先投资合伙 企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2025年04月25日		否
张帅	华芯投资管理有限 责任公司	投资一部、二部 副总经理，业务 二部总经理	2020年08月03日		是
张帅	深圳佰维存储科技 股份有限公司	董事	2021年09月01日	2025年10月17 日	否
张帅	英韧科技股份有限公司	监事	2023年01月16日		否
张帅	苏州华太电子技术 股份有限公司	董事	2023年03月17日	2025年01月03 日	否
张帅	北京奕斯伟计算技 术股份有限公司	董事	2023年08月07日		否
张帅	北京华大九天科技 股份有限公司	董事	2023年12月12日		否
张帅	上海合见工业软件 集团有限公司	董事	2024年06月30日		否
张帅	深圳鸿芯微纳技术 有限公司	董事长	2024年04月30日	2026年01月27 日	否
张帅	上海燧原科技股份 有限公司	董事	2025年12月26日		否
张帅	芯迈半导体技术（杭 州）股份有限公司	董事	2025年04月29日		否
王玮冰	中国科学院微电子 研究所	研究员	2005年01月01日		是
王玮冰	北京迈领科技合伙 企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年02月14日		否
张阿斌	湖北北斗产业投资 基金管理有限公司	董事	2018年07月05日		否
张阿斌	北京思丰可科技有 限公司	董事	2021年09月22日		否
王玮	北京大学集成电路 学院	教授	2021年07月01日		是
王玮	北京大学集成电路 学院	副院长	2022年04月08日		是
王玮	深圳硅基仿生科技 有限公司	独立董事	2022年12月08日		是
刘婷	北京工商大学商学 院会计系	教授	2010年07月02日		是
刘婷	承德露露股份公 司	独立董事	2022年11月12日		是
付三中	北京市兰台律师事 务所	高级合伙人	2018年04月01日		是
周家玉	北京嘉阳信通科技 发展	执行董事、经理	2009年08月25日		否

	有限公司				
周家玉	武汉光谷信息技术股份有限公司	董事	2020年05月15日		否
刘波	丝路征和（天津）飞机租赁有限公司	执行董事	2017年08月14日		否
刘波	丝路太初（天津）飞机租赁有限公司	执行董事	2017年08月14日		否
刘波	丝路元鼎（天津）飞机租赁有限公司	执行董事	2017年08月16日		否
刘波	丝路龙朔（天津）飞机租赁有限公司	执行董事	2018年11月06日		否
刘波	丝路贞观（天津）飞机租赁有限公司	执行董事	2018年11月06日		否
刘波	丝路麟德（天津）飞机租赁有限公司	执行董事	2018年11月06日		否
刘波	丝路永徽（天津）飞机租赁有限公司	执行董事	2018年11月06日		否
刘波	武汉光谷信息技术股份有限公司	董事	2024年04月17日		否
刘波	丝路永隆（天津）飞机租赁有限公司	执行董事	2024年09月14日		否

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议，于 2025 年 4 月 10 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，经薪酬与考核委员会审核，公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由工资及奖金构成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。同时，在公司任职的非独立董事不从公司领取董事薪酬。

2、未在公司任职的非独立董事领取公司固定董事薪酬人民币 6 万元/年（税前）。公司现任董事张帅先生、王玮冰先生不从公司领取董事薪酬。

3、公司独立董事领取公司固定独立董事薪酬人民币 12 万元/年（税前）。

4、公司董事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩规定发放。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨云春	男	57	董事长	现任	116.32	否
张帅	男	41	董事	现任	0	否
王玮冰	男	49	董事	现任	0	否
张阿斌	男	41	董事、总经理、董事会秘书	现任	114.81	否
王玮	男	49	独立董事	现任	12	否
刘婷	女	43	独立董事	现任	12	否
付三中	男	58	独立董事	现任	12	否
Yuan Lu	男	69	副总经理	现任	104.07	否

周家玉	女	55	副总经理	现任	98.28	否
刘波	男	40	副总经理	现任	92.29	否
许骥	男	36	财务总监	现任	73.81	否
合计	--	--	--	--	635.58	--

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	完成
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	不适用
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

其他情况说明

适用 不适用

七、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨云春	12	6	6	0	0	否	4
张帅	12	0	12	0	0	否	4
王玮冰	12	10	2	0	0	否	4
张阿斌	12	12	0	0	0	否	4
王玮	12	3	9	0	0	否	4
刘婷	12	11	1	0	0	否	4
付三中	12	6	6	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
张帅	《关于拟购买北京芯东来半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》	拟受让企业后续增资情况尚未确定，无法合理论证关联交易价格公允性，故弃权表决。
张帅	《关于拟使用自有资金进行证券投资的议案》	由于本次上市公司证券投资金额较大，暂未有明确投资方向，风险较大，故反对表决。
张帅	《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》	由于证券投资业务性质较为敏感，且公司暂无配套风控流程，认为风险较大，故反对表决。
董事对公司有关事项提出异议的说明	1、拟受让企业后续增资情况尚未确定，无法合理论证关联交易价格公允性，故	

	<p>弃权表决。</p> <p>2、由于本次上市公司证券投资金额较大，暂未有明确投资方向，风险较大，故反对表决。</p> <p>3、由于证券投资业务性质较为敏感，且公司暂无配套风控流程，认为风险较大，故反对表决。</p>
--	--

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》及中国证监会的要求，忠实勤勉地履行董事职责，关注公司运作，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并根据公司实际情况对公司内部控制建设、管理体系建设和经营发展建言献策。公司独立董事积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告等事项发表了明确意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	刘婷、王玮、付三中	9	2025年01月20日	审议《关于〈内部控制管理手册〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过所有议案。		不适用
审计委员会			2025年03月14日	审议《关于〈2024年内部审计报告及2025年内部审计工作计划〉的议案》、《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2024年年度审计报告〉的议案》、《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过所有议案。		不适用

				<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
审计委员会			2025 年 04 月 10 日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过所有议案。		不适用
审计委员会			2025 年 04 月 23 日	审议《关于<2025 年第一季度内部审计报告>的议案》、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过所有议案。		不适用
审计委员会			2025 年 08 月 22 日	审议《关于<2025 年半年度内部审计报告>的议案》、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于控股股东为公司及子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供关联担保的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过所有议案。		不适用
审计委员会			2025 年 09 月 10 日	审议《关于控股股东为全资子公司申请银行并购贷款提供关联担保的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过所有议案。		不适用
审计委员会			2025 年 10	审议《关于<2025	审计委员会严格		不适用

			月 27 日	年第三季度内部审计报告>的议案》、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》	按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过所有议案。		
审计委员会			2025 年 11 月 18 日	审议《关于拟购买北京芯东来半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于拟使用自有资金进行证券投资的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过所有议案。		不适用
审计委员会			2025 年 12 月 05 日	审议《关于控股股东为公司申请银行并购贷款及为控股子公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过所有议案。		不适用
提名委员会	王玮、付三中、杨云春		2025 年 04 月 10 日	1 审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过所有议案。		不适用
薪酬与考核委员会	刘婷、付三中、杨云春		2025 年 03 月 14 日	2 审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过相关议案。		不适用
薪酬与考核委员会			2025 年 07 月 16 日	审议《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过相关议案。		不适用
战略与 ESG 委	杨云春、张		4 2025 年 03	审议《关于 2025	战略与 ESG 委员		不适用

员会	帅、王玮		月 14 日	年度公司发展战略的议案》、《关于〈2024 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告〉的议案》	会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过相关议案。		
战略与 ESG 委员会			2025 年 06 月 13 日	审议《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》（逐项审议）、《关于〈北京赛微电子股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议案》、《关于本次重大资产出售定价的意见及公平合理性说明的议案》、《关于本次重大资产出售签署附生效条件〈股份买卖协议〉的议案》、《关于公司本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条的相关规定的议案》、《关于公司本次重大资产出售相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》、《关于公司本次重大资产出售符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定	战略与 ESG 委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过相关议案。		不适用

				的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于公司重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》、《关于本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产的议案》、《关于本次重大资产重组中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》、《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》、《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的议案》、《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的议案》			
战略与 ESG 委员会			2025 年 06 月 30 日	审议《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》	战略与 ESG 委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通过相关议案。		不适用
战略与 ESG 委员会			2025 年 08 月 19 日	审议《关于收购青岛展诚科技有限公司 56.24% 股权的议案》	战略与 ESG 委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对相关议案进行核查审议，一致通		不适用

					过相关议案。		
--	--	--	--	--	--------	--	--

九、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

十、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	50
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	985
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,035
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,035
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	124
销售人员	16
技术人员	793
财务人员	27
行政人员	75
合计	1,035
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	50
硕士	124
本科	613
大专及其他	248
合计	1,035

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度；公司退休职工费用由社会统筹，无需公司承担。

3、培训计划

公司各部门根据自身情况，经过需求调查以及往年的培训结果反馈，编制各部门年度培训计划，并报人力资源部备案。公司人力资源部每年根据需求制定对相关岗位人员的年度培训计划，报公司批准后执行。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	276,380.19
劳务外包支付的报酬总额（元）	12,455,170.56

十一、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司分别于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第十三次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，2024 年利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	不适用
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.70
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	732,213,134
现金分红金额（元）（含税）	270,918,859.58
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	270,918,859.58
可分配利润（元）	307,518,011.33
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润为 1,388,434,832.63 元，其中归属于母公司股东的净利润为 1,473,454,069.63 元，以前年度累计未分配利润 254,074,064.86 元，并提取 31,630,363.03 元的盈余公积后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 1,704,231,080.21 元。母公司 2025 年度实现净利润	

316,303,630.30 元，年初未分配利润 22,839,435.31 元，并提取 31,630,363.03 元的盈余公积后，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 307,518,011.33 元。
本报告期利润分配预案为：公司拟以目前总股本 732,213,134 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 3.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司已建立一套较为完整且持续有效运行的内控体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
青岛展诚科技有限公司	资产、人员、财务、业务等方面全部纳入公司统一管理。	已完成整合。	不适用	不适用	不适用	不适用

对子公司的管理控制存在异常

是 否

十五、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026 年 03 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合	100.00%

并财务报表营业收入的比例		缺陷认定标准	
类别	财务报告	非财务报告	
定性标准	<p>重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：</p> <p>①董事和高级管理人员舞弊；</p> <p>②当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>③内部审计对财务报告的内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重要缺陷：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>具备以下特征的缺陷，视影响程度可认定为重大缺陷或重要缺陷：</p> <p>①公司决策程序不科学，导致出现重大失误；</p> <p>②公司严重违反国家法律法规并受到处罚；</p> <p>③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：除认定为上述重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。</p>	
定量标准	<p>1) 重大缺陷：缺陷影响超过合并财务报表净资产的 5%；超过合并财务报表利润总额的 10%。</p> <p>2) 重要缺陷：缺陷影响达到或超过合并财务报表净资产的 1%，但不超过 5%；达到或超过合并财务报表利润总额的 5%，但不超过 10%。</p> <p>3) 一般缺陷：缺陷影响低于合并财务报表净资产的 1%；低于合并财务报表利润总额的 5%。金额标准按照绝对值认定，以净资产和利润总额孰低的原则确定重要性水平。</p>	非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。	
财务报告重大缺陷数量（个）	0		
非财务报告重大缺陷数量（个）	0		
财务报告重要缺陷数量（个）	0		
非财务报告重要缺陷数量（个）	0		

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，赛微电子于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2026 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十六、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

十七、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司	https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home

十八、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

1、公司高度重视对投资者的合理投资回报，制定“质量回报双提升”行动方案，维护投资者合法权益。公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司建立了稳定的利润分配政策，积极回报广大投资者，与投资者共同分享企业发展成果。

2、公司坚持平等雇佣原则，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及国际劳工组织核心公约，制定《员工手册》《招聘管理办法》等规章制度，致力于构建公平、透明且无歧视的职场环境。公司深知公平与多样性对企业发展的重要性，坚决消除一切形式的就业歧视，并持续建设多元化的员工队伍。公司员工队伍多元化，汇聚了来自不同国家和文化背景的优秀人才，包括经验丰富的工程技术人员、海外技术专家等，尊重员工的个性化需求并提供相应支持。

3、公司在自身发展的同时，积极履行社会责任。公司充分利用行业资源与技术优势，为高校学子提供实践平台。多次接待清华、北大、北理工等顶尖高校的师生，分享行业知识和企业发展经验，帮助学子拓宽视野，增强理论与实践相结合的能力，推动产学研深度融合，促进行业人才培养。

4、公司还积极参与社区发展，增进社区福祉，关注慈善公益事业，组织员工开展志愿服务活动、“共产党员献爱心”捐献活动；坚持长期艰苦奋斗，通过各种方式，努力实现在 MEMS 主业方面的技术及业务突破，助力解决半导体高科技领域部分“卡脖子”问题，创造经济和税收效益。2025 年，公司荣获“北京民营企业科技创新百强”、“2025 北京制造业企业百强”等奖项，以及“国证 ESG 评级 AA 级”、“Wind ESG 评级 A 级”。

十九、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内未开展相关活动，未来将结合公司业务发展的实际情况开展相关工作。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	北京赛微电子股份有限公司	其他承诺	<p>一、关于提供信息真实、准确、完整的承诺</p> <p>1、本公司将及时向参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺；本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、文件均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本公司为本次交易所出具的确认、说明或承诺均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>4、在本次交易期间，本公司将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，及时提交及披露有关本次交易的信息、文件及资料，本公司保证本次交易的信息披露和提交文件的内容均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>5、本公司对所提供的信息、资料、文件以及所出具相关的确认、说明或承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> <p>二、关于合规诚信情况的承诺</p> <p>1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查、正被其他有权部门调查等情形。</p> <p>2、本公司最近五年未受过刑事处罚或行政</p>	2025年06月13日	长期	正常履行中

			<p>处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；本公司最近五年内不存在被中国证监会采取行政监管措施、受到证券交易所纪律处分或公开谴责的情形，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等重大失信行为或其他证券市场失信行为；最近三年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为。</p> <p>3、截至本函出具日，本公司不存在对本次交易造成或可能造成重大影响的事实或情形。</p> <p>三、关于标的资产权属的承诺</p> <p>1、标的公司为依法设立和有效存续的企业，不存在影响其合法存续的情况；标的公司已取得其设立及经营业务所需的必要审批、同意、授权和许可，且该等审批、同意、授权和许可均为合法有效；</p> <p>2、标的公司的出资真实，不存在股东虚假出资、延期出资、抽逃出资的情形；</p> <p>3、本次交易完成前，本公司的全资控股子公司运通电子有限公司合法拥有标的公司 87.80% 股权，标的公司股权不存在权属纠纷，不存在通过信托持股、委托持股、收益权安排、期权安排、代持或者其他任何代表其他方的利益的情形；标的公司股权不存在抵押、质押等权利受限制的情形，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形；拟转让的标的公司股权不存在尚未了结或本公司可预见的与标的公司股权权属相关的诉讼、仲裁等纠纷；</p> <p>4、本公司承诺本次交易相关协议正式生效后，将根据协议约定和监管部门的要求及时进行标的公司的权属变更。本公司确认上述内容均真实、准确、完整。</p> <p>四、关于不存在内幕交易的承诺</p> <p>1、本公司及本公司控制的机构在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为；</p> <p>2、经自查，本公司及本公司控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。</p>			
资产重组时所作承诺	杨云春	其他承诺	<p>一、关于提供信息真实、准确、完整的承诺</p> <p>1、本人将及时向参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺；本人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准</p>	2025 年 06 月 13 日	长期	正常履行中

		<p>确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、本人向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、文件均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本人为本次交易所出具的确认、说明或承诺均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5、本人对所提供的信息、资料、文件以及所出具相关的确认、说明或承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p> <p>二、关于合规诚信情况的承诺</p> <p>1、截至本函出具日，本人不存在《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。</p> <p>2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查、正被其他有权部门调查等情形。</p> <p>3、本人最近五年未受过刑事处罚或行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；本人最近五年内不存在被中国证监会采取行政监管措施、受到证券交易所纪律处分或公开谴责的情形，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等重大失信行为或其他证券市场失信行为；最近三年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>违法行为。</p> <p>4、截至本函出具日，本人不存在对本次交易造成或可能造成重大影响的事实或情形。</p> <p>三、关于不存在内幕交易的承诺</p> <p>1、本人及本人控制的机构在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为；</p> <p>2、经自查，本人及本人控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。</p> <p>四、关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p> <p>1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、如上市公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p>			
资产重组时所作承诺	杨云春	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于保持上市公司独立性及避免同业竞争的承诺</p> <p>1、本次重大资产出售完成后，本人将继续按照法律、法规、规范性文件的要求，保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。</p> <p>2、截至本承诺函签署之日，本人始终严格履行已作出的关于避免同业竞争的承诺，并未出现违反所作承诺的情形。本次重大资产出售完成后，本人仍将继续履行该承诺，以保障上市公司及上市公司全体股东</p>	2025 年 06 月 13 日	长期	正常履行中

			<p>的利益。</p> <p>3、本承诺函自本人正式签署之日起生效并不可撤销，于本人担任公司控股股东、实际控制人期间持续有效。本人保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本人未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本人将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。</p> <p>二、关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在与公司及其下属公司关联交易违规的情形。</p> <p>2、在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将尽可能避免和减少与公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害公司及其他股东合法权益的行为；如未来公司预计与本人及本人控制的其他企业持续发生交易的，本人将采取有效措施督促公司建立对持续性关联交易的长效独立审议机制、细化信息披露内容和格式，并适当提高披露频率。</p> <p>3、本人违反上述承诺给公司造成损失的，本人将赔偿公司由此遭受的损失。</p>			
资产重组时所作承诺	杨云春	关于股份减持的承诺	<p>截至本承诺出具之日，本人没有减持公司股份的计划。</p> <p>本次交易中，自上市公司本次交易方案首次披露之日起至实施完毕期间（以过户完成为准），本人不存在减持上市公司股份的计划。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，如违反规定进行减持的，本人减持股份所得收益将归上市公司所有，并就此因此给上市公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担全部法律责任。本人若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任并将依法承担因此给公司或其投资者造成的实际损失。</p>	2025年06月13日	2025年7月23日	已履行完毕
资产重组时所作承诺	杨云春;张帅;张阿斌;王玮冰;王玮;刘婷;付三中;罗大杰;赵晗阳;赵利芳;LU YUAN;周家玉;刘波;许骥	关于股份减持的承诺	<p>截至本承诺出具之日，本人没有减持公司股份的计划。本次交易中，自上市公司本次交易方案首次披露之日起至实施完毕期间（以过户完成为准），本人不存在减持上市公司股份的计划。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，如违反规定进行减持的，本人减持股份所得收益将归上市公司所有，并就此因此给上市公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担全部法律责任。</p>	2025年06月13日	2025年7月23日	已履行完毕

			本人若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任并将依法承担因此给公司或其投资者造成的实际损失。			
资产重组时所作承诺	杨云春;张帅;张阿斌;王玮冰;王玮;刘婷;付三中;罗大杰;赵晗阳;赵利芳;LU YUAN;周家玉;刘波;许骥	其他承诺	<p>一、关于提供信息真实、准确、完整的承诺</p> <p>1、本人将及时向参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺；本人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>二、关于合规诚信情况的承诺</p> <p>1、截至本函出具日，本人不存在《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。</p> <p>2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查、正被其他有权部门调查等情形。</p> <p>3、本人最近五年未受过刑事处罚或行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；本人最近五年内不存在被中国证监会采取行政监管措施、受到证券交易所纪律处分或公开谴责的情形，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等重大失信行为或其他证券市场失信行为；最近三年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为。</p> <p>4、截至本函出具日，本人不存在对本次交易造成或可能造成重大影响的事实或情形。</p> <p>三、关于不存在内幕交易的承诺</p> <p>1、本人及本人控制的机构在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为；</p> <p>2、经自查，本人及本人控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。</p>	2025 年 06 月 13 日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	杨云春;张帅;张阿斌;王玮冰;王玮;刘婷;付三中;LU YUAN;周家	其他承诺	<p>关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺：</p> <p>1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约</p>	2025 年 06 月 13 日	长期	正常履行中

	玉;刘波;许骥		束; 3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、如上市公司拟实施股权激励,本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。			
资产重组时所作承诺	Silex Microsystems AB	其他承诺	关于提供信息真实、准确、完整的承诺: 1、本公司保证及时提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料,副本资料或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 4、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果,保证如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。 关于合规诚信情况的承诺: 1、本公司为瑞典依法设立并合法存续的有限责任公司/股份有限公司,具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。 2、本公司及本公司的董事及高级管理人员最近五年内未受过刑事处罚或与证券市场有关的行政处罚,不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。	2025年06月04日	长期	正常履行中

			<p>3、本公司及本公司的董事及高级管理人员最近五年诚信情况良好，最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，不存在其他重大失信行为。</p> <p>4、如违反上述承诺，本公司愿承担相关法律责任。</p> <p>关于不存在内幕交易的承诺：</p> <p>1、本公司（含本公司控制的企业或其他组织）、本公司董事及高级管理人员及本公司的控股股东、实际控制人在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息在中国证券市场中买卖赛微电子股票，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人在中国证券市场中买卖赛微电子股票等内幕交易行为。</p> <p>2、本公司（含本公司控制的企业或其他组织）、本公司董事、监事及高级管理人员及本公司的控股股东、实际控制人不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与上市公司重大资产重组的情形，即不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>3、若违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。</p>			
资产重组时所作承诺	Silex Microsystems AB 董事、高管	其他承诺	<p>关于合规诚信情况的承诺：</p> <p>1、本人最近五年内未受过与中国证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>2、本人最近五年诚信情况良好，最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，不存在其他重大失信行为。</p> <p>3、如违反上述承诺，本人愿承担相关法律责任。</p> <p>关于不存在内幕交易的承诺：</p> <p>1、本人在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息在中国证券市场中买卖赛微电子股票，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人在中国证券市场中买卖赛微电子股票等内幕交易行为。</p> <p>2、本人不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与上市公司重大资产重组的情形，即不存在因</p>	2025 年 06 月 04 日	长期	正常履行中

			涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 3、若违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。			
资产重组时所作承诺	Aktiebolag Grens specialisten; Bure Equity AB; Creades AB (publ); Salénia AB; SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda Bankens Pens. Stif; Tham Special Investment AB; Tom Enterprise Private AB	其他承诺	关于提供信息真实、准确、完整的承诺： 1、本公司保证及时提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料及出具的说明均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，保证如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 关于合规诚信情况的承诺： 1、本公司为瑞典依法设立并合法存续的主体，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。 2、本公司及本公司的董事及高级管理人员最近五年内未受过刑事处罚或与证券市场有关的行政处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、本公司及本公司的董事及高级管理人员最近五年诚信情况良好，最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，不存在其他重大失信行为。 4、如违反上述承诺，本公司愿承担相关法律责任。 关于不存在内幕交易的承诺： 1、本公司（含本公司控制的企业或其他组织）、本公司董事及高级管理人员及本公司的控股股东、实际控制人在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息在中国证券市场中买卖赛微电子股票，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人在中国证券市场中买卖赛微电子股票等内幕交易行为。 2、本公司（含本公司控制的企业或其他组织）、本公司董事、监事及高级管理人员及本公司的控股股东、实际控制人不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与上市公司重大资产	2025 年 06 月 05 日	长期	正常履行中

			<p>重组的情形，即不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>3、若违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。</p> <p>关于本次交易资金来源的承诺： 本公司保证用于支付本次交易对价的全部资金均来源于自有资金或自筹资金，资金来源合法合规；本公司保证本次交易的资金均未来源于赛微电子。</p>			
资产重组时所作承诺	北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）；徐兴慧；杨云春	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺</p> <p>（一）交易对方承诺，交易对方北京集成电路投资中心、徐兴慧承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，除本企业/本人作为投资人而进行的投资外，本企业/本人未直接从事任何在商业上对耐威科技或其所控制的企业构成同业竞争的业务或活动，并保证在本企业/本人持有耐威科技股票期间也不会直接从事任何在商业上对耐威科技或其所控制的企业构成同业竞争的业务或活动（本企业/本人作为投资人而进行的投资除外）。</p> <p>2、在本次交易完成后，除本企业/本人作为投资人而进行的投资外，在本企业/本人持有耐威科技股票期间，如本企业/本人直接从事的业务与耐威科技及其下属企业经营的业务产生竞争，则本企业/本人将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入耐威科技或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业/本人不再直接从事与耐威科技及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。</p> <p>3、如因本企业/本人违反上述承诺而给耐威科技造成损失的，本企业/本人将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本企业/本人承诺以现金方式支付上述损失。</p> <p>4、本承诺在本企业/本人作为耐威科技股东期间持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>（二）控股股东及实际控制人承诺，耐威科技控股股东、实际控制人杨云春先生承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人未从事任何在商业上对耐威科技或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的企业从事任何在商业上对耐威科技或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。</p> <p>2、本次交易完成后，在本人持有耐威科技股票期间，如本人及本人控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范</p>	2015 年 12 月 31 日	长期	正常履行中

		<p>围，与耐威科技及其下属企业经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入耐威科技或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与耐威科技及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。</p> <p>3、如因本人违反上述承诺而给耐威科技造成损失的，本人将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。</p> <p>4、本承诺在本人作为耐威科技股东期间持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>（一）交易对方承诺，交易对方北京集成电路投资中心、徐兴慧承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本企业/本人及相关关联方不存在与耐威科技及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本企业/本人将会严格遵守有关上市公司监管法规，规范和减少与耐威科技及其所控制企业之间的关联交易；若本企业/本人及相关关联方与耐威科技及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本企业/本人及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在耐威科技履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保耐威科技及其股东的利益不受损害。</p> <p>2、如因本企业/本人违反上述承诺而给耐威科技造成损失的，本企业/本人将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本企业/本人承诺以现金方式支付上述损失。</p> <p>（二）控股股东及实际控制人承诺，耐威科技控股股东、实际控制人杨云春先生承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人及相关关联方不存在与耐威科技及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本人将会严格遵守有关上市公司监管法规，规范和减少与耐威科技及其所控制企业之间的关联交易；若本人及相关关联方与耐威科技及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本人及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在耐威科技履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保耐威科技及其股东的利益不受损害。</p> <p>2、如因本人违反上述承诺而给耐威科技造成损失的，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人承诺以现金方式支付上</p>			
--	--	---	--	--	--

			述损失。			
资产重组时所作承诺	北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙);徐兴慧;杨云春	其他承诺	<p>关于保持上市公司独立性的承诺</p> <p>(一) 交易对方承诺</p> <p>交易对方北京集成电路投资中心、徐兴慧承诺:</p> <p>在本次交易完成后,本企业/本人承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与耐威科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响耐威科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害耐威科技及其他股东的利益,切实保障耐威科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。</p> <p>(二) 控股股东及实际控制人承诺</p> <p>耐威科技控股股东、实际控制人杨云春先生承诺:</p> <p>在本次交易完成后,本人承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与耐威科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响耐威科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害耐威科技及其他股东的利益,切实保障耐威科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。”</p>	2015年12月31日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙);徐兴慧	其他承诺	<p>“关于不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚的承诺</p> <p>交易对方北京集成电路投资中心、徐兴慧承诺:</p> <p>1、本企业及主要管理人员/本人最近五年不存在负有数额较大债务到期未清偿、未履行承诺;</p> <p>2、本企业及主要管理人员/本人不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或行政处罚,以及受到证券交易所纪律处分或公开谴责的情况;</p> <p>3、本企业及主要管理人员/本人不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为以及因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会等行政主管部门立案调查之情形;</p> <p>4、本企业及主要管理人员/本人不存在任何证券市场失信行为;</p> <p>5、本企业及主要管理人员/本人最近五年均未受到过刑事处罚、与证券市场有关的行政处罚、或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼及仲裁的情形。”</p>	2015年12月31日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	北京市金杜律师事务所;北京天健兴业资产评估有限公司;北京天圆全会计师事务所(特殊普通	其他承诺	<p>根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速发展》及2015年11月11日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》中的规定,本次发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问国信证券股份有限公司、法律顾问北京市金杜律师事务所、审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及北</p>	2015年12月31日	长期	正常履行中

	合伙);德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所;国信证券股份有限公司		京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)、资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司(以下合称“中介机构”)承诺,如本次发行股份购买资产暨关联交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,中介机构未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。			
资产重组时所作承诺	北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙);徐兴慧	其他承诺	“交易对方北京集成电路投资中心、徐兴慧承诺: 1、本企业/本人作为瑞通芯源的股东,已经依法履行对瑞通芯源出资人民币489,570,652.94/500,000元的出资义务,不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为瑞通芯源股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响瑞通芯源合法存续的情况。 2、本企业/本人所持有的瑞通芯源股权为本企业/本人实际合法拥有,不存在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。”	2015年12月31日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	白绍武;北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙);蔡广远;丁新春;杜杰;李建浩;任章;王春磊;徐兴慧;杨建;杨云春;张阿斌;张云鹏;赵春海;郑云霞	其他承诺	“耐威科技全体董事、监事、高级管理人员承诺: 1、本人已向耐威科技及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重大资产重组事宜在现阶段所必须的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明,不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处;所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的;所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的,并已履行该等签署和盖章所需的法定程序,获得合法授权;所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。 2、根据本次重大资产重组的进程,本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,及时向耐威科技提供本次重大资产重组相关信息和文件,并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本人承诺并保证为本次重大资产重组所提供的信息和文件真实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 3、如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给耐威科技或者投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂	2015年12月31日	长期	正常履行中

			<p>停转让在耐威科技拥有权益的股份。</p> <p>交易对方北京集成电路投资中心、徐兴慧承诺：</p> <p>1、本企业/本人已向耐威科技及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次重大资产重组事宜在现阶段必须的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或书面陈述和说明，不存在任何虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有书面陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。</p> <p>2、根据本次重大资产重组的进程，本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向耐威科技提供本次重大资产重组相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> <p>3、如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给耐威科技或者投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担赔偿责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业/本人将暂停转让在耐威科技拥有权益的股份。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京耐威科技股份有限公司	募集资金使用承诺	<p>“本次公开发行后，募集资金用于投资项目至该等项目产生效益需要一定周期，为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增厚未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报：</p> <p>1、加强募集资金管理</p> <p>为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《募集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金合法、合理地使用。</p> <p>2、强化投资者回报机制</p> <p>为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司已根据中国证监会的规定和监管要求，制定上市后适用的《公司章程（草案）》，对利润分配尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序及机制；同时，公司制定了《股东未来分红回报规划》，以制度的形式稳定公司对股东的中长期回报，维护公司</p>	2015年05月14日	长期	正常履行中

			股东享有的资产。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京耐威科技股份有限公司	分红承诺	<p>”（一）本次发行完成前滚存利润的分配计划</p> <p>经公司 2015 年第一次临时股东大会决议：公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前的滚存未分配利润由公司公开发行后的新老股东按本次发行后的股权比例共享。</p> <p>（二）本次发行上市后的股利分配政策</p> <p>根据本次公开发行股票并上市后将生效的《公司章程（草案）》，公司股利分配政策如下：</p> <p>1、利润分配政策的基本原则</p> <p>公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。</p> <p>2、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润</p> <p>公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。</p> <p>（1）现金分红的条件</p> <p>公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。</p> <p>上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一：</p> <p>①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元。</p> <p>②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>（2）现金分红的间隔及比例</p> <p>原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到</p>	2015 年 05 月 14 日	长期	正常履行中

			<p>40%；</p> <p>③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>按照企业完整生命周期的四个阶段即初创期、成长期、成熟期与衰退期，公司目前所处发展阶段属于成长期。</p> <p>（3）股票股利分配的条件</p> <p>公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。</p> <p>公司于2015年3月22日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了公开发布上市后适用的《股东未来分红回报规划》，公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷等情况，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>公司2015年-2017年股东分红回报规划为：</p> <p>原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程及本规划规定的程序，提出差异化的现金分红政策。经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨云春	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及/或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与贵公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，贵公司在同等条件下享有优先权。</p>	2015年05月14日	长期	正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺	穆林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人为北京友好创达科技有限公司的控股股东，除北京友好创达科技有限公司以外，本人不存在其他对外投资的情形。本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对贵公司及 / 或贵公司的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动；如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及 / 或本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与贵公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，贵公司在同等条件下享有优先权。	2015 年 05 月 14 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨云春	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在公司今后经营活动中，本人将尽最大努力减少与公司之间的关联交易。若本人与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的公司的股东及 / 或董事回避表决，本人将促成该等关联股东及 / 或董事回避表决。	2015 年 05 月 14 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京耐威科技股份有限公司	其他承诺	公司承诺：招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2015 年 05 月 14 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	白绍武;蔡广远;丁新春;杜杰;柯颖;李建浩;任章;杨云春;张云鹏;赵春海;郑云霞	其他承诺	“招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若本人未及时履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起停止在公司领取薪酬（或津贴）及股东现金分红（如有），同时本人持有的公司股票（如有）将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。”	2015 年 05 月 14 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	国信证券股份有限公司	其他承诺	国信证券股份有限公司承诺：因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2015 年 05 月 14 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本事务所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2015 年 05 月 14 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	国浩律师（深圳）事务所	其他承诺	国浩律师（深圳）事务所承诺：因本事务所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2015 年 05 月 14 日	长期	正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺	北京耐威科技股份有限公司	其他承诺	<p>“本次公开发行后，募集资金用于投资项目至该等项目产生效益需要一定周期，为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增厚未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报：</p> <p>1、加强募集资金管理 为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《募集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金合法、合理地使用。</p> <p>2、积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资收益 公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，该等项目的建成有助于扩充公司产能，将公司自主掌握的核心技术转化为较强的盈利能力；研发中心项目基于行业技术发展趋势开展技术研发升级，可为公司规划的未来产品提供技术支持。公司积极调配内部资源，已先行通过自筹资金开展募投项目的基础工程建设；本次发行所募集的资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期收益，提供股东回报，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。</p> <p>3、加大市场拓展力度，加强研发投入力量 公司将继续立足导航定位产业，在已有的惯性导航、卫星导航产品及技术基础上，一方面，对于已掌握的成熟核心技术，继续推动其产业化应用，拓展应用市场，加强公司的市场地位；另一方面，对于反映行业发展趋势的核心技术，继续投入研发力量，努力取得突破，提升公司的综合竞争实力。</p> <p>4、强化投资者回报机制 为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司已根据中国证监会的规定和监管要求，制定上市后适用的《公司章程（草案）》，对利润分配尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序及机制；同时，公司制定了《股东未来分红回报规划》，以制度的形式稳定公司对股东的中长期回报，维护公司股东享有的资产。”</p>	2015年05月14日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京耐威科技股份有限公司	其他承诺	<p>本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施监管。公司承诺不会通过本</p>	2019年01月29日	长期	正常履行中

			次募集资金投入铺底流动资金和预备费变相实施重大投资或资产购买。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
其他承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

3、公司涉及业绩承诺

适用 不适用

承诺背景	承诺方	承诺期间	承诺指标	承诺金额（万元）	实际完成金额（万元）	完成率（%）
公司收购展诚科技 56.24% 股权，交易对方承诺展诚科技 2025 年、2026 年及 2027 年期间每个会计年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于 1,600 万元（含本数，下同）、1,800 万元、2,000 万元，并且在业绩承诺期间内各年度主营业务收入分别不低于 1.6 亿元、1.8 亿元、2 亿元。	孙延辉、袁鹏飞、刘斌、周静、李世密、刘晓颖	2025 年、2026 年、2027 年	扣除非经常性损益后的净利润	1,600	1,758.91	109.93%
公司收购展诚科技 56.24% 股权，交易对方承诺展诚科技 2025 年、2026 年及 2027 年期间每个会计年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于 1,600 万元（含本数，下同）、1,800 万元、2,000 万元，并且在业绩承诺期间内各年度主营业务收入分别不低于 1.6 亿元、1.8 亿元、2 亿元。	孙延辉、袁鹏飞、刘斌、周静、李世密、刘晓颖	2025 年、2026 年、2027 年	主营业务收入	16,000	21,148.38	132.18%

业绩承诺变更情况

适用 不适用

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

交易对方承诺展诚科技 2025 年、2026 年及 2027 年期间每个会计年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于 1,600 万元（含本数，下同）、1,800 万元、2,000 万元，并且在业绩承诺期间内各年度主营业务收入分别不低于 1.6 亿元、1.8 亿元、2 亿元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

展诚科技 2025 年度实现的主营业务收入为 211,483,792.84 元，占交易对方承诺业绩 160,000,000.00 元的 132.18%；扣除非经常性损益后的净利润为 17,589,139.62 元，占交易对方承诺业绩 16,000,000.00 元的 109.93%，完成业绩承诺，对商誉减值测试无影响。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、审计委员会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、近年来，国际地缘政治环境发生深刻变化，同时半导体产业在全球地缘政治博弈中的战略地位日益凸显，经济全球化与国际产业链分工协作面临挑战。由于国际局势的日趋紧张及复杂化，瑞典 Sillex 面临的不确定性因素显著增加。若公司继续维持对瑞典 Sillex 的控股地位，其业务运营与发展面临的地缘政治相关风险及不确定性可能上升，包括但不限于其与关键客户及供应商伙伴持续稳定合作的潜在挑战，以及由此可能导致的瑞典 Sillex 经营风险和价值受损风险。为审慎应对复杂多变的国际形势，最大程度缓解地缘政治环境变化带来的系统性风险，切实维护上市公司及全体股东的长远利益，经公司慎重研究，决定出售瑞典 Sillex 控制权，同时保留部分少数股权，继续享有瑞典 Sillex 业务增长收益、

保持境内外协作沟通纽带，并为海外业务运营创造更具韧性的发展条件。本次重大资产出售已于 2025 年 7 月完成交割，瑞典 Silex 从公司的全资子公司转变成为公司的重要参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

2、根据公司业务发展战略和规划，为进一步拓展和深化公司在 MEMS 芯片制造、IC 设计服务领域的战略布局，促进公司半导体服务产业生态协同，从而进一步提升公司综合竞争实力、行业地位和竞争力，公司于 2025 年 9 月完成收购展诚科技 56.24% 股权事项，本次交易完成后公司合计持有展诚科技 61.00% 股权，展诚科技纳入公司合并报表范围。

报告期内，公司依据业务发展而进行，但未对公司总体产生重大影响的其他合并范围变动详见“财务报告-合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	侯红梅、梁益胜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年、1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度公司聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司内部控制审计会计师事务所，支付内部控制审计费用为 30 万元；本年度，因重大资产出售，公司聘请华泰联合证券有限责任公司为独立财务顾问，支付独立财务顾问费用 445.20 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决的情况，也不存在负数额较大的债务逾期未清偿的情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
海创智能装备（烟台）有限公司	本公司实际控制人控制的公司	采购商品	采购海创智能设备	参照市场价格	协议约定	1,672.57	3.92%	5,000	否	货币资金	-	2025年03月20日	www.cninfo.com.cn
北京瑞宏宇星科技有限公司	公司董事持股超过5%的企业	销售服务	MEMS 工艺开发	参照市场价格	协议约定	256.64	0.88%	2,000	否	货币资金	-	2025年03月20日	www.cninfo.com.cn
穆林	实际控制人配偶	租赁办公场所	租赁穆林持有的房屋	参照市场价格	协议约定	26.82	2.09%	50	否	货币资金	6元/平/天	2025年03月20日	www.cninfo.com.cn
杨云春	实际控制人	租赁办公场所	租赁杨云春持有的房屋	参照市场价格	协议约定	28.12	2.19%	30	否	货币资金	5.2元/平/天	2025年03月20日	www.cninfo.com.cn
合计				--	--	1,984.15	--	7,080	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引

国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国家集成电路基金当时为公司第二大股东且持有公司5%以上股份，同时公司董事张帅先生由国家集成电路基金委派	收购股权	收购控股子公司9.5%股权	以经过具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告为基础，根据赛莱克斯北京实际经营、资产情况以及双方合作情况确定	11,990.92	30,353.92	32,370.96	货币资金	2025年07月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
海南依迈科技有限公司、海创智能装备（烟台）有限公司	为公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生实际控制企业且其担任执行董事	收购股权	收购海南依迈、海创智能装备持有的芯东来部分股权	以芯东来2025年5月融资投后估值5亿元为参考，并结合实际经营、资产、所在行业估值及未来发展、合作情况，经各方初步协商确定	769.7	-	3,722.4	货币资金	2025年11月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不会导致公司合并报表范围的变化，未对公司当期财务状况及经营成果产生重大不利影响。						
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用						

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 2025 年 3 月 19 日，公司召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司及子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司及子公司与银行签订的最终协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。该事项经独立董事专门会议审议通过。与会监事认为公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司及子公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

(2) 2025 年 6 月 30 日，公司召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司及子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司及子公司与银行签订的最终协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。该事项经独立董事专门会议审议通过。与会监事认为公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司及子公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

(3) 2025 年 8 月 26 日，公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东为公司及子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供关联担保的议案》，公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司及该等子公司根据资金使用计划与融资租赁机构及银行签订的最终协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。该事项经独立董事专门会议审议通过。审计委员会认为公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供连带责任担保，解决了公司及子公司开展融资租赁业务及申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且该等担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。

(4) 2025 年 9 月 10 日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股股东为全资子公司申请银行并购贷款提供关联担保的议案》，公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司全资子公司赛莱克斯国际申请银行并购贷款提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以赛莱克斯国际根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准，赛莱克斯国际免于支付担保费用。该事项经独立董事专门会议审议通过。审计委员会认为公司控股股东、实际控制人杨云春先生为赛莱克斯国际申请银行并购贷款提供连带责任担保，解决了赛莱克斯国际申请银行并购贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且该等担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。

(5) 2025 年 12 月 5 日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行并购贷款及为控股子公司申请银行授信提供关联担保的议案》，公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司申请银行并购贷款及为控股子公司申请银行授信提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司及控股子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准，公司及控股子公司免于支付担保费用。该事项经独立董事专门会议审议通过。审计委员会认为公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司申请银行并购贷款及为控股子公司申请银行授信提供连带责任担保，解决了公司申请银行并购贷款及控股子公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且该等担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的公告》	2025 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的公告》	2025 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于控股股东为公司及子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供关联担保的公告》	2025 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于控股股东为全资子公司申请银行并购贷款提供关联担保的公告》	2025 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《关于控股股东为公司申请银行并购贷款及为控股子公司申请银行授信提供关联担保的公告》	2025 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☑适用 □不适用

租赁情况说明

报告期内公司发生的租赁事项主要为公司及子公司以售后回租等方式租赁机器设备。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□适用 ☑不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☑适用 □不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
赛莱克斯北京	2024年12月18日	23,000	2025年05月29日	21,149.04	连带责任保证			自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
赛莱克斯北京	2025年06月30日	45,000	2023年09月06日	30,112.24	连带责任保证			自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
赛莱克斯北京	2025年03月20日	10,000	2025年04月23日	7,990	连带责任保证			自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
赛莱克斯北京	2025年08月27日	5,000	2025年09月05日	4,993.86	连带责任保证			自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
赛莱克斯北京	2025年08月27日	10,000	2025年09月30日	6,000	连带责任保证			自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
赛莱克斯北京	2025年12月05日	10,000	2025年12月25日	1,000	连带责任保证			自主合同项下的借	否	否

									款期限届满之次日起三年		
赛积国际	2025年08月27日	5,000	2025年09月05日	4,329	连带责任保证				自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
赛积国际	2025年06月30日	25,000	2022年10月31日	24,425	连带责任保证				自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
赛积国际	2025年08月27日	2,500	2025年10月15日	2,500	连带责任保证				自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
赛莱克斯国际	2025年09月10日	25,896.77	2025年09月15日	25,896.77	连带责任保证、质押	赛莱克斯北京9.5%股权			自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			209,530		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			73,858.67			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			232,530		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			128,395.91			
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		209,530		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			73,858.67				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		232,530		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			128,395.91				
全部担保余额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				19.07%							
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0							
担保总额超过净资产50%部分的金额 (F)				0							
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0							
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情				不适用							

况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、募集资金使用情况

适用 不适用

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2021年	向特定对象发行股票	2021年09月08日	233,343.27	233,343.27	806.39	221,142.35	94.77%	0	18,000	7.71%	0	不适用	0
合计	--	--	233,343.27	233,343.27	806.39	221,142.35	94.77%	0	18,000	7.71%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明：

公司 2021 年向特定对象发行股票募集专项资金净额为 233,343.27 万元；本次向特定对象发行股票募集资金主要用于“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”、“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”、“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”及“补充流动资金”项目。

(1) 公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”19,299.98 万元于 2021 年 10 月 26 日完成置换，“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”累计使用募集资金 79,289.60 万元。

(2) “MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”累计使用募集资金 71,241.46 万元。

(3) 公司于 2023 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中用于“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”的部分募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的 32,580 万元缩减为 14,580 万元，并将变更的该部分募集资金 18,000 万元永久补充流动资金。截至 2024 年 6 月 30 日，“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”已达到预定可使用状态。公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金继续用于子公司项目的议案》，该事项已经公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过，海创微元募集资金专户中的余额 12,620.13 万元继续用于其 MEMS 中试线建设。截至报告期末，该募投项目累计使用募集资金 1,980 万元。

(4) “补充流动资金”项目：截至报告期末，“补充流动资金”项目累计使用募集资金 68,631.29 万元。

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
2021 年向特定对象发行股票	2021 年 09 月 08 日	8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目(2019 年、2021 年均融资投入)	生产建设	否	79,051.98	79,051.98		79,289.6	100.30%	2020 年 12 月 31 日	17,296.83	75,312.73	否	否
2021 年向特定对象发行股票	2021 年 09 月 08 日	MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目	研发项目	否	32,580	14,580		1,980	13.58%	2024 年 06 月 30 日			不适用	否
2021 年	2021 年	MEMS 先	生产建	否	71,080	71,080	806.39	71,241	100.23	2025 年	7.35	7.35	否	否

向特定对象发行股票	09月08日	进封装测试研发及产线建设项目	设					.46	%	12月05日				
2021年向特定对象发行股票	2021年09月08日	补充流动资金	补流	否	50,631.29	68,631.29		68,631.29	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计				--	233,343.27	233,343.27	806.39	221,142.35	--	--	17,304.18	75,320.08	--	--
超募资金投向														
无														
合计				--	233,343.27	233,343.27	806.39	221,142.35	--	--	17,304.18	75,320.08	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>公司 2021 年（完成）向特定对象发行股票募集资金投资项目中：“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”同时为 2019 年（完成）向特定对象发行股票募集资金投资项目，在 2019 年募集资金投资完成时已处于正常运营阶段（截至本报告出具日，北京 FAB3 已处于正常运营阶段并持续推进产能爬坡，但发展及实现效益的节奏慢于预期）；“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”在项目实施过程中，公司相关子公司在自主开发及商业活动中同步成功积累相关工艺，高频通信 MEMS 器件的相关制造工艺研发工作同步获得开展，相关制造工艺同步成功解决，截至 2024 年 6 月 30 日，该项目已达到预定可使用状态，该募投项目的研发目标均已实现、已取得相关技术成果并在商业活动中进行应用；截至 2025 年 12 月 31 日，“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”已达到预定可使用状态；“补充流动资金”已正常实施。</p> <p>公司于 2023 年 12 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司将 2021 年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”、“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”实施进度进行调整，“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日；“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”由原计划的 2024 年 1 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。</p>													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用													
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用													
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2023 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”的实施主体由公司全资子公司赛莱克斯国际变更为公司控股子公司海创微元，实施地点由北京经济技术开发区变更为北京市怀柔区怀柔科学城。</p> <p>公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，该事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，恢复增加赛莱克斯国际为“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”的实施主体，并相应恢复增加北京经济技术开发区作为该募投项目实施地点。</p>													
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2023 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中用于“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”的部分募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划</p>													

	的 32,580 万元缩减为 14,580 万元，并将变更的该部分募集资金 18,000 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 19,299.98 万元，该金额经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天圆全专审字[2021]001537 号”《北京赛微电子股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。 公司以上述自筹资金预先投入募投项目资金 19,299.98 万元于 2021 年 10 月 26 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目由公司全资子公司赛莱克斯国际和控股子公司海创微元共同实施，公司相关子公司在自主开发及商业活动中已成功积累相关工艺，高频通信 MEMS 器件的相关制造工艺研发工作已同步获得开展，相关制造工艺已同步获得成功解决。 2、除募集资金投入部分外，与 MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目相关的研发活动也获得日常商业活动及政府补助相关项目的支持，MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目综合所获支持金额高于原计划投入金额。 3、公司在实施该募投项目过程中，本着合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，形成了募集资金结余。 公司 2021 年向特定对象发行股票涉及的募投项目已全部结项或完成，募集资金相关账户结余募集资金 16,385.58 万元已全部转入非募集资金专用账户，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户已全部注销完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见

适用 不适用

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）认为，贵公司董事会编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了贵公司募集资金实际存放与使用情况。

中泰证券股份有限公司认为，赛微电子 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的规定；公司对募集资金进行了专户存放、管理和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。保荐机构对赛微电子 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、控股子公司通过国家高新技术企业认定

2025 年 3 月，公司控股子公司海创微芯收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，本次系海创微芯首次通过高新技术企业认定，有效期三年。

2、控股子公司通过 IATF16949 认证

公司控股子公司赛莱克斯北京于 2025 年 4 月正式取得了《IATF16949：汽车质量管理体系证书》，证书有效期至 2028 年 2 月 20 日。

3、转让瑞典 Sillex 控制权

公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈北京赛微电子股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司向 Bure Equity AB、Creades AB(publ)等七名交易对方转让全资子公司瑞典 Sillex 控制权。本次交易前，瑞典 Sillex 为公司全资子公司，公司通过运通电子持有瑞典 Sillex 87.80%的股份，通过全资子公司赛莱克斯国际持有瑞典 Sillex 12.20%的股份。本次交易完成后，公司通过全资子公司赛莱克斯国际、运通电子合计持有瑞典 Sillex 45.24%股份，瑞典 Sillex 成为公司参股公司。上述议案已经公司于 2025 年 6 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。2025 年 7 月，本次重大资产出售交割完成。

4、调整公司治理结构

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，公司于 2025 年 7 月 16 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案已经公司于 2025 年 8 月 1 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过。本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。

5、收购展诚科技 56.24%股权

公司于 2025 年 8 月 19 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购青岛展诚科技有限公司 56.24%股权的议案》，公司拟以 15,747.20 万元收购展诚科技 56.24%股权。本次交易前，公司全资子公司微芯科技持有展诚科技 4.76%股权，本次交易完成后，公司合计持有展诚科技 61.00%股权，展诚科技成为公司控股子公司。本次股权交易事项已于 2025 年 9 月完成工商变更登记。

6、购买芯东来部分股权

公司于 2025 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟购买北京芯东来半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司微芯科技合计以 5,282.40 万元购买芯东来 10.20%股权。本次交易完成后，芯东来成为公司参股子公司。本次股权交易事项已于 2025 年 12 月完成工商变更登记。基于对芯东来发展前景的看好，公司于 2026 年 2 月继续购买芯东来 4.30%股权。截至目前，公司持有芯东来 14.50%股权。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、控股子公司 MEMS 硅晶振试产

2025 年 8 月，亦庄 MEMS 量产线代工制造的某款 MEMS 硅晶振通过了客户验证，赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单，启动首批 MEMS 硅晶振 8 英寸晶圆的小批量试生产。

2、控股子公司 MEMS-OCS 试产

2025 年 8 月，亦庄 MEMS 量产线代工制造的某款 MEMS-OCS 通过了客户验证，赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单，启动首批 MEMS-OCS 8 英寸晶圆的小批量试生产。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	138,716,556	18.94%				-3,952,350	-3,952,350	134,764,206	18.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	138,716,556	18.94%				-3,952,350	-3,952,350	134,764,206	18.41%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	138,716,556	18.94%				-3,952,350	-3,952,350	134,764,206	18.41%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	593,496,578	81.06%				3,952,350	3,952,350	597,448,928	81.59%
1、人民币普通股	593,496,578	81.06%				3,952,350	3,952,350	597,448,928	81.59%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	732,213,134	100.00%				0	0	732,213,134	100.00%

股份变动的原因

□适用 不适用

股份变动的批准情况

□适用 不适用

股份变动的过户情况

□适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨云春	138,260,039	0	3,952,500	134,307,539	高管锁定股	高管锁定股根据法律法规规定锁定。
张阿斌	245,929	0	0	245,929	高管锁定股	高管锁定股根据法律法规规定锁定。
周家玉	18,750	0	0	18,750	高管锁定股	高管锁定股根据法律法规规定锁定。
刘波	191,838	0	0	191,838	高管锁定股	高管锁定股根据法律法规规定锁定。
闻静	0	150	0	150	高管锁定股	高管锁定股根据法律法规规定锁定。
合计	138,716,556	150	3,952,500	134,764,206	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	168,675	年度报告披露日前 上一月末普通股 股东总数	161,665	报告期末表决权 恢复的优先 股股东总数 (如有)(参 见注9)	0	年度报告披露日前上一 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 (如有)(参 见注9)	0	持有特别 表决权股 份的股东 总数(如 有)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告期内增减 变动情况	持有有限售条件 的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
杨云春	境内自然人	24.46%	179,076,719	0	134,307,539	44,769,180	质押 冻结	71,170,000 11,843,479	
国家集成电路产 业投资基金股份 有限公司	国有法人	4.18%	30,592,393	-33,523,684	0	30,592,393	不适用		0

香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	13,100,772	8,491,279	0	13,100,772	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	4,706,939	342,100	0	4,706,939	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.45%	3,261,941	3,145,813	0	3,261,941	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	3,189,482	-2,571,551	0	3,189,482	不适用	0
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	2,873,400	603,300	0	2,873,400	不适用	0
#宋天峰	境内自然人	0.33%	2,411,900	2,411,900	0	2,411,900	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.30%	2,183,958	2,177,958	0	2,183,958	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	2,136,050	374,400	0	2,136,050	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杨云春	44,769,180	人民币普通股	44,769,180					
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	30,592,393	人民币普通股	30,592,393					
香港中央结算有限公司	13,100,772	人民币普通股	13,100,772					
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	4,706,939	人民币普通股	4,706,939					
UBS AG	3,261,941	人民币普通股	3,261,941					
国泰海通证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	3,189,482	人民币普通股	3,189,482					

招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,873,400	人民币普通股	2,873,400
#宋天峰	2,411,900	人民币普通股	2,411,900
高盛国际—自有资金	2,183,958	人民币普通股	2,183,958
中国工商银行股份有限公司—广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,136,050	人民币普通股	2,136,050
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前 10 名股东以及其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	宋天峰通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,411,900 股，实际合计持有 2,411,900 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨云春	中国	否
主要职业及职务	公司董事长，简历详见本报告第四节“六、董事和高级管理人情况”。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨云春	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长，简历详见本报告第四节“六、董事和高级管理人情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外	无		

上市公司情况

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2026 年 03 月 26 日
审计机构名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天圆全审字[2026]000521 号
注册会计师姓名	候红梅、梁益胜

审计报告正文

北京赛微电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京赛微电子股份有限公司（以下简称“赛微电子”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛微电子 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于赛微电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1. 事项描述

如财务报表附注七、15. 商誉所述，截止 2025 年 12 月 31 日，因赛微电子收购子公司产生的商誉为人民币 13,122.78 万元。根据企业会计准则，管理层须每年对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。

由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对赛微电子商誉的减值实施的主要审计程序包括：

- （1）了解、评估并测试了赛微电子商誉评估相关的内部控制的设计及运行情况；
- （2）复核赛微电子管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；
- （3）与赛微电子管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、评估参数的选择等合理性；
- （4）评价由赛微电子聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

- (5) 复核外部评估机构对商誉所在资产组的估值方法及出具的评估报告；
- (6) 评估赛微电子管理层于 2025 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

(二) 收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注五、29. 所述的会计政策及七、39. 营业收入所述，赛微电子 2025 年度实现营业收入 82,410.59 万元。

营业收入是赛微电子的关键绩效指标之一，而当中涉及因收入计入错误的会计期间或遭到操控而产生固有风险，因此我们将收入的真实性及截止正确做为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对赛微电子公司营业收入的真实性及截止正确实施的主要审计程序包括：

(1) 我们了解、评估了管理层对赛微电子公司自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 我们通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估赛微电子公司营业收入的确认政策；

(3) 结合产品类型对收入和成本执行分析程序，包括各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等；

(4) 执行细节测试，抽样检查销售合同、销售发票、出库单、发货单、验收单、对账单等单据，评估销售收入的真实性；

(5) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，确认业务收入的真实性、完整性；

(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证的相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止问题；

(7) 通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与赛微电子公司及主要关联方是否存在关联关系；

(8) 通过对生产过程及工时记录的检查，以及成本在不同产品或服务中的分配，检查收入真实性及成本分摊的合理性。

四、其他信息

赛微电子管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括赛微电子 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照赛微电子财务报告编制基础的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估赛微电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算赛微电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督赛微电子的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对赛微电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致赛微电子不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就赛微电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天圆全会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：

中国注册会计师：

2026 年 3 月 26 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京赛微电子股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,244,368,874.18	616,222,918.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		7,101,460.29
应收票据	34,338.00	
应收账款	293,225,623.06	512,242,749.28
应收款项融资		
预付款项	186,017,306.18	42,562,070.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,129,732.18	117,596,574.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	290,157,341.34	464,486,082.64
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,833,625.07	122,602,804.86
流动资产合计	3,206,766,840.01	1,882,814,660.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,462,613,615.86	580,845,635.71
其他权益工具投资	148,857,235.47	89,715,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,501,932,886.96	1,799,636,378.42
在建工程	476,905,888.63	891,261,115.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	376,634,024.71	497,325,434.25
无形资产	109,251,627.57	183,409,821.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	131,227,814.14	491,443,302.52
长期待摊费用	16,822,812.07	7,256,735.70
递延所得税资产	303,744,304.50	297,360,535.99
其他非流动资产	204,665,378.48	290,269,154.18
非流动资产合计	5,732,655,588.39	5,128,523,113.49
资产总计	8,939,422,428.40	7,011,337,774.25
流动负债：		
短期借款	253,397,568.67	109,851,280.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		1,572,738.32
应付票据	3,759,529.24	6,249,110.00
应付账款	46,839,044.91	81,699,853.49
预收款项		
合同负债	115,193,080.37	98,116,457.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,897,273.94	51,856,297.37
应交税费	6,656,147.03	19,075,211.59
其他应付款	164,053,499.14	81,301,309.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	199,590,165.11	153,642,622.69

其他流动负债	4,994,983.96	2,037,392.24
流动负债合计	829,381,292.37	605,402,274.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	754,615,128.64	620,488,083.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	171,525,401.71	101,004,999.74
长期应付款	31,494,400.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	118,169,777.20	194,756,556.69
递延所得税负债	12,916,902.49	100,522,072.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,088,721,610.04	1,016,771,712.45
负债合计	1,918,102,902.41	1,622,173,986.62
所有者权益：		
股本	732,213,134.00	732,213,134.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,205,092,606.79	4,048,395,248.89
减：库存股		
其他综合收益	34,319,994.62	-137,984,750.19
专项储备		
盈余公积	58,529,640.80	26,899,277.77
一般风险准备		
未分配利润	1,704,231,080.21	254,074,064.86
归属于母公司所有者权益合计	6,734,386,456.42	4,923,596,975.33
少数股东权益	286,933,069.57	465,566,812.30
所有者权益合计	7,021,319,525.99	5,389,163,787.63
负债和所有者权益总计	8,939,422,428.40	7,011,337,774.25

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：许骥

会计机构负责人：霍夕淼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	244,436,403.71	63,319,727.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	99,345,391.77	112,048,172.50
应收款项融资		
预付款项	552,187.60	69,405.88
其他应收款	1,760,519,281.05	1,569,624,109.71
其中：应收利息		
应收股利	200,000,000.00	
存货	23,360,072.74	30,176,991.15
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,801,653.45	3,701,981.41
流动资产合计	2,133,014,990.32	1,778,940,388.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		0.00
长期股权投资	3,454,535,831.37	3,293,877,827.92
其他权益工具投资	42,383,235.47	43,165,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,587,997.13	12,923,834.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,654,265.48	
无形资产	947,707.02	1,317,895.38
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,755,027.26	16,639,544.90
其他非流动资产	19,880,000.00	19,880,000.00
非流动资产合计	3,555,744,063.73	3,387,804,103.11
资产总计	5,688,759,054.05	5,166,744,491.32
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,482,570.79	88,338,440.79
预收款项		
合同负债	6,662,973.42	162,211.50
应付职工薪酬		
应交税费	49,196.61	876,043.34
其他应付款	327,007,923.67	224,177,560.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,689,744.28	
其他流动负债	848,987.54	3,888.50
流动负债合计	414,741,396.31	313,558,144.76
非流动负债：		
长期借款	68,027,903.98	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,000,068.15	0.00
长期应付款	31,494,400.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,522,372.13	0.00
负债合计	519,263,768.44	313,558,144.76
所有者权益：		
股本	732,213,134.00	732,213,134.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,071,234,499.48	4,071,234,499.48
减：库存股		0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,529,640.80	26,899,277.77
未分配利润	307,518,011.33	22,839,435.31
所有者权益合计	5,169,495,285.61	4,853,186,346.56
负债和所有者权益总计	5,688,759,054.05	5,166,744,491.32

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	824,105,934.18	1,204,715,636.91
其中：营业收入	824,105,934.18	1,204,715,636.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,564,546,426.37	1,432,317,582.43
其中：营业成本	531,542,520.46	781,790,496.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,692,578.04	6,101,301.80
销售费用	20,617,804.22	29,304,870.92
管理费用	544,849,986.96	148,281,360.25
研发费用	392,729,653.21	454,830,833.84
财务费用	67,113,883.48	12,008,719.43
其中：利息费用	30,270,754.05	37,232,659.26
利息收入	34,906,410.02	14,166,971.57
加：其他收益	9,954,770.69	28,984,462.23
投资收益（损失以“-”号填列）	2,230,837,643.69	13,354,776.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,900,785.85	13,069,176.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-311,708.41	-44,365,715.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-120,117,683.96	-26,680,423.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	255,635.05	2,032,516.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,380,178,164.87	-254,276,329.43
加：营业外收入	43,416.55	17,831.53
减：营业外支出	115,893.69	6,066.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,380,105,687.73	-254,264,564.41
减：所得税费用	-8,329,144.90	991,389.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,388,434,832.63	-255,255,953.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-423,199,967.53	-435,618,616.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,811,634,800.16	180,362,663.03
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	1,473,454,069.63	-169,994,109.70
2. 少数股东损益	-85,019,237.00	-85,261,843.81
六、其他综合收益的税后净额	172,304,744.81	-67,636,505.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	172,304,744.81	-67,636,505.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	172,304,744.81	-67,636,505.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	34,313,418.10	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	753,318.40	15,104,352.78
6. 外币财务报表折算差额	137,238,008.31	-82,740,858.56
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,560,739,577.44	-322,892,459.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,645,758,814.44	-237,630,615.48
归属于少数股东的综合收益总额	-85,019,237.00	-85,261,843.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.0123	-0.2322
（二）稀释每股收益	2.0123	-0.2322

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：许骥

会计机构负责人：霍夕淼

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	24,314,969.48	59,398,035.09
减：营业成本	13,539,823.01	42,898,215.93
税金及附加	203,698.40	222,708.64
销售费用	10,091.75	9,575.51
管理费用	27,054,377.14	20,882,037.27

研发费用	12,521,809.82	17,405,101.16
财务费用	-44,233.78	-3,249,733.81
其中：利息费用	653,146.04	4,130,305.92
利息收入	739,974.09	6,216,834.36
加：其他收益	272,587.84	574,363.58
投资收益（损失以“-”号填列）	328,605,011.94	13,200,806.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,605,011.94	13,200,806.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,336,488.10	-29,861,775.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	83,653.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,243,491.02	-34,772,821.34
加：营业外收入	0.21	0.00
减：营业外支出	54,595.76	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,188,895.47	-34,772,821.34
减：所得税费用	-11,114,734.83	-1,920,009.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,303,630.30	-32,852,811.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	316,303,630.30	-32,852,811.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	316,303,630.30	-32,852,811.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	848,852,232.19	1,315,014,723.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	62,822,581.46	125,021,834.87
收到其他与经营活动有关的现金	142,231,180.24	148,019,052.24
经营活动现金流入小计	1,053,905,993.89	1,588,055,611.06
购买商品、接受劳务支付的现金	510,393,306.80	663,485,051.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	375,728,757.92	421,982,710.75
支付的各项税费	56,384,053.87	63,414,448.39
支付其他与经营活动有关的现金	125,306,635.38	83,578,887.53
经营活动现金流出小计	1,067,812,753.97	1,232,461,098.29
经营活动产生的现金流量净额	-13,906,760.08	355,594,512.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,504,791.44	4,708,461.16

取得投资收益收到的现金	37,507,501.93	12,383,438.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,011.10	157,606.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,671,940,764.25	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,716,063,068.72	17,249,506.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,308,776.45	483,012,067.82
投资支付的现金	498,060,785.20	128,408,229.53
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,812,618.38	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	695,182,180.03	611,420,297.35
投资活动产生的现金流量净额	1,020,880,888.69	-594,170,791.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		84,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		84,000,000.00
取得借款收到的现金	1,149,849,598.50	307,095,077.56
收到其他与筹资活动有关的现金	17,790,000.00	1,230,000.00
筹资活动现金流入小计	1,167,639,598.50	392,325,077.56
偿还债务支付的现金	514,387,041.96	376,603,708.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,925,695.68	55,066,858.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,419,746.79	34,370,828.45
筹资活动现金流出小计	548,732,484.43	466,041,395.22
筹资活动产生的现金流量净额	618,907,114.07	-73,716,317.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,034,712.78	-17,903,668.47
五、现金及现金等价物净增加额	1,628,915,955.46	-330,196,264.58
加：期初现金及现金等价物余额	615,452,918.72	945,649,183.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,244,368,874.18	615,452,918.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,314,960.96	47,327,261.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,256,027,404.81	970,579,865.69
经营活动现金流入小计	1,292,342,365.77	1,017,907,127.66
购买商品、接受劳务支付的现金	34,228,925.08	15,744,236.00
支付给职工以及为职工支付的现金	23,032,821.47	19,502,286.21
支付的各项税费	1,929,862.76	2,088,513.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,166,646,968.27	936,341,840.78
经营活动现金流出小计	1,225,838,577.58	973,676,876.81

经营活动产生的现金流量净额	66,503,788.19	44,230,250.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,504,791.44	4,708,461.16
取得投资收益收到的现金	137,204,765.93	12,097,838.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		188,874,894.80
投资活动现金流入小计	143,709,557.37	205,780,194.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,000.00	47,388.00
投资支付的现金	17,503,475.60	121,908,229.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	94,483,200.00	196,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,206,675.60	318,555,617.53
投资活动产生的现金流量净额	31,502,881.77	-112,775,423.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,586,560.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		6,440,197.50
筹资活动现金流入小计	85,586,560.00	6,440,197.50
偿还债务支付的现金		195,097,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476,553.81	33,466,534.49
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	15,970,828.45
筹资活动现金流出小计	2,476,553.81	244,534,762.94
筹资活动产生的现金流量净额	83,110,006.19	-238,094,565.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	181,116,676.15	-306,639,737.96
加：期初现金及现金等价物余额	63,319,727.56	369,959,465.52
六、期末现金及现金等价物余额	244,436,403.71	63,319,727.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	732,213,134.00				4,048,395,248.89			-137,984,750.19		26,899,277.77		254,074,064.86	4,923,596,975.33	465,566,812.30	5,389,163,787.63
加：会计政策变															

单位：元

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	733,497,134.00				4,038,342,954.00	15,985,800.00	70,348,244.41		26,899,277.77		449,695,631.78		5,162,100,953.14	466,828,656.11	5,628,929,609.25
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	733,497,134.00				4,038,342,954.00	15,985,800.00	70,348,244.41		26,899,277.77		449,695,631.78		5,162,100,953.14	466,828,656.11	5,628,929,609.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,284,000.00				10,052,294.89	15,985,800.00	67,636,505.78				195,621,566.92		238,503,977.81	1,261,843.81	239,765,821.62
（一）综合收益总额							67,636,505.78				169,994,109.70		237,630,615.48	85,261,843.81	322,892,459.29
（二）所有者投入和减少资本	1,284,000.00				10,052,294.89	15,985,800.00							24,754,094.89	84,000,000.00	108,754,094.89
1. 所有者投入的普通股	1,284,000.00				14,656,860.00	15,985,800.00							44,940,000.00	84,000,000.00	84,044,940.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					24,709,154.89								24,709,154.89		24,709,154.89
（三）利润分配											25,627,457.22		25,627,457.22		25,627,457.22

											2		2		2
1. 提取 盈余公积															
2. 提取 一般风险 准备															
3. 对所 所有者（或 股东）的 分配											- 25,627 ,457.2 2		- 25,627 ,457.2 2		- 25,627 ,457.2 2
4. 其他															
（四）所 所有者权益 内部结转															
1. 资本 公积转增 资本（或 股本）															
2. 盈余 公积转增 资本（或 股本）															
3. 盈余 公积弥补 亏损															
4. 设定 受益计划 变动额结 转留存收 益															
5. 其他 综合收益 结转留存 收益															
6. 其他															
（五）专 项储备															
1. 本期 提取															
2. 本期 使用															
（六）其 他															
四、本期 期末余额	732, 213, 134. 00				4,048, 395,24 8.89		- 137,98 4,750. 19		26,899 ,277.7 7		254,07 4,064. 86		4,923, 596,97 5.33	465,56 6,812. 30	5,389, 163,78 7.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	732,213,134.00				4,071,234,499.48				26,899,277.77	22,839,435.31		4,853,186,346.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	732,213,134.00				4,071,234,499.48				26,899,277.77	22,839,435.31		4,853,186,346.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									31,630,363.03	284,678,576.02		316,308,939.05
（一）综合收益总额										316,303,630.30		316,303,630.30
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									31,630,363.03	31,630,363.03		
1. 提取盈余公积									31,630,363.03	31,630,363.03		
2. 对所有												

者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他										5,308.75		5,308.75
四、本期期末余额	732,213,134.00				4,071,234,499.48				58,529,640.80	307,518,011.33		5,169,495,285.61

上期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	733,497,134.00				4,061,182,204.59	15,985,800.00			26,899,277.77	281,319,704.16		4,886,912,520.52
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	733,497,134.00				4,061,182,204.59	15,985,800.00			26,899,277.77	281,319,704.16		4,886,912,520.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,284,000.00				10,052,294.89	-15,985,800.00				-58,480,268.85		-33,726,173.96
（一）综合收益总额										-32,852,811.63		-32,852,811.63
（二）所有者投入和减少资本	-1,284,000.00				10,052,294.89	-15,985,800.00						24,754,094.89
1. 所有者投入的普通股	-1,284,000.00				14,656,860.00	-15,985,800.00						44,940.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					24,709,154.89							24,709,154.89
（三）利润分配										-25,627,457.22		-25,627,457.22
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,627,457.22		-25,627,457.22
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	732,213,134.00				4,071,234,499.48				26,899,277.77	22,839,435.31		4,853,186,346.56

三、公司基本情况

1、公司概况

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，前身为“北京耐威科技股份有限公司”）2015年5月经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714号文《关于核准北京耐威科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准向社会公开发行人民币普通股（A股）并流通上市。公司注册地址：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室（德胜园区），公司总部办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室（德胜园区）、北京市北京经济技术开发区科创八街21号院1号楼，本公司及子公司的业务性质为产品研发、生产、销售与技术开发服务。

本公司及子公司实际从事的主要经营活动包括：MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造，集成电路设计服务，半导体设备销售，导航产品的研发、生产与销售；相关硬件产品的代理销售；相关技术开发服务。

公司法定代表人：杨云春

本公司财务报表已于2026年3月26日经公司董事会批准报出。

2、合并财务报表范围

本公司2025年度纳入合并范围的子公司共20户，详见本附注十“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加9户，减少3户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定编制。

此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2025 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2025 年度的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变动和公司及合并现金流量。

2、会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司、境内子公司及境外二级子公司运通电子以人民币为记账本位币。本公司之境外三级子公司运通电子技术发展有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币，本公司之境外二级子公司 VCHIP SDN. BHD. 以林吉特为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额超过 500 万
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项金额超过 500 万
本期重要的应收款项核销/债权投资核销/其他债权投资核销	单项金额超过 500 万
合同资产账面价值发生重大变动	单项金额超过 500 万
重要的在建工程	单项金额超过 5,000 万
重要的资本化研发项目/外购在研项目	单项金额超过 1,000 万
重要的投资活动	单项金额超过 5,000 万
重要的非全资子公司/联合营企业/共同经营、纳入合并范围的重要境外经营实体/结构化主体	单一主体收入、净利润、净资产、资产总额占本公司合并报表相关项目的 20%以上的
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	金额超过 500 万元的

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失

控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算，于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为林吉特、美元或人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产、负债项目，按照资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的所有者权益项目，按发生时的即期汇率折算。利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中其他综合收益项目中列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 分类和计量：

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：a)以摊余成本计量的金融资产；b)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备

① 预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

a) 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合如下：

应收账款组合 1 境外公司应收组合

应收账款组合 2 境内公司应收组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 无风险组合

合同资产组合 2 账龄组合

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；c) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

12、合同资产

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融资产减值相关内容。

13、存货

（1）存货的分类：存货主要分为原材料、在产品、库存商品、备品备件、发出商品、委托加工物资、在途物资等。

（2）存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，采用移动加权平均法或个别认定法确定发出存货的实际成本。

（3）存货的盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法进行摊销。

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

①库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值，以该存货的估计售价减去估计销售费用和相关税费后的金额确定；

②需要经过加工的材料，在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

14、持有待售资产

(1) 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(2) 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

在利润表中，本公司在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

15、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购

买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

（2）后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并

不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.9-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
电子设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
运输设备	年限平均法	4	5	23.75

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 其他说明

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

17、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非

正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、计算机软件等。无形资产按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照上述关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

26、预计负债

当与产品质量保证/亏损合同或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

27、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日计入相关资产成本或当期费用，相应增加负债。在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

28、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等金融工具的区分

本公司对于发行的优先股、永续债等金融工具，根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等金融工具的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

29、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

（1）境内商品销售：本公司境内商品销售主要为销售根据不同客户具体需求定制化开发或生产的不同类型 MEMS 芯片晶圆及相关产品、量产芯片和相关软硬件产品的代理销售等。本公司一般负责将货物运送至指定交货地点，将货物交付客户后，客户取得货物控制权，本公司确认销售商品收入。

（2）境外商品销售：本公司境外商品销售主要为向境外出口销售根据不同客户具体需求定制化开发或生产的不同类型 MEMS 芯片晶圆及相关产品。本公司与客户根据合同在货物交付给货运商并取得货运单时由购货方取得货物控制权，本公司确认销售商品收入。

（3）提供劳务

提供劳务收入本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。本公司在完成技术服务内容，取得客户验收单后确定提供劳务收入。劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补

偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）半导体设备销售收入

本公司自第三方取得商品控制权后再转让给客户，在交易过程中承担向客户转让商品的主要责任、承担存货风险，并能有权自主决定所交易的商品的价格，本公司在该交易中的身份是主要责任人，按合同约定的本公司预期有权收取的对价总额确认收入。

（5）芯片设计服务销售收入

1) 人月制计费模式：公司根据客户确认的工作量结算单据，定期确认收入。

2) 项目制计费模式：公司按合同约定的内容将技术开发成果交付客户，取得客户验收单据后确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

30、合同成本

31、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

（1）本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，本公司区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（2）与资产相关的政府补助的确认和计量方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（3）与收益相关的政府补助的确认和计量方法

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

2) 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

（4）与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（5）本公司涉及的各项政府补助的确认时点：

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。

已确认的政府补助需要退回的，本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- 2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

33、租赁

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- 1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- 2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司租赁资产的类别主要包括房屋及建筑物、机器设备。

(a) 初始计量

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(b) 后续计量

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租

赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(c) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

- 1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
- 2) 其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(d) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

34、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 套期会计

1) 套期的分类

本公司将套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益和其他综合收益。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2) 套期工具和被套期项目

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的，其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具，包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生工具，但签出期权除外。只有在对购入期权（包括嵌入在混合合同中的购入期权）进行套期时，签出期权才可以作为套期工具。嵌入在混合合同中但未分拆的衍生工具不能作为单独的套期工具。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产或非衍生金融负债，但指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益、且其自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益的金融负债除外。

自身权益工具不属于金融资产或金融负债，不能作为套期工具。

被套期项目，是指使本公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本公司将下列单个项目、项目组合或其组成部分指定为被套期项目：

①已确认资产或负债。

②尚未确认的确定承诺。确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。

③极可能发生的预期交易。预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

④境外经营净投资。

上述项目组成部分是指小于项目整体公允价值或现金流量变动的部分，本公司将下列项目组成部分或其组合指定为被套期项目：

①项目整体公允价值或现金流量变动中仅由某一个或多个特定风险引起的公允价值或现金流量变动部分（风险成分）。根据在特定市场环境下的评估，该风险成分应当能够单独识别并可靠计量。风险成分也包括被套期项目公允价值或现金流量的变动仅高于或仅低于特定价格或其他变量的部分。

②一项或多项选定的合同现金流量。

③项目名义金额的组成部分,即项目整体金额或数量的特定部分,其可以是项目整体的一定比例部分,也可以是项目整体的某一层级部分。若某一层级部分包含提前还款权,且该提前还款权的公允价值受被套期风险变化影响的,不得将该层级指定为公允价值套期的被套期项目,但在计量被套期项目的公允价值时已包含该提前还款权影响的情况除外。

3)套期关系评估

公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的,才能运用套期会计方法进行处理:

①套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。

②在套期开始时,本公司正式指定了套期工具和被套期项目,并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法(包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法)等内容。

③套期关系符合套期有效性要求。

套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。套期工具的公允价值或现金流量变动大于或小于被套期项目的公允价值或现金流量变动的部分为套期无效部分。

本公司发生下列情形之一的,终止运用套期会计:

①因风险管理目标发生变化,导致套期关系不再满足风险管理目标。

②套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

③被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系,或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响开始占主导地位。

④套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。在适用套期关系再平衡的情况下,本公司首先考虑套期关系再平衡,然后评估套期关系是否满足运用套期会计方法的条件。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分,在仅影响其中一部分时,剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

4)确认和计量

满足运用套期会计方法条件的,按如下方法进行处理:

①公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资(或其组成部分)进行套期的,套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

被套期项目因被套期风险敞口形成利得或损失计入当期损益,同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(或其组成部分)的,其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益,其账面价值已经按公允价值计量,不需要调整;被套期项目为选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资(或其组成部分)的,其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益,其账面价值已经按公允价值计量,不需要调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺(或其组成部分)的,其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时,应当调整该资产或负债的初始确认金额,以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

②现金流量套期

套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失。②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

如果被套期的预期交易随后确认为一项非金融资产或非金融负债的，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用公允价值套期会计的确定承诺时，则将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，本公司按照类似于现金流量套期会计的规定处理。

(2) 回购本公司股份

回购本公司股份支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、出售或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

- 1) 本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。
- 2) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。
- 3) 本公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

(3) 非货币性资产交换

如果非货币性资产交换具有商业实质，并且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以换出资产的公允价值（如果有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠除外）和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。如果非货币性资产交换不具备上述条件，则按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。

非货币性资产交换同时换入多项资产的，如果该交换具有商业实质，并且换入资产的公允价值能够可靠计量的，按照换入的金融资产以外的各项换入资产公允价值相对比例，将换出资产公允价值总额扣除换入金融资产公允价值后的净额进行分摊，以分摊至各项换入资产的金额，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的成本进行初始计量；如该交换不具有商业实质，按照各项换入资产的公允价值的相对比例，将换出资产的账面价值总额分摊至各项换入资产，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的初始计量金额，换入资产的公允价值不能可靠计量的，按照各项换入资产的原账面价值的相对比例或其他合理的比例对换出资产的账面价值进行分摊。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□适用 不适用

(3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用

36、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	按销售额的 9%（出租不动产）、13% 计算销项税，按规定扣除进项税额后计算缴纳
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、24%、25%
增值税	技术服务收入	3%，6%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京赛微电子股份有限公司	25%
北京赛莱克斯国际科技有限公司	25%
运通电子有限公司	16.5%
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	25%
赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司	25%
飞纳经纬科技（北京）有限公司	25%
北京微芯科技有限公司	25%
北京中科赛微电子有限公司	25%
北京极芯传感科技中心（有限合伙）	25%
北京赛积国际科技有限公司	25%
北京海创微芯科技有限公司	15%
北京海创微元科技有限公司	25%
青岛展诚科技有限公司	15%
南京宁芯电子科技有限公司	20%
成都芯卓电子科技有限公司	20%
青岛芯诚电子科技有限公司	20%
上海芯舵科技有限公司	20%
无锡筑芯科技有限公司	20%
运通电子技术发展有限公司	16.5%
VCHIP SDN. BHD.	24%
亞芯（香港）有限公司	16.5%

2、税收优惠

（1）增值税优惠

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）规定，继续实施软件增值税优惠政策；根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

北京耐威科技股份有限公司（已更名为“北京赛微电子股份有限公司”）于2011年12月9日在北京市西城区国家税务局第一税务所进行了软件产品备案，包括：北斗/GPS/GLONASS多模网络RTK系统移动站软件V3.0、北斗/GPS/GLONASS多模网络RTK系统监控中心软件V4.0、北斗/GPS/GLONASS多模网络RTK系统基准站软件V3.0三种软件产品，其生产销售的上述软件产品增值税入库税款实际税负超过3%的部分即征即退。北京耐威科技股份有限公司（已更名为“北京赛微电子股份有限公司”）于2019年12月18日在北京市西城区国家税务局第一税务所进行了软件产品备案，包括：利用外部间断信号自主修正的导航解算软件V1.0、北斗导航芯片信号处理软件V1.0、抗干扰天线信号处理软件V1.0、具有自寻北自检测自标定功能的惯性导航解算软件V1.0四种软件产品，其生产销售的上述软件产品增值税入库税款实际税负超过3%的部分即征即退。

飞纳经纬科技（北京）有限公司于2019年9月6日在北京市西城区国家税务局第一税务所进行了软件产品备案，包括：飞纳经纬卫星导航板卡固件升级软件V1.0、飞纳经纬高精度卫星导航数据转换软件DataTrans V1.0、飞纳经纬串口升级软件SerialUpdate V1.0三种软件产品，其生产销售的上述软件产品增值税入库税款实际税负超过3%的部分即征即退。

青岛展诚科技有限公司于2022年9月2日在国家税务总局青岛市市南区税务局进行了软件产品备案，包括集成电路自动更改ESD参数与layers系统V1.0、展诚集成电路测试优化软件V1.0、展诚集成电路阵列设计系统V1.0等二十三种软件产品，其生产销售的上述软件产品增值税入库税款实际税负超过3%的部分即征即退。

（2）所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。北京海创微芯科技有限公司于2024年12月31日（证书载明发证时间）取得高新技术企业证书（编号：GR202411010047号），2024年至2026年享受15%税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。青岛展诚科技有限公司于2025年12月19日（证书载明发证时间）取得高新技术企业证书（编号：GR202537100064号），2025年至2027年享受15%税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）规定，对集成电路线宽小于0.25微米或投资额超过80亿元的集成电路生产企业，经认定后，减按15%的税率征收企业所得税，其中经营期在15年以上的，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税（以下简称企业所得税“五免五减半”优惠政策）。赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司自2019年至2023年免征企业所得税，2024年至2028年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）规定：“三、对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。”南京宁芯微电子科技有限公司、成都芯卓微电子科技有限公司、青岛芯诚微电子科技有限公司、上海芯舵科技有限公司和无锡筑芯科技有限公司属于符合规定的小型微利企业，按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		25,000.00
银行存款	2,244,368,874.18	615,427,918.66
其他货币资金		770,000.06
合计	2,244,368,874.18	616,222,918.72
其中：存放在境外的款项总额	1,677,417,277.36	321,726,398.79

其他说明：

2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生品（汇率对冲工具）		7,101,460.29
合计		7,101,460.29

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,338.00	
合计	34,338.00	

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	34,338.00	100.00%			34,338.00					
其中：										
银行承兑汇票组合	34,338.00	100.00%			34,338.00					
合计	34,338.00	100.00%			34,338.00					

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	34,338.00	0.00	0.00%
合计	34,338.00	0.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,065,537.90	34,338.00

合计	1,065,537.90	34,338.00
----	--------------	-----------

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	130,046,260.94	365,706,951.27
1 至 2 年	60,859,218.03	157,270,292.78
2 至 3 年	133,122,332.86	48,472,742.53
3 年以上	53,105,170.66	15,811,206.50
3 至 4 年	40,719,664.16	4,264,000.00
4 至 5 年	4,262,000.00	3,396,000.00
5 年以上	8,123,506.50	8,151,206.50
合计	377,132,982.49	587,261,193.08

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,279,696.92	6.97%	26,279,696.92	100.00%		39,291,616.63	6.69%	38,195,213.31	97.21%	1,096,403.32
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	350,853,285.57	93.03%	57,627,662.51	16.43%	293,225,623.06	547,969,576.45	93.31%	36,823,230.49	6.72%	511,146,345.96

账款										
其中:										
境外公司应收组合	0.00	0.00%				176,633,323.86	30.08%		0.00%	176,633,323.86
境内公司应收组合	350,853,285.57	93.03%	57,627,662.51	16.43%	293,225,623.06	371,336,252.59	63.23%	36,823,230.49	9.92%	334,513,022.10
合计	377,132,982.49	100.00%	83,907,359.43	22.25%	293,225,623.06	587,261,193.08	100.00%	75,018,443.80	12.77%	512,242,749.28

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	客户财务困难
客户 2	24,369,696.92	24,369,696.92	24,369,696.92	24,369,696.92	100.00%	客户财务困难
客户 3	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	100.00%	客户财务困难
客户 4	3,602,036.96	3,602,036.96				
客户 5	1,949,771.21	1,949,771.21				
客户 6	1,286,095.20	1,286,095.20				
客户 7	1,254,528.02	1,254,528.02				
客户 8	1,401,988.32	305,585.00				
客户 9	3,390,000.00	3,390,000.00				
客户 10	127,500.00	127,500.00				
合计	39,291,616.63	38,195,213.31	26,279,696.92	26,279,696.92		

按组合计提坏账准备: 境外公司应收组合计提项目

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 境内公司应收组合计提项目

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	130,046,260.94	6,502,313.05	5.00%
1 至 2 年	60,859,218.03	6,085,921.80	10.00%
2 至 3 年	131,272,762.98	26,254,552.60	20.00%
3 至 4 年	18,199,537.12	9,099,768.56	50.00%
4 至 5 年	3,952,000.00	3,161,600.00	80.00%
5 年以上	6,523,506.50	6,523,506.50	100.00%
合计	350,853,285.57	57,627,662.51	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	38,195,213.31	3,776,715.56	4,383,077.41		-11,309,154.54	26,279,696.92
按组合计提坏账准备	36,823,230.49	18,601,325.32			2,203,106.70	57,627,662.51
合计	75,018,443.80	22,378,040.88	4,383,077.41		-9,106,047.84	83,907,359.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
客户 1	3,390,000.00	收回款项	货币资金	客户财务困难，全额计提
合计	3,390,000.00			

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	128,053,000.00		128,053,000.00	33.95%	24,525,521.52
客户 2	29,252,605.00		29,252,605.00	7.76%	2,925,260.50
客户 3	28,874,989.15		28,874,989.15	7.66%	1,446,703.05
客户 4	24,369,696.92		24,369,696.92	6.46%	24,369,696.92
客户 5	19,000,000.00		19,000,000.00	5.04%	1,900,000.00
合计	229,550,291.07		229,550,291.07	60.87%	55,167,181.99

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	125,129,732.18	117,596,574.92
合计	125,129,732.18	117,596,574.92

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	136,739,225.59	132,098,051.24
押金及保证金	24,461,321.35	36,773,263.47
个人借款	5,650,000.00	
股权转让款	2,550,000.00	2,550,000.00
代扣代缴款项	1,775,153.73	1,454,781.36
备用金	533,127.47	439,127.47
合计	171,708,828.14	173,315,223.54

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	79,156,018.74	24,828,715.86
1至2年	24,386,156.34	342,514.74
2至3年	3,811,668.30	52,014,500.00
3年以上	64,354,984.76	96,129,492.94
3至4年	52,136,827.47	92,915,355.12
4至5年	9,015,355.12	6,057.82
5年以上	3,202,802.17	3,208,080.00
合计	171,708,828.14	173,315,223.54

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	50,495,233.26		5,223,415.36	55,718,648.62
2025 年 1 月 1 日余额在 本期				
本期计提	-17,727,512.65		44,257.59	-
其他变动	6,098,601.60		2,445,100.80	17,683,255.06
2025 年 12 月 31 日余额	38,866,322.21		7,712,773.75	8,543,702.40
				46,579,095.96

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	55,718,648.62	-17,683,255.06			8,543,702.40	46,579,095.96
合计	55,718,648.62	-17,683,255.06			8,543,702.40	46,579,095.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
IMEGO AB	应收退货款	69,890,906.90	1 年以内	40.70%	3,494,545.35
北京耐威时代科技有限公司	往来款	60,714,855.12	3-4 年 52,000,000.00 元, 4-5 年 8,714,855.12 元	35.36%	32,971,884.10
芯鑫融资租赁（北京）有限责任公司	融资租赁保证金	18,400,000.00	1-2 年	10.72%	552,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	融资租赁保证金	5,000,000.00	1 年以内	2.91%	150,000.00
FABEXCHANGE, INC.	往来款	2,674,257.45	1-2 年	1.56%	2,674,257.45
合计		156,680,019.47		91.25%	39,842,686.90

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	150,521,218.44	80.92%	42,134,711.99	99.00%
1 至 2 年	35,341,020.42	19.00%	260,551.51	0.60%
2 至 3 年	60,015.77	0.03%	91,516.55	0.22%
3 年以上	95,051.55	0.05%	75,290.00	0.18%
合计	186,017,306.18		42,562,070.05	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未结算原因
供应商 1	28,818,080.00	合同正在履行中

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	45,600,000.00	24.51

供应商 2	28,818,080.00	15.49
供应商 3	20,342,219.13	10.94
供应商 4	16,737,859.49	9.00
供应商 5	15,814,800.00	8.50
合计	127,312,958.62	68.44

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	111,305,656.95		111,305,656.95	186,495,526.89	7,801,075.80	178,694,451.09
在产品	27,686,548.24	8,409,543.98	19,277,004.26	43,649,526.75	7,092,699.38	36,556,827.37
库存商品	232,146,661.37	107,965,717.11	124,180,944.26	191,333,685.05	17,373,659.88	173,960,025.17
合同履约成本	26,293,746.33	6,525,171.17	19,768,575.16	24,930,222.33		24,930,222.33
发出商品	18,890,643.65	3,265,482.94	15,625,160.71	7,280,335.62		7,280,335.62
备品备件				58,345,353.99	15,288,744.84	43,056,609.15
低值易耗品				7,611.91		7,611.91
合计	416,323,256.54	126,165,915.20	290,157,341.34	512,042,262.54	47,556,179.90	464,486,082.64

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,801,075.80	-965,116.23	130,341.64	1,898,183.10	5,068,118.11	
在产品	7,092,699.38	1,316,844.60				8,409,543.98
库存商品	17,373,659.88	107,178,935.62	1,352,212.38	17,939,090.77		107,965,717.11
合同履约成本		6,525,171.17				6,525,171.17
备品备件	15,288,744.84	5,799,175.50	1,862,588.73	1,886,018.54	21,064,490.53	
发出商品		3,265,482.94				3,265,482.94
合计	47,556,179.90	123,120,493.60	3,345,142.75	21,723,292.41	26,132,608.64	126,165,915.20

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款/待抵扣增值税	66,437,089.04	53,645,314.80
待摊费用		21,637,888.90
预缴企业所得税	1,396,536.03	137,638.92
应收退税款		47,181,962.24
合计	67,833,625.07	122,602,804.86

其他说明：

9、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
爱集微咨询（厦门）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00						
海南火眼曦和股权投资	9,218,235.47	10,000,000.00						

私募基金合伙企业（有限合伙）								
阿基米德半导体（合肥）有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00						
吉姆西半导体科技（无锡）股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00						
深圳市金石重投智能传感器产业私募股权基金	16,665,000.00	16,665,000.00						
青岛展诚科技有限公司		5,000,000.00					302,736.00	
依迈微（北京）科技有限公司	1,550,000.00	1,550,000.00						
成都纤声科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00						
无锡墀旃半导体有限公司	9,600,000.00	8,000,000.00						
星昱传感科技（嘉兴）有限公司	1,000,000.00							
北京芯东来半导体科技有限公司	52,824,000.00							
龙骧鑫睿（厦门）科技有限公司	4,500,000.00							
深圳市蔚海智芯科技有限公司	5,000,000.00							
合计	148,857,235.47	89,715,000.00					302,736.00	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业													
二、联营企业													
武汉光谷信息技术股份有限公司和湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	363,622,649.92		17,503,475.60		-7,382,086.82							373,744,038.70	
青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）	11,698,578.82			2,348,026.91								9,350,551.91	
青岛聚能创芯微电子有限公司	54,686,158.89				-6,216,131.48							48,470,027.41	
北京赛微私募基金管理有限公司	11,346,498.02				975,677.18							12,322,175.20	
北京北工杯微传感科技股权投资基金（有限合伙）	123,519,280.93			3,375,000.00	4,028,095.88							124,172,376.81	
Silex Microsystems AB					52,161,201.68	34,313,418.10					1,780,013,780.53	1,866,488,400.31	
西安智诚微电子科技有限公司					1,319,347.32						-590,995.84	728,351.48	

有限公司												
广州联星科技有限公司	3,511,056.04				-183,300.39						3,327,755.65	
北京思丰可科技有限公司	3,461,459.39				-1,288.14						3,460,171.25	
北京市赛微传感产业投资基金合伙企业(有限合伙)	8,999,953.70				-186.56						8,999,767.14	
杭州初芯微科技合伙企业(有限合伙)			11,550,000.00								11,550,000.00	
小计	580,845,635.71	0.00	29,053,475.60	5,723,026.91	44,701,328.67	34,313,418.10	0.00	0.00	0.00	1,779,422,784.69	2,462,613,615.86	
合计	580,845,635.71	0.00	29,053,475.60	5,723,026.91	44,701,328.67	34,313,418.10	0.00	0.00	0.00	1,779,422,784.69	2,462,613,615.86	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明:

由于武汉光谷信息技术股份有限公司为新三板挂牌企业（证券代码 430161），其截至 2026 年 3 月 26 日尚未披露 2025 年年度报告，因此将武汉光谷信息技术股份有限公司及湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合并列示。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,501,932,886.96	1,799,636,378.42
合计	1,501,932,886.96	1,799,636,378.42

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	866,035,538.75	1,392,342,255.81	3,070,131.00	31,976,852.37	2,293,424,777.93
2. 本期增加金额	24,477,657.31	729,646,610.69		3,669,465.64	757,793,733.64
(1) 购置		18,041.42		181,667.15	199,708.57
(2) 在建工程转入		453,863,096.67		2,298,701.12	456,161,797.79
(3) 企业合并增加				731,368.19	731,368.19
(4) 融资租赁转入		229,444,961.16			229,444,961.16
(5) 外币报表折算差额	24,477,657.31	46,320,511.44		457,729.18	71,255,897.93
3. 本期减少金额	233,706,049.82	871,545,521.29		4,551,336.72	1,109,802,907.83
(1) 处置或报废		6,345,379.76			6,345,379.76
(2) 处置子公司减少	233,444,913.82	449,408,234.38		4,400,639.52	687,253,787.72
(3) 融资租赁转出		415,762,674.98		150,697.20	415,913,372.18
(4) 其他	261,136.00	29,232.17			290,368.17
4. 期末余额	656,807,146.24	1,250,443,345.21	3,070,131.00	31,094,981.29	1,941,415,603.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	149,199,891.08	324,690,350.36	2,508,583.97	17,389,574.10	493,788,399.51
2. 本期增加金额	42,840,857.04	154,432,829.99	189,202.99	6,088,115.86	203,551,005.88
(1) 计提	39,892,888.28	135,157,833.48	189,202.99	5,958,526.89	181,198,451.64
(2) 外币报表折算差额	2,947,968.76	19,274,996.51		129,588.97	22,352,554.24
3. 本期减少金额	34,863,332.17	220,994,997.26		1,998,359.18	257,856,688.61
(1) 处置或报废		1,155,387.90			1,155,387.90
(2) 处置子公司减少	34,863,332.17	205,581,211.39		1,877,695.25	242,322,238.81
(3) 融资租赁转出		14,258,397.97		120,663.93	14,379,061.90
4. 期末余额	157,177,415.95	258,128,183.09	2,697,786.96	21,479,330.78	439,482,716.78
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	499,629,730.29	992,315,162.12	372,344.04	9,615,650.51	1,501,932,886.96
2. 期初账面价值	716,835,647.67	1,067,651,905.45	561,547.03	14,587,278.27	1,799,636,378.42

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	133,193,322.46

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况适用 不适用**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	476,905,888.63	891,261,115.57
合计	476,905,888.63	891,261,115.57

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	476,905,888.63		476,905,888.63	891,261,115.57		891,261,115.57
合计	476,905,888.63		476,905,888.63	891,261,115.57		891,261,115.57

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北京 8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目（在建工程）	2,304,420,000.00	380,926,035.79	52,106,418.75	54,954,394.66	40,817,029.77	337,261,030.11	95.87%	98.00%	48,769,000.33			募集资金、金融机构贷款、其他
MEMS 先进封装测试及产线建设（在建工程）	543,462,300.00	380,002,113.44	7,846,565.40	387,848,678.84			71.37%	100.00%	25,653,713.20	7,617,207.64	3.12%	募集资金、金融机构贷款、其他
先进 MEMS 工艺设计与服务北京市工程研究中心（在建工程）	114,887,300.00	98,449,513.10	32,340,559.43			130,790,072.53	108.61%	95.00%				其他
合计	2,962,769,600.00	859,377,662.33	92,293,543.58	442,803,073.50	40,817,029.77	468,051,102.64			74,422,713.53	7,617,207.64		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 ☑不适用

13、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额		737,641,379.21		737,641,379.21
2. 本期增加金额	2,383,717.25	443,665,536.29	30,033.27	446,079,286.81
(1) 租入资产		401,504,277.01	30,033.27	401,534,310.28
(2) 外币报表折算差额		42,161,259.28		42,161,259.28
(3) 企业合并增加	2,383,717.25			2,383,717.25
3. 本期减少金额		779,802,638.49		779,802,638.49
(1) 处置		245,822.99		245,822.99
(2) 租赁到期转出		377,669,668.16		377,669,668.16
(3) 处置子公司		401,887,147.34		401,887,147.34
4. 期末余额	2,383,717.25	401,504,277.01	30,033.27	403,918,027.53
二、累计折旧				0.00
1. 期初余额		240,315,944.96		240,315,944.96
2. 本期增加金额	221,764.71	57,501,214.15	2,644.01	57,725,622.87
(1) 计提	221,764.71	46,360,237.73	2,644.01	46,584,646.45
(2) 外币报表折算差额		11,140,976.42		11,140,976.42
3. 本期减少金额		270,757,565.01		270,757,565.01
(1) 处置				0.00
(2) 租赁到期转出		148,224,707.00		148,224,707.00
(3) 处置子公司		122,532,858.01		122,532,858.01
4. 期末余额	221,764.71	27,059,594.10	2,644.01	27,284,002.82
三、减值准备				0.00
1. 期初余额				0.00
2. 本期增加金额				0.00
(1) 计提				0.00
				0.00
3. 本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
				0.00
4. 期末余额				0.00
四、账面价值				0.00
1. 期末账面价值	2,161,952.54	374,444,682.91	27,389.26	376,634,024.71
2. 期初账面价值		497,325,434.25		497,325,434.25

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	162,843,652.26	16,736,043.50		50,329,508.56	72,353.99	229,981,558.31
2. 本期增加金额	11,202,757.29	2,000,326.46	29,206,000.00	693,778.18	8,475.28	43,111,337.21
(1) 购置						0.00
(2) 内部研发						0.00
(3) 企业合并增加			29,206,000.00	202,978.18		29,408,978.18
(4) 在建工程转入				490,800.00		490,800.00
(5) 外币报表折算差额	11,202,757.29	2,000,326.46			8,475.28	13,211,559.03
3. 本期减少金额	106,841,380.69	18,736,369.96			80,829.27	125,658,579.92
(1) 处置						0.00
(2) 处置子公司	106,841,380.69	18,736,369.96			80,829.27	125,658,579.92
						0.00
4. 期末余额	67,205,028.86		29,206,000.00	51,023,286.74		147,434,315.60
二、累计摊销						0.00
1. 期初余额	12,399,488.49	16,547,840.03		17,552,054.65	72,353.99	46,571,737.16
2. 本期增加金额	1,676,941.18	2,039,662.65	1,718,000.00	5,870,240.10	8,475.28	11,313,319.21
(1) 计提	1,590,293.07	99,486.02	1,718,000.00	5,870,240.10		9,278,019.19
(2) 外币报表折算差额	86,648.11	1,940,176.63			8,475.28	2,035,300.02
3. 本期减少金额	1,034,036.39	18,587,502.68			80,829.27	19,702,368.34
(1) 处置						0.00
(2) 处置子公司减少	1,034,036.39	18,587,502.68			80,829.27	19,702,368.34
4. 期末余额	13,042,393.28		1,718,000.00	23,422,294.75		38,182,688.03

三、减值准备						0.00
1. 期初余额						0.00
2. 本期增加金额						0.00
(1) 计提						0.00
						0.00
3. 本期减少金额						0.00
(1) 处置						0.00
						0.00
4. 期末余额						0.00
四、账面价值						0.00
1. 期末账面价值	54,162,635.58		27,488,000.00	27,600,991.99		109,251,627.57
2. 期初账面价值	150,444,163.77	188,203.47		32,777,453.91		183,409,821.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置	外币报表折算差额	
北京赛莱克斯国际科技有限公司	491,443,302.52		30,516,294.67	521,959,597.19		

青岛展诚科技有限公司		131,227,814.14				131,227,814.14
飞纳经纬科技（北京）有限公司	3,642,504.07					3,642,504.07
合计	495,085,806.59	131,227,814.14	30,516,294.67	521,959,597.19		134,870,318.21

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
飞纳经纬科技（北京）有限公司	3,642,504.07					3,642,504.07
合计	3,642,504.07					3,642,504.07

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
展诚科技商誉资产组	展诚科技（合并报表口径）的固定资产、使用权资产、无形资产以及分摊至该资产组的商誉作为减值测试的资产组组合	集成电路行业	是
飞纳经纬科技（北京）有限公司	以飞纳经纬科技（北京）有限公司整体作为减值测试的资产组	卫星导航行业	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

展诚科技商誉资产组可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定。飞纳经纬科技（北京）有限公司已全额计提商誉减值准备。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
青岛展诚科技有限公司	245,779,935.46	397,600,000.00	0.00	市场法	价值比率（全投资价值比率）	1、结合资本市场情况，对评估对象与可比企业

						所处行业进行分析，选择相对合适的价值比率。 2、分析比较可比公司和评估对象，建立适用的价值参数比较体系。 3、建立价值参数比较标准，将可比公司的参数或指标与评估对象的参数或指标进行比较，得出价值比率修正系数。 4、将价值比率修正系数与价值比率进行相乘，得到修正后价值比率。
合计	245,779,935.46	397,600,000.00				

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

单位：元

项目	业绩承诺完成情况						商誉减值金额	
	本期			上期			本期	上期
	承诺业绩	实际业绩	完成率	承诺业绩	实际业绩	完成率		
扣除非经常性损益后的净利润	16,000,000.00	17,589,139.62	109.93%					
营业收入	160,000,000.00	211,483,792.84	132.18%					

其他说明：

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	4,910,637.04	15,043,688.07	5,047,428.38		14,906,896.73
工艺开发工程	2,346,098.66		430,183.32		1,915,915.34
合计	7,256,735.70	15,043,688.07	5,477,611.70		16,822,812.07

其他说明:

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	117,084,744.00	22,171,407.66	111,648,430.52	17,031,793.39
内部交易未实现利润	15,157,111.38	2,685,092.88	17,579,786.64	3,101,403.21
可抵扣亏损	2,096,375,810.04	267,077,872.99	1,762,304,393.69	221,125,834.87
固定资产折旧			14,814,136.02	3,051,712.02
衍生品公允价值变动			1,572,738.32	323,984.06
租赁资产差异	3,634,640.80	506,127.69	153,549,707.12	31,631,238.85
递延收益	89,958,631.72	11,303,803.28	168,756,556.69	21,094,569.59
合计	2,322,210,937.94	303,744,304.50	2,230,225,749.00	297,360,535.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	27,488,000.00	2,748,800.00	2,980,838.99	655,784.58
租赁资产差异	2,161,952.54	324,292.88	264,407,326.80	54,467,909.32
累计折旧与税法差异			165,999,740.92	34,195,946.63
丧失控制权日按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得	38,905,632.57	9,726,408.14	38,905,632.57	9,726,408.14
衍生品公允价值变动			7,101,460.29	1,462,900.58
内部交易未实现利润	939,211.65	117,401.47	87,489.32	13,123.40
合计	69,494,796.76	12,916,902.49	479,482,488.89	100,522,072.65

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		303,744,304.50		297,360,535.99
递延所得税负债		12,916,902.49		100,522,072.65

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	139,567,626.59	66,644,841.80
可抵扣亏损	491,829,871.26	247,196,373.26
合计	631,397,497.85	313,841,215.06

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年		4,296,316.42	
2026 年	1,788,353.65	5,945,261.22	
2027 年	1,644,255.30	19,545,054.00	
2028 年	11,538,383.93	32,206,608.99	
2029 年	79,224,357.90	147,820,943.48	
2030 年	184,913,358.63	7,175,010.49	
2031 年	11,386,450.21	9,079,495.50	
2032 年	24,727,923.56	12,616,364.86	
2033 年	31,853,914.96	4,488,425.14	
2034 年	25,880,042.94	4,022,893.16	
2035 年	40,380,211.54		
永久	78,492,618.64		
合计	491,829,871.26	247,196,373.26	

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款、 工程款	124,665,378. 48		124,665,378. 48	290,269,154. 18		290,269,154. 18
预付股权款	80,000,000.0 0		80,000,000.0 0			
合计	204,665,378. 48		204,665,378. 48	290,269,154. 18		290,269,154. 18

其他说明：

19、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金					770,000.0 0	770,000.0 0	保证金	不能随时 支取

固定资产					235,738,824.94	208,880,258.17	抵押	抵押
无形资产					95,638,623.40	94,937,427.57	抵押	抵押
合计					332,147,448.34	304,587,685.74		

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	252,528,598.19	109,757,045.17
信用借款	686,800.00	
短期借款应付利息	182,170.48	94,235.79
合计	253,397,568.67	109,851,280.96

短期借款分类的说明：

赛莱克斯北京自兴业银行股份有限公司北京西单支行取得借款人民币 7,990.00 万元，自宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）取得借款人民币 4,993.86 万元，自中国银行股份有限公司北京北三环支行取得借款人民币 6,000.00 万元，自中国进出口银行北京分行取得借款人民币 1,000.00 万元；赛积国际自宁波银行取得借款人民币 4,329.00 万元；以上借款均由公司及公司控股股东杨云春提供担保。

展诚科技自中国工商银行股份有限公司青岛市分行取得借款人民币 940.00 万元，该笔借款由孙延辉及其配偶提供担保。自招商银行股份有限公司青岛分行取得借款人民币 68.68 万元，该笔借款为信用借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

21、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生品（汇率与利率工具）		1,572,738.32
合计		1,572,738.32

其他说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,759,529.24	6,249,110.00
合计	3,759,529.24	6,249,110.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	36,951,560.47	67,558,286.41
1 年以上	9,887,484.44	14,141,567.08
合计	46,839,044.91	81,699,853.49

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

(3) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

是 否

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	164,053,499.14	81,301,309.96
合计	164,053,499.14	81,301,309.96

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应退政府补助	87,350,000.00	
设备及工程款	37,629,725.40	61,980,056.30
应付股权收购款	31,494,400.00	
应付水电费、房租、物业费	3,164,843.50	5,446,181.96
单位往来款	2,336,805.12	613,304.00
应付项目补助款	1,400,000.00	975,111.19
个人款项	586,215.38	1,520,925.22

押金及保证金	5,000.00	33,000.00
应付中介服务费		10,305,979.56
其他	86,509.74	426,751.73
合计	164,053,499.14	81,301,309.96

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	96,196,098.03	89,736,123.14
1 年以上	18,996,982.34	8,380,334.41
合计	115,193,080.37	98,116,457.55

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	9,275,546.40	按照合同正常履约中
合计	9,275,546.40	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,656,022.12	378,787,785.72	390,597,066.06	34,846,741.78
二、离职后福利-设定提存计划	5,200,275.25	29,114,691.70	34,264,434.79	50,532.16
三、辞退福利		1,778,685.11	1,778,685.11	
合计	51,856,297.37	409,681,162.53	426,640,185.96	34,897,273.94

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,763,669.75	303,962,895.09	292,328,488.55	34,398,076.29

2、职工福利费		1,548,146.93	1,548,146.93	
3、社会保险费	12,928,785.44	42,746,878.60	55,646,861.74	28,802.30
其中：医疗保险费	4,470.96	10,291,294.94	10,267,560.01	28,205.89
工伤保险费	91.24	474,826.20	474,321.03	596.41
瑞典公司社会保险费	12,924,223.24	31,979,414.52	44,903,637.76	
马来西亚公司保险费		1,342.94	1,342.94	
4、住房公积金	3,780.00	9,418,437.68	9,405,180.68	17,037.00
5、工会经费和职工教育经费	403,850.97	2,604,552.07	2,605,576.85	402,826.19
6、短期带薪缺勤	10,555,935.96	18,506,875.35	29,062,811.31	
合计	46,656,022.12	378,787,785.72	390,597,066.06	34,846,741.78

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,200,047.13	28,562,253.55	33,713,291.07	49,009.61
2、失业保险费	228.12	552,438.15	551,143.72	1,522.55
合计	5,200,275.25	29,114,691.70	34,264,434.79	50,532.16

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	763,968.06	1,801,267.80
企业所得税	4,980,214.22	11,263,325.90
个人所得税	835,634.63	4,747,969.84
城市维护建设税	11,424.11	50,726.30
教育费附加	6,006.91	21,739.85
地方教育费附加	3,982.75	14,493.23
其他	54,916.35	1,175,688.67
合计	6,656,147.03	19,075,211.59

其他说明：

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	122,215,438.37	41,945,147.85
一年内到期的租赁负债	77,374,726.74	111,697,474.84

合计	199,590,165.11	153,642,622.69
----	----------------	----------------

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,994,983.96	2,037,392.24
合计	4,994,983.96	2,037,392.24

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
合计												

其他说明：

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	334,766,924.12	
抵押借款		141,417,127.48
保证借款	542,063,642.89	521,016,103.74
减：一年内到期的长期借款	-122,215,438.37	-41,945,147.85
合计	754,615,128.64	620,488,083.37

长期借款分类的说明：

(1) 赛积国际自中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）取得借款人民币 24,425 万元，借款期限从 2022 年 10 月 31 日至 2028 年 10 月 31 日；赛莱克斯北京自建设银行取得借款人民币 29,736.29 万元，借款期限从 2023 年 9 月 6 日至 2028 年 9 月 5 日；以上借款均由公司及公司控股股东杨云春先生提供担保。

(2) 赛微电子自上海浦东发展银行股份有限公司北京分行取得借款人民币 7,558.66 万元，借款期限从 2025 年 12 月 22 日至 2035 年 12 月 21 日，该借款由公司控股股东杨云春先生提供担保，同时质押展诚科技 56.24% 股权。

(3) 赛莱克斯国际自北京银行股份有限公司安华路支行取得借款 25,896.77 万元，借款期限为 2025 年 9 月 19 日至 2035 年 9 月 19 日，该借款由公司控股股东杨云春先生提供担保，同时质押赛莱克斯北京 9.5% 股权。

其他说明，包括利率区间：

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁	171,525,401.71	101,004,999.74
合计	171,525,401.71	101,004,999.74

其他说明：

项目	期末余额
资产负债表日后第 1 年	79,353,274.12
资产负债表日后第 2 年	122,570,060.48
资产负债表日后第 3 年	58,241,270.83
以后年度	0.00
最低租赁付款合计	260,164,605.43
未确认融资费用	11,264,476.98
应付融资租赁款	248,900,128.45
其中：1 年内到期的租赁款	77,374,726.74
1 年后到期的租赁款	171,525,401.71

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	31,494,400.00	
合计	31,494,400.00	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	31,494,400.00	
合计	31,494,400.00	

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关	76,976,666.51	12,766,600.00	8,228,234.24	81,515,032.27	政府补助
与收益相关	117,779,890.18	5,242,940.00	86,368,085.25	36,654,744.93	政府补助
合计	194,756,556.69	18,009,540.00	94,596,319.49	118,169,777.20	

其他说明：

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	732,213,134.00						732,213,134.00

其他说明：

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,023,686,094.00	360,871,458.69	204,174,100.79	4,180,383,451.90
其他资本公积	24,709,154.89			24,709,154.89
合计	4,048,395,248.89	360,871,458.69	204,174,100.79	4,205,092,606.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要为瑞典 SiIex 股权激励增加 360,871,458.69 元，本期减少主要为购买少数股权成本与购买日净资产份额之间的差额 204,174,100.79 元。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-137,984,750.19	172,304,744.81				172,304,744.81		34,319,994.62
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		34,313,418.10				34,313,418.10		34,313,418.10
现金流量套期	5,214,929.80	753,318.40	5,968,248.20			-5,214,929		

储备						.80		
外币 财务报表 折算差额	- 143,199,6 79.99	137,238,0 08.31	- 5,968,248 .20			143,206,2 56.51		6,576.52
其他综合 收益合计	- 137,984,7 50.19	172,304,7 44.81				172,304,7 44.81		34,319,99 4.62

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,899,277.77	31,630,363.03		58,529,640.80
合计	26,899,277.77	31,630,363.03		58,529,640.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	254,074,064.86	449,695,631.78
调整后期初未分配利润	254,074,064.86	449,695,631.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,473,454,069.63	-169,994,109.70
减：提取法定盈余公积	31,630,363.03	
应付普通股股利		25,627,457.22
加：分步收购股权购买日之前持有的股权 于购买日的公允价值与账面价值的差额	8,328,000.00	
其他	5,308.75	
期末未分配利润	1,704,231,080.21	254,074,064.86

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细说明：

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	784,087,015.50	501,091,350.30	1,141,496,941.61	757,856,640.80

其他业务	40,018,918.68	30,451,170.16	63,218,695.30	23,933,855.39
合计	824,105,934.18	531,542,520.46	1,204,715,636.91	781,790,496.19

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	824,105,934.18	-	1,204,715,636.91	-
营业收入扣除项目合计金额	40,018,918.68	房租收入 30,998,104.41 元， 销售原材料收入 8,986,842.57 元，其 他服务费收入 33,971.70 元。	63,218,695.30	房租收入 43,345,848.06 元， 销售原材料收入 18,811,297.65 元， 其他服务费收入 1,061,549.59 元。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	4.86%		5.25%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	40,018,918.68	房租收入 30,998,104.41 元， 销售原材料收入 8,986,842.57 元，其 他服务费收入 33,971.70 元。	63,218,695.30	房租收入 43,345,848.06 元， 销售原材料收入 18,811,297.65 元， 其他服务费收入 1,061,549.59 元。
与主营业务无关的业务收入小计	40,018,918.68	房租收入 30,998,104.41 元， 销售原材料收入 8,986,842.57 元，其 他服务费收入 33,971.70 元。	63,218,695.30	房租收入 43,345,848.06 元， 销售原材料收入 18,811,297.65 元， 其他服务费收入 1,061,549.59 元。
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	-	0.00	-
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0.00	-	0.00	-
营业收入扣除后金额	784,087,015.50	房租收入 30,998,104.41 元， 销售原材料收入 8,986,842.57 元，其 他服务费收入 33,971.70 元。	1,141,496,941.61	房租收入 43,345,848.06 元， 销售原材料收入 18,811,297.65 元， 其他服务费收入 1,061,549.59 元。

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	境内分部		境外分部				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中:								
MEMS 纯代工	152,398,536.28	105,937,500.76	531,701,134.31	319,179,482.02			684,099,670.59	425,116,982.78
集成电路设计服务	69,730,562.41	55,317,452.71					69,730,562.41	55,317,452.71
半导体设备	23,625,221.25	16,518,501.57					23,625,221.25	16,518,501.57
其他	25,092,476.22	29,392,057.01	21,558,003.71	5,197,526.39			46,650,479.93	34,589,583.40
按经营地区分类								
其中:								
境内销售	268,777,097.68	205,849,713.54	53,622,607.11	49,205,895.20			322,399,704.79	255,055,608.74
境外销售	2,069,698.48	1,315,798.51	499,636,530.91	275,171,113.21			501,706,229.39	276,486,911.72
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
直销	270,846,796.16	207,165,512.05	553,259,138.02	324,377,008.41			824,105,934.18	531,542,520.46
合计	270,846,796.16	207,165,512.05	553,259,138.02	324,377,008.41			824,105,934.18	531,542,520.46

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	195,915.38	53,001.38
教育费附加	141,864.31	37,858.08
房产税	6,469,879.45	4,797,287.81
土地使用税	153,265.50	153,265.50
车船使用税		750.00
印花税	678,427.04	998,701.93
环境保护税	53,226.36	60,437.10
合计	7,692,578.04	6,101,301.80

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励	360,871,458.69	
中介咨询费用	78,724,099.80	30,421,145.22
工资及福利	63,223,794.75	69,000,089.35
办公费用	15,262,191.60	13,841,989.65
房租物业及仓储费用	14,619,887.07	11,857,467.05
折旧	5,833,357.68	16,919,394.82
无形资产摊销	1,726,692.45	1,694,418.56
业务招待费	1,090,467.68	1,101,280.71
差旅费	1,000,917.14	912,369.47
会议费	215,567.68	374,466.41
其他	2,281,552.42	2,158,739.01
合计	544,849,986.96	148,281,360.25

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费用	15,604,680.14	21,240,384.94
业务招待费	1,898,190.21	2,851,410.16
咨询费	1,356,673.03	2,181,495.18
广告宣传	828,509.57	2,301,148.07
办公费	321,209.05	385,041.67
差旅费	250,970.47	142,062.69
交通费用	39,762.18	134,990.30
会议费	8,135.95	31,610.89
折旧	7,583.38	7,570.15
房租及物业费	2,495.80	15,523.32
其他	299,594.44	13,633.55
合计	20,617,804.22	29,304,870.92

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	139,426,213.71	117,411,520.76
工资及福利	135,923,048.34	128,614,438.17
材料费	40,046,639.16	46,793,931.62
技术服务费	25,171,560.60	116,268,373.50
能源消耗费	24,407,668.87	21,944,741.21
固定资产修理费	15,487,486.67	10,516,512.75
房租及物业费	5,231,402.97	5,628,379.81
无形资产摊销	4,880,062.66	3,987,565.72
办公费用	471,023.27	1,397,446.62
差旅费	383,045.58	386,760.61
危废处理	300,001.52	1,285,796.70
其他	1,001,499.86	595,366.37
合计	392,729,653.21	454,830,833.84

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,270,754.05	37,232,659.26
减：利息收入	34,906,410.02	14,166,971.57
手续费支出	143,232.63	112,049.36
汇兑损失	72,214,501.73	8,261,006.78
减：汇兑收益	608,194.91	19,430,024.40
合计	67,113,883.48	12,008,719.43

其他说明：

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,309,820.49	21,036,693.29
增值税加计抵减	3,439,906.66	7,854,137.04
个税手续费返还	205,043.54	93,606.89
税费减免		25.01
合计	9,954,770.69	28,984,462.23

46、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	44,701,328.67	3,221,338.55
处置长期股权投资产生的投资收益	855,640,819.37	9,847,838.20
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	302,736.00	285,600.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	1,330,192,759.65	
合计	2,230,837,643.69	13,354,776.75

其他说明：

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-17,994,963.47	-20,676,158.03
其他应收款坏账损失	17,683,255.06	-23,689,557.58
合计	-311,708.41	-44,365,715.61

其他说明：

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-120,117,683.96	-26,826,486.29
十一、合同资产减值损失		146,062.50
合计	-120,117,683.96	-26,680,423.79

其他说明：

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	255,635.05	142,260.55
在建工程处置利得		1,890,255.96
合计	255,635.05	2,032,516.51

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	43,416.55	17,831.53	43,416.55
合计	43,416.55	17,831.53	43,416.55

其他说明：

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		5,852.23	
其他	115,893.69	214.28	115,893.69
合计	115,893.69	6,066.51	115,893.69

其他说明：

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,254,939.25	47,751,731.41
递延所得税费用	-39,584,084.15	-46,760,342.31
合计	-8,329,144.90	991,389.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,380,105,687.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	345,026,421.93
子公司适用不同税率的影响	-145,007,115.18
调整以前期间所得税的影响	330,335.16
非应税收入的影响	-343,799,091.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	84,858,669.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-365,003.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	63,038,688.15
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-11,082,594.85
加计扣除	-48,579,464.95
上期可弥补亏损账面与申报差异	3,945,043.83
本期转回以前期间确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损	42,301,951.61
境外收入缴税	986,536.38
其他	16,479.79
所得税费用	-8,329,144.90

其他说明：

55、其他综合收益

详见附注 36、其他综合收益。

56、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	75,260,914.81	60,063,716.15
政府补助	26,716,349.75	72,361,696.53
保证金或押金	5,067,625.67	1,304,259.72
员工备用金	279,879.74	104,576.74
利息收入	34,906,410.02	14,166,971.57
营业外收入	0.25	17,831.53
合计	142,231,180.24	148,019,052.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用类	109,904,687.72	66,893,060.23
往来款	11,573,543.23	12,946,100.00
保证金或押金	1,501,224.31	3,302,529.72
员工备用金	2,068,197.27	324,968.79
手续费	143,232.63	112,049.36
营业外支出	115,750.22	179.43
合计	125,306,635.38	83,578,887.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的现金	1,671,940,764.25	0.00
处置参股公司收到的现金	37,204,765.93	9,847,838.20
收回投资成本	6,504,791.44	4,708,461.16
股利收入	302,736.00	2,535,600.00
处置固定资产	110,011.10	157,606.71
合计	1,716,063,068.72	17,249,506.07

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购置长期资产	135,308,776.45	483,012,067.82
购买子公司少数股权	324,083,309.60	
投资参股公司	173,977,475.60	128,408,229.53
购买子公司	61,812,618.38	
合计	695,182,180.03	611,420,297.35

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁保证金	17,790,000.00	
保证金户收款		1,230,000.00
合计	17,790,000.00	1,230,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁保证金	5,000,000.00	18,400,000.00
支付经营租赁本金及利息	419,746.79	
回购限制性股票		15,970,828.45
合计	5,419,746.79	34,370,828.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	109,851,280.96	273,256,230.02	14,326,852.90	144,036,795.21	0.00	253,397,568.67
一年内到期的非流动负债	153,642,622.69	0.00	177,841,762.39	70,034,167.81	61,860,052.16	199,590,165.11
长期借款	620,488,083.37	611,593,368.48	42,696,894.91	290,293,424.69	229,869,793.43	754,615,128.64
租赁负债	101,004,999.74	265,000,000.00	36,434,733.01	46,536,567.91	184,377,763.13	171,525,401.71
合计	984,986,986.76	1,149,849,598.50	271,300,243.21	550,900,955.62	476,107,608.72	1,379,128,264.13

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**57、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,388,434,832.63	-255,255,953.51
加：资产减值准备	120,429,392.37	71,046,139.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	181,198,451.64	175,448,579.34
使用权资产折旧	46,584,646.45	64,720,955.50
无形资产摊销	9,278,019.19	7,991,764.78
长期待摊费用摊销	5,477,611.70	2,062,458.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-255,635.05	-2,032,516.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		5,852.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	101,877,060.87	26,063,641.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,230,837,643.69	-13,354,776.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,343,888.45	-83,674,724.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,240,195.70	36,914,382.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,104,262.01	-18,754,564.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	320,584,262.36	234,723,496.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-123,182,812.30	59,801,943.56
其他	285,193,399.91	49,887,835.38
经营活动产生的现金流量净额	-13,906,760.08	355,594,512.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,244,368,874.18	615,452,918.72
减：现金的期初余额	615,452,918.72	945,649,183.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,628,915,955.46	-330,196,264.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	94,483,200.00
其中：	
青岛展诚科技有限公司	94,483,200.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	32,670,581.62
其中：	
青岛展诚科技有限公司	32,670,581.62
其中：	
取得子公司支付的现金净额	61,812,618.38

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,789,780,680.53
其中：	
Silex Microsystems AB	1,789,780,680.53
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	117,839,916.28
其中：	
Silex Microsystems AB	117,839,916.28
其中：	
处置子公司收到的现金净额	1,671,940,764.25

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,244,368,874.18	615,452,918.72
其中：库存现金		25,000.00
可随时用于支付的银行存款	2,244,368,874.18	615,427,918.66
可随时用于支付的其他货币资金		0.06
三、期末现金及现金等价物余额	2,244,368,874.18	615,452,918.72

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
信用证保证金		770,000.00	不能随时支取
合计		770,000.00	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	225,749,637.86	7.0288	1,586,749,054.59
欧元	94,038.59	8.2355	774,454.81
港币	149,477.03	0.9032	135,007.66
应收账款			
其中：美元	25,000.00	7.0288	175,720.00
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

60、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本公司作为承租方以简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁主要为租赁房屋、机器等，本期租赁费用合计为 3,979,610.45 元。

涉及售后租回交易的情况

本公司售后租回交易主要涉及机器设备，详见“七、合并财务报表项目注释 13 使用权资产”和“七、合并财务报表项目注释 31 租赁负债”。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
瑞典 Sillex 园区厂房出租	21,558,003.71	
其他房屋建筑物出租	9,440,100.70	
合计	30,998,104.41	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

61、数据资源

62、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	135,923,048.34	128,614,438.17
折旧	139,426,213.71	117,411,520.76
材料费	40,046,639.16	46,793,931.62
技术服务费	25,171,560.60	116,268,373.50
能源消耗费	24,407,668.87	21,944,741.21
固定资产修理费	15,487,486.67	10,516,512.75
无形资产摊销	4,880,062.66	3,987,565.72
房租及物业费	5,231,402.97	5,628,379.81
危废处理	300,001.52	1,285,796.70
办公费用	471,023.27	1,397,446.62
差旅费	383,045.58	386,760.61
其他	1,001,499.86	595,366.37
合计	392,729,653.21	454,830,833.84
其中：费用化研发支出	392,729,653.21	454,830,833.84

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
青岛展诚科技有限公司	2025年09月30日	162,472,000.00	61.00%	现金购买	2025年09月30日	1、购买方已实际控制被购买方的财务和经营政策，享有收益并承担风险；2、完成股权过户、资产移交等法律手续；3、已支付超过50%的合并对价，剩余款项支付能力明确且无实质性障碍；4、企业合并合同或协议已获董事会通过。	70,105,090.71	13,070,211.65	27,633,726.39

其他说明：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
青岛展诚科技有限公司	2025-9-30	157,472,000.00	56.24%	现金购买
青岛展诚科技有限公司	2022-5-24	5,000,000.00	4.76%	现金购买

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	青岛展诚科技有限公司
--现金	157,472,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	

--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	13,328,000.00
--其他	
合并成本合计	170,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	39,572,185.86
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	131,227,814.14

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	青岛展诚科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	32,670,581.62	32,670,581.62
应收款项		
存货	194,690.27	194,690.27
固定资产	731,368.19	731,368.19
无形资产	29,408,978.18	202,978.18
应收账款	41,901,931.65	41,901,931.65
预付款项	91,693,022.54	91,693,022.54
其他应收款	3,662,568.88	3,662,568.88
其他流动资产	2,780,150.94	2,780,150.94
长期股权投资	372,307.40	372,307.40
使用权资产	2,383,717.25	2,383,717.25
递延所得税资产	1,828,723.67	1,828,723.67
负债：		
借款	10,086,800.00	10,086,800.00
应付款项		
递延所得税负债	3,158,971.74	238,371.73
应付账款	11,306,432.57	11,306,432.57
合同负债	83,612,411.88	83,612,411.88
应付职工薪酬	21,561,729.16	21,561,729.16
应交税费	858,737.63	858,737.63
其他应付款	1,428,190.91	1,428,190.91
一年内到期的非流动负债	862,523.65	862,523.65
其他流动负债	4,744,445.68	4,744,445.68
租赁负债	1,269,701.02	1,269,701.02
预计负债	963,303.24	963,303.24
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
净资产	65,774,793.11	39,489,393.12

减：少数股东权益	902,357.28	902,357.28
取得的净资产	64,872,435.83	38,587,035.84

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权的取得时点	购买日之前原持有股权的取得比例	购买日之前原持有股权的取得成本	购买日之前原持有股权的取得方式	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益或留存收益的金额
青岛展诚科技有限公司	2022年05月24日	4.76%	5,000,000.00	现金购买	5,000,000.00	13,328,000.00	8,328,000.00	新增股权的交易价格	0.00

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	

--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面	丧失控制权之日合并财务报表层面	按照公允价值重新计量剩余股权产	丧失控制权之日合并财务报表层面	与原子公司股权投资相关的其他综

						务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额		剩余股 权的账 面价值	剩余股 权的公 允价值	生的利 得或损 失	剩余股 权公允 价值的 确定方 法及主 要假设	合收益 转入投 资损益 或留存 收益的 金额
Silex Microsy stems AB	1,789,7 80,680. 53	45.24%	现金处 置	2025 年 07 月 23 日	1、企业 合并合 同或协 议已获 董事 会、股 东大会 等通 过； 2、参与 合并各 方已办 理了必 要的财 产权转 移手 续； 3、购买 方已支 付了全 部购买 价款的大 部分； 4、合并 方或购 买方实 际上已 经控制 了被合 并方或 被购买 方的财 务和经 营政 策，并 享有相 应的利 益、承 担相应 的风 险。	1,339,9 59,659. 65	45.24%	449,821 ,020.88	1,780,0 13,780. 53	1,330,1 92,759. 65	按照本 次交易 的每股 价格	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

除前述合并范围变动外，本报告期新设立运通电子技术发展有限公司以及无锡筑芯科技有限公司，详细信息见“十、1. 在子公司中的权益”附注。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京赛莱克斯国际科技有限公司	1,500,000,000.00	北京市北京经济技术开发区西环南路26号院1幢4层3A11室	北京市北京经济技术开发区西环南路26号院1幢4层3A11室	技术开发/销售	100.00%		非同一控制下企业合并
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	2,105,263,200.00	北京市北京经济技术开发区科创八街21号院1号楼(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)	北京市北京经济技术开发区科创八街21号院1号楼(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)	技术开发/销售		80.00%	通过设立方式取得
运通电子有限公司	10,000.00 港币	香港特别行政区海港城海洋中心16楼1627	香港特别行政区海港城海洋中心16楼1627	持股平台		100.00%	非同一控制下企业合并
北京赛积国际科技有限公司	880,000,000.00	北京市北京经济技术开发区科创十三街1号院3号楼2层101-07室	北京市北京经济技术开发区科创十三街1号院3号楼2层101-07室	技术开发/销售	100.00%		通过设立方式取得
北京海创微芯科技有限公司	30,000,000.00	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼三层329-04室	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼三层329-04室	技术开发/销售		70.00%	通过设立方式取得
飞纳经纬科技（北京）	10,000,000.00	北京市西城区裕民路18	北京市西城区裕民路18	技术开发/销售	65.00%		非同一控制下企业合并

有限公司		号 24 层 2606 号	号 24 层 2606 号				
北京微芯科 技有限公司	100,000,00 0.00	北京市北京 经济技术开发区 科创十三街 1 号 院 3 号楼 2 层 101-06 室	北京市北京 经济技术开发区 科创十三街 1 号 院 3 号楼 2 层 101-06 室	技术开发/ 销售	100.00%		通过设立方 式取得
北京中科赛 微电子科技 有限公司	10,000,000 .00	北京市海淀 区花园北路 25 号小关 (厂南区) 5 幢 2 层 1- 208 室	北京市海淀 区花园北路 25 号小关 (厂南区) 5 幢 2 层 1- 208 室	技术开发/ 销售		57.14%	通过设立方 式取得
北京极芯传 感科技中心 (有限合 伙)	3,000,000. 00	北京市北京 经济技术开发区 科谷一街 10 号 院 5 号楼 8 层 801 室	北京市北京 经济技术开发区 科谷一街 10 号 院 5 号楼 8 层 801 室	投资平台	99.00%	1.00%	通过设立方 式取得
赛莱克斯微 系统科技 (深圳)有 限公司	1,500,000, 000.00	深圳市光明 区凤凰街道 东坑社区凤 归路 3 号 2 栋一层	深圳市光明 区凤凰街道 东坑社区凤 归路 3 号 2 栋一层	技术开发/ 销售		30.00%	通过设立方 式取得
北京海创微 元科技有限 公司	300,000,00 0.00	北京市怀柔 区大富乐村 北红螺东路 21 号 56 幢 2 层 210 室	北京市怀柔 区大富乐村 北红螺东路 21 号 56 幢 2 层 210 室	技术开发/ 销售	42.00%		通过设立方 式取得
青岛展诚科 技有限公司	4,800,338. 55	山东省青岛 市市南区延 安三路 109 号华通中联 创意产业园 B2 栋 3 层	山东省青岛 市市南区延 安三路 109 号华通中联 创意产业园 B2 栋 3 层	技术开发/ 销售	56.24%	4.76%	非同一控制 下企业合并
南京宁芯微 电子科技有 限公司	1,050,000. 00	南京市江北 新区研创园 江淼路 88 号腾飞大厦 A 座 6 层 612 室	南京市江北 新区研创园 江淼路 88 号腾飞大厦 A 座 6 层 612 室	技术开发/ 销售		100.00%	非同一控制 下企业合并
成都芯卓微 电子科技有 限公司	1,000,000. 00	中国(四川) 自由贸易试 验区成都高 新区天府大 道中段 1388 号 1 栋 5 层 522 号	中国(四川) 自由贸易试 验区成都高 新区天府大 道中段 1388 号 1 栋 5 层 522 号	技术开发/ 销售		100.00%	非同一控制 下企业合并
青岛芯诚微 电子科技有 限公司	3,000,000. 00	山东省青岛 市崂山区松 岭路 169 号 青岛国际创 新园二期 D2-1601	山东省青岛 市崂山区松 岭路 169 号 青岛国际创 新园二期 D2-1601	技术开发/ 销售		100.00%	非同一控制 下企业合并

上海芯舵科技有限公司	1,000,000.00	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2305 号 B 幢 908 室（房产登记证为 8 层）	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2305 号 B 幢 908 室（房产登记证为 8 层）	技术开发/销售		51.00%	非同一控制下企业合并
无锡筑芯科技有限公司	1,000,000.00	无锡市新吴区菱湖大道 111-34 号无锡软件园天鹅座 D 座 301 室-077	无锡市新吴区菱湖大道 111-34 号无锡软件园天鹅座 D 座 301 室-077	技术开发/销售		51.00%	通过设立方式取得
运通电子技术发展有限公司	10,000.00 港币	香港特别行政区海港城海洋中心 16 楼 1627	香港特别行政区海港城海洋中心 16 楼 1627	技术开发/销售		100.00%	通过设立方式取得
VCHIP SDN. BHD.	10,000.00 林吉特	马来西亚, 檳城, 乔治市, 苏丹艾哈迈德沙路, BHL 大厦, 51-10-F	马来西亚, 檳城, 乔治市, 苏丹艾哈迈德沙路, BHL 大厦, 51-10-F	技术开发/销售		100.00%	非同一控制下企业合并
亞芯（香港）有限公司	10,000.00 港币	香港特别行政区九龙湾宏光道 8 号创豪坊 8 层 5 号	香港特别行政区九龙湾宏光道 8 号创豪坊 8 层 5 号	持股平台		100.00%	非同一控制下企业合并

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司持有赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司 30% 股权，为第一大股东，赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司设有董事会，董事会由 3 名成员组成，北京赛莱克斯国际科技有限公司提名 2 人，且赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司董事长由本公司董事长杨云春担任，财务及法务等相关事务亦由本公司控制，本公司能够控制赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司，因此将其纳入合并报表范围。

公司直接持有北京海创微元科技有限公司 42% 股权，为第一大股东，北京海创微元科技有限公司设有董事会，董事会由 5 名成员组成，公司提名 3 人，且北京海创微元科技有限公司董事长由本公司董事长杨云春担任，财务及法务等相关事务亦由本公司控制，本公司能够控制北京海创微元科技有限公司，因此将其纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	20.00%	-77,168,561.34		206,438,787.28
青岛展诚科技有限公司	39.00%	4,810,307.65		30,202,653.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	940,094,653.05	2,122,407,195.11	3,062,501,848.16	1,563,063,711.56	458,322,916.56	2,021,386,628.12	895,678,255.38	2,359,454,905.15	3,255,133,160.53	1,488,864,978.58	415,265,468.07	1,904,130,446.65
青岛展诚科技有限公司	193,778,799.78	34,076,616.10	227,855,415.88	142,166,372.32	6,755,721.38	148,922,093.70						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	172,968,267.48	-309,887,493.84	-309,887,493.84	-252,217,275.50	262,338,632.29	-241,878,583.26	-241,878,583.26	206,222,576.96
青岛展诚科技有限公司	70,105,090.71	13,070,211.65	13,066,433.24	28,126,893.07				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	324,083,309.60
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	324,083,309.60
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	119,909,208.81
差额	204,174,100.79
其中：调整资本公积	204,174,100.79
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Silex Microsystems AB	瑞典斯德哥尔摩	瑞典斯德哥尔摩	技术开发/销售/代工生产		45.24%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

瑞典 Silex 在 2025 年第四季度发行了具有不同权利设置的 C 类股票。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	Silex Microsystems AB	
流动资产	679,209,351.20	
非流动资产	1,031,238,555.07	
资产合计	1,710,447,906.27	
流动负债	295,131,773.54	
非流动负债	328,451,299.80	
负债合计	623,583,073.34	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,086,864,832.93	

按持股比例计算的净资产份额	491,697,650.41	
调整事项		
--商誉	1,374,790,749.90	
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,866,488,400.31	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	500,718,323.80	
净利润	115,298,854.29	
终止经营的净利润		
其他综合收益	75,847,520.12	
综合收益总额	191,146,374.41	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	596,125,215.55	580,845,635.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-7,459,873.01	3,221,338.55
--综合收益总额	-7,459,873.01	3,221,338.55

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	76,976,666.51	12,766,600.00		8,228,234.24	0.00	81,515,032.27	与资产相关
递延收益	117,779,890.18	3,242,940.00		21,151,817.81	-63,216,267.44	36,654,744.93	与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	6,309,820.49	21,036,693.29

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、衍生金融资产、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

（1）国际局势及汇率波动风险

自二战之后，特别是上世纪八九十年代以来，全球化发展日益加速，已成为时代发展的重要特征和显著标志，国家之间在经济、政治、文化、社会等方面的交流程度大幅提升，在加速科技进步和生产力发展的同时，也使得民族国家的利益面临着多元化的冲击和挑战，最终导致民族主义情绪的累积并在近年来显著抬头，右翼民粹主义、反全球化主义、贸易保护主义、本土主义等主张在全球，尤其是欧美国家泛起，引发国际局势紧张及日趋复杂化，对跨国经营的企业提出诸多新的挑战。公司同时持有境内外资产及业务，近年来直接源自境外营业收入的比例较高，2023-2025 年的比例分别为 50.04%、59.28%、60.88%，虽然公司在报告期已完成瑞典 Sillex 控制权出售的交割，但公司持有外币资产且部分原材料采购以及 MEMS 业务的部分机器设备采购仍涉及外币结算，日常涉及美元、欧元、瑞典克朗、日元、人民币等货币。因此，公司日常经营活动客观上面临着国际政治经济局势剧烈变化的风险，随之而来的还包括因汇率大幅波动对公司报表业绩（以人民币计算）产生较大影响的风险。

（2）行业竞争加剧的风险

公司 MEMS 主业直接参与全球竞争，竞争对手既包括博世、惠普、意法半导体、德州仪器等 IDM 企业，也包括 Teledyne、台积电、X-FAB、索尼、Atomica 等境外代工企业，以及芯联集成、广州增芯、上海先进、华虹宏力、华润微、士兰微、华鑫微纳等含 MEMS 业务的境内企业；芯片设计服务及 EDA 工具服务竞争对手包括创意电子、智原科技、灿芯股份、创耀科技、芯原股份、华大九天、概伦电子、广立微、行芯科技等。MEMS 属于技术、智力及资金密集型行业，涉及电子、机械、光学、医学等多个专业领域，技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响企业核心竞争力的关键因素。若公司不能正确判断未来市场及产品竞争的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。

（3）新兴行业的创新风险

公司 MEMS 主业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，同时也是国家“十五五”规划中的科技前沿攻关领域，该产业技术进步及迭代迅速，要求行业参与者不断通过新技术/工艺的研究和新产品的开发以应对下游需求的变化。如公司对新技术/工艺、新产品的投入不足，或投入方向偏离行业创新发展趋势或未能符合重要客户需求的变化，将会损害公司的技术优势与核心竞争力，从而给公司的市场竞争地位和经营业绩带来不利影响；此外，近年来，公司研发费用支出的绝对金额以及占营业收入的比重均处于高位，2023-2025 年，公司研发费用分别高达 3.57 亿元、4.55 亿元、3.93 亿元，占营业收入的比重分别高达 27.44%、37.75%、47.66%，而研发活动本身存在一定的不确定性，公司还存在研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力的创新风险。

2、信用风险

2025 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司的信用风险主要来自于货币资金、应收账款及其他应收款。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司存在信用风险集中的情况，应收账款余额前五名占 2025 年 12 月 31 日应收账款余额的 60.87%。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨云春。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
西安智诚微电子科技有限公司	联营企业
北京北工怀微传感科技股权投资基金(有限合伙)	联营企业

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京瑞宏宇星科技有限公司	公司董事持股超过 5%的企业
北京芯东来半导体科技有限公司	担任董事的企业
青岛聚能创芯微电子有限公司	担任董事长的企业
海创智能装备（烟台）有限公司	本公司实际控制人控制的公司
穆林	本公司实际控制人之配偶

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
西安智诚微电子科技有限公司	采购服务	2,246,130.47		否	
西安智诚微电子科技有限公司	采购服务	471,698.11		否	
海创智能装备（烟台）有限公司	采购设备	16,725,663.72	50,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京瑞宏宇星科技有限公司	提供服务	2,566,371.69	
西安智诚微电子科技有限公司	提供服务	294,060.85	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
穆林	房屋	268,224.00	309,732.00			268,224.00	309,732.00				
杨云春	房屋	281,207.68	87,877.40			87,877.40					

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京赛积国际科技有限公司	250,000,000.00	2022年10月31日	2028年10月31日	否
北京赛积国际科技有限公司	50,000,000.00	2025年09月05日	2026年12月31日	否
北京赛积国际科技有限公司	25,000,000.00	2025年10月15日	2027年10月15日	否
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	50,000,000.00	2025年09月05日	2026年12月31日	否
赛莱克斯微系统科技	100,000,000.00	2025年04月23日	2026年04月22日	否

(北京)有限公司				
赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司	100,000,000.00	2025年12月25日	2027年01月25日	否
赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司	100,000,000.00	2025年09月30日	2026年09月30日	否
赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司	450,000,000.00	2023年09月06日	2028年09月05日	否
赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司	230,000,000.00	2025年05月29日	2028年05月28日	否
北京赛莱克斯国际科技有限公司	258,967,680.00	2025年09月15日	2035年09月15日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨云春	10,000,000.00	2025年10月15日	2027年10月15日	否
杨云春	125,977,600.00	2025年12月11日	2035年12月10日	否
杨云春	250,000,000.00	2022年10月31日	2028年10月31日	否
杨云春	50,000,000.00	2025年09月05日	2026年12月31日	否
杨云春	25,000,000.00	2025年10月15日	2027年10月15日	否
杨云春	50,000,000.00	2025年09月05日	2026年12月31日	否
杨云春	100,000,000.00	2025年04月23日	2026年04月22日	否
杨云春	100,000,000.00	2025年12月25日	2027年01月25日	否
杨云春	100,000,000.00	2025年09月30日	2026年09月30日	否
杨云春	450,000,000.00	2023年09月06日	2028年09月05日	否
杨云春	258,967,680.00	2025年09月15日	2035年09月15日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,355,725.12	7,461,553.08

(8) 其他关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	购买价格
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国家集成电路基金当时为公司第二大股东且持有公司 5%以上股份，同时公司董事张帅先生由国家集成电路基金委派	收购股权	收购控股子公司 9.5%股权	以经过具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告为基础，根据赛莱克斯北京实际经营、资产情况以及双方合作情况确定	323,709,600.00
海南依迈科技有限公司、海创智能装备（烟台）有限公司	为公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生实际控制企业且其担任执行董事	收购股权	收购海南依迈、海创智能装备持有的芯东来部分股权	以芯东来 2025 年 5 月融资投后估值 5 亿元为参考，并结合实际经营、资产、所在行业估值及未来发展、合作情况，经各方初步协商确定	37,224,000.00
北京北工怀微传感科技股权投资基金（有限合伙）	公司联营企业	收购股权	收购北工怀微持有的芯东来股权	以芯东来 2025 年 5 月融资投后估值 5 亿元为参考，并结合实际经营、资产、所在行业估值及未来发展、合作情况，经各方初步协商确定	15,600,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安智诚微电子科技有限公司	311,704.50	15,585.23		
应收账款	北京芯东来半导体科技有限公司			15,550,000.00	1,555,000.00
其他应收款	北京芯东来半导体科技有限公司			113,304.00	5,665.20

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西安智诚微电子科技有限公司	1,609,451.16	
应付账款	北京芯东来半导体科技有限公司		26,415.09
合同负债	北京芯东来半导体科技有限公司	6,500,761.91	
合同负债	青岛聚能创芯微电子有限公司	4,425,000.00	4,425,000.00
合同负债	北京瑞宏宇星科技有限公司	2,946,902.65	2,735,849.06
其他应付款	海创智能装备（烟台）有限公司	11,055,663.72	
其他应付款	杨云春	281,207.68	87,877.40
其他流动负债	北京芯东来半导体科技有限公司	845,099.05	
其他流动负债	青岛聚能创芯微电子有限公司		575,250.00
其他流动负债	北京瑞宏宇星科技有限公司	383,097.35	164,150.94

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	360,871,458.69
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	360,871,458.69

其他说明：

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
Silex Microsystems AB 管理层员工	360,871,458.69	
合计	360,871,458.69	

其他说明：

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）		3.70
拟分配每 10 股分红股（股）		0.00
拟分配每 10 股转增数（股）		0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）		0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）		0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）		0.00
利润分配方案	公司拟以目前总股本 732,213,134 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 3.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。	

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
Silex Microsystems AB	553,259,138.02	798,552,129.56	1,841,207,764.60	29,572,964.44	1,811,634,800.16	1,811,634,800.16

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、耐威时代借款逾期事项

赛微电子公司 2021 年 3 月 16 日第四届董事会第十次会议以及 2021 年 4 月 6 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》，同意将全资子公司耐威时代 100%股权以 3.74 亿元人民币转让给青州市宏源公有资产经营有限公司。公司于 2021 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司股权转让交易调整的议案》，同意公司签署《股权转让协议补充协议》，各方均同意北京耐威时代科技有限公

司原持有的导航产业基地土地使用权、房屋、建筑物及构筑物等资产不再列入原协议项下股权转让标的范围内，股权价款变更为 18,121.71 万元。2022 年 3 月 29 日，耐威时代已完成该次股权转让交易的工商变更登记程序并取得新的营业执照。截止 2022 年 3 月 10 日，上述股权转让款已全部收回。

在赛微电子公司作为耐威时代控股股东期间，为支持耐威时代业务发展，赛微电子公司向其提供借款，借款金额 227,964,855.12 元，待支付的分红款 28,000,000.00 元，上述款项均未归还。针对上述借款，公司与耐威时代及耐威时代控股股东青州市宏源国有资产经营有限公司签署了《还款协议》，具体还款内容如下：

- (1) 耐威时代应当于 2023 年偿还人民币 25,964,855.12 元；
- (2) 耐威时代应当于 2024 年偿还人民币 100,000,000.00 元；
- (3) 耐威时代应当于 2025 年偿还人民币 130,000,000.00 元。

截止 2025 年 12 月 31 日，耐威时代上述借款及分红款已偿还 195,250,000.00 元，尚余借款 60,714,855.12 元未偿还，该笔款项已逾期。截止本财务报告披露日，上述款项尚未偿还。公司已与耐威时代达成协议，耐威时代承诺在 2026 年 5 月 31 日前全额偿还上述款项。

2、其他说明

公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生所持公司 11,843,479 股股份被司法冻结（诉前保全），占其所持股份的比例为 6.61%，占公司总股本比例为 1.62%。该事项起因因为杨云春先生控股的商业主体（非赛微电子及其子公司）与申请保全方的融资租赁合同纠纷。山东省青岛市中级人民法院于 2026 年 3 月 24 日对案件进行了开庭审理，庭审结束后法院征求了原告方和被告方的调解意向。基于各方目前的调解意愿，法院暂时不会做出判决，后续各方若能达成调解方案，法院会出具调解书；若不能达成调解方案，法院会及时做出判决。

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,227,700.00	65,019,900.00
1 至 2 年	45,019,900.00	33,351,747.76
2 至 3 年	33,351,747.76	21,699,537.12
3 年以上	35,641,567.71	17,459,530.59
3 至 4 年	21,699,537.12	5,652,000.00
4 至 5 年	5,650,000.00	3,786,324.09
5 年以上	8,292,030.59	8,021,206.50
合计	135,240,915.47	137,530,715.47

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	1,600,000.00	1.18%	1,600,000.00	100.00%		5,117,500.00	3.72%	5,117,500.00	100.00%	
其中:										
客户 1	1,600,000.00	1.18%	1,600,000.00	100.00%		1,600,000.00	1.16%	1,600,000.00	100.00%	
客户 2						3,390,000.00	2.46%	3,390,000.00	100.00%	
客户 3						127,500.00	0.10%	127,500.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	133,640,915.47	98.82%	34,295,523.70	25.66%	99,345,391.77	132,413,215.47	96.28%	20,365,042.97	15.38%	112,048,172.50
其中:										
账龄组合	133,640,915.47	98.82%	34,295,523.70	25.66%	99,345,391.77	132,413,215.47	96.28%	20,365,042.97	15.38%	112,048,172.50
合计	135,240,915.47	100.00%	35,895,523.70	26.54%	99,345,391.77	137,530,715.47	100.00%	25,482,542.97	18.53%	112,048,172.50

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	客户财务困难
客户 2	3,390,000.00	3,390,000.00				客户财务困难
客户 3	127,500.00	127,500.00				客户财务困难
合计	5,117,500.00	5,117,500.00	1,600,000.00	1,600,000.00		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	21,227,700.00	1,061,385.00	5.00%
1 至 2 年	45,019,900.00	4,501,990.00	10.00%
2 至 3 年	33,351,747.76	6,670,349.55	20.00%
3 至 4 年	21,699,537.12	10,849,768.56	50.00%
4 至 5 年	5,650,000.00	4,520,000.00	80.00%
5 年以上	6,692,030.59	6,692,030.59	100.00%
合计	133,640,915.47	34,295,523.70	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	5,117,500.00		3,517,500.00			1,600,000.00
按组合计提坏账准备	20,365,042.97	13,930,480.73				34,295,523.70
合计	25,482,542.97	13,930,480.73	3,517,500.00			35,895,523.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	27,909,300.00		27,909,300.00	20.64%	3,041,700.00
客户 2	20,257,800.00		20,257,800.00	14.98%	7,831,455.00
客户 3	19,000,000.00		19,000,000.00	14.05%	1,900,000.00
客户 4	18,590,700.00		18,590,700.00	13.75%	2,507,760.00
客户 5	9,721,401.44		9,721,401.44	7.19%	4,860,700.72
合计	95,479,201.44		95,479,201.44	70.61%	20,141,615.72

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	200,000,000.00	
其他应收款	1,560,519,281.05	1,569,624,109.71

合计	1,760,519,281.05	1,569,624,109.71
----	------------------	------------------

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京赛莱克斯国际科技有限公司	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

核销说明：

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权投资款	876,640,066.62	876,640,066.62
往来款	714,865,915.22	741,830,488.51
股权转让款	2,550,000.00	2,550,000.00
押金及保证金	2,004,850.00	19,646.20
备用金	483,127.47	373,127.47
代扣代缴款项	162,182.61	147,110.61
合计	1,596,706,141.92	1,621,560,439.41

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	491,680,661.68	571,942,235.40
1 至 2 年	194,818,097.38	36,023,127.47
2 至 3 年	4,400,000.00	103,084,500.00
3 年以上	905,807,382.86	910,510,576.54
3 至 4 年	63,293,127.47	691,185,053.88
4 至 5 年	623,188,732.73	5,869,867.86
5 年以上	219,325,522.66	213,455,654.80
合计	1,596,706,141.92	1,621,560,439.41

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	49,386,329.70		2,550,000.00	51,936,329.70
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

本期计提	-15,749,468.83			-15,749,468.83
2025年12月31日余额	33,636,860.87		2,550,000.00	36,186,860.87

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	51,936,329.70	-15,749,468.83				36,186,860.87
合计	51,936,329.70	-15,749,468.83				36,186,860.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京赛莱克斯国际科技有限公司	股权投资款	825,840,066.62	1-2年 19,800,000.00元, 4-5年 595,020,198.76元, 5年以上 211,019,867.86元	51.72%	
赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司	往来款	335,220,120.34	1年以内 216,900,000.00元, 1-2年	20.99%	

			118,320,120.34 元		
北京海创微芯科技有限公司	往来款	148,565,334.96	1 年以内 144,487,357.92 元, 1-2 年 4,077,977.04 元	9.30%	
北京微芯科技有限公司	往来款	127,930,000.00	1 年以内	8.01%	
北京耐威时代科技有限公司	往来款	60,714,855.12	3-4 年 52,000,000.00 元, 4-5 年 8,714,855.12 元	3.80%	32,971,884.10
合计		1,498,270,377.04		93.82%	32,971,884.10

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,927,144,70 3.52		2,927,144,70 3.52	2,769,672,70 3.52		2,769,672,70 3.52
对联营、合营企业投资	527,391,127. 85		527,391,127. 85	524,205,124. 40		524,205,124. 40
合计	3,454,535,83 1.37		3,454,535,83 1.37	3,293,877,82 7.92		3,293,877,82 7.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备期 初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
北京赛莱克斯国际科技有限公司	1,784,620,7 61.87						1,784,620,7 61.87	
飞纳经纬科技(北京)有限公司	16,500,000. 00						16,500,000. 00	
北京微芯科技有限公司	75,084,429. 40						75,084,429. 40	
北京赛积国际科技有限公司	767,467,512 .25						767,467,512 .25	
北京海创微	126,000,000						126,000,000	

元科技有限 公司	.00						.00	
青岛展诚科 技有限公司			157,472,000				157,472,000	
			.00				.00	
合计	2,769,672,7 03.52		157,472,000				2,927,144,7 03.52	
			.00					

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资 单位	期初余 额（账 面价 值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动							期末余 额（账 面价 值）	减值准 备期末 余额	
			追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
武汉光 谷信息 技术股 份有限 公司和 湖北北 斗产业 创业投 资基金 合伙企 业（有 限合 伙）	358,690 ,007.74		17,503, 475.60		- 7,382,0 86.82						368,811 ,396.52	
青岛海 丝民合 半导体 投资中 心（有 限合 伙）	11,698, 578.82			2,348,0 26.91							9,350,5 51.91	
青岛聚 能创芯 微电子 有限公 司	18,950, 758.89				- 6,216,1 31.48						12,734, 627.41	
北京赛 微私募 基金管 理有限 公司	11,346, 498.02				975,677 .18						12,322, 175.20	
北京北 工怀微 传感科 技股权 投资基 金（有限	123,519 ,280.93			3,375,0 00.00	4,028,0 95.88						124,172 ,376.81	

合伙)												
小计	524,205,124.40		17,503,475.60	5,723,026.91	8,594,445.24	-						527,391,127.85
合计	524,205,124.40		17,503,475.60	5,723,026.91	8,594,445.24	-						527,391,127.85

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

由于武汉光谷信息技术股份有限公司为新三板挂牌企业（证券代码 430161），其截至 2026 年 3 月 26 日尚未披露 2025 年年度报告，因此将武汉光谷信息技术股份有限公司及湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合并列示。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,930,973.45	13,539,823.01	47,436,491.89	42,898,215.93
其他业务	11,383,996.03		11,961,543.20	
合计	24,314,969.48	13,539,823.01	59,398,035.09	42,898,215.93

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
半导体设备	11,592,920.35	12,831,858.41					11,592,920.35	12,831,858.41
其他	12,722,049.13	707,964.60					12,722,049.13	707,964.60
按经营地区分类								
其中：								
境内销售	24,314,969.48	13,539,823.01					24,314,969.48	13,539,823.01
市场或客户类型								

其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计	24,314,969.48	13,539,823.01					24,314,969.48	13,539,823.01

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,594,445.24	3,352,968.45
处置长期股权投资产生的投资收益	37,199,457.18	9,847,838.20
成本法核算的长期股权投资股利收入	300,000,000.00	

合计	328,605,011.94	13,200,806.65
----	----------------	---------------

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	2,186,089,214.07	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,240,259.33	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-360,871,458.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,477.14	
减：所得税影响额	9,525,312.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,456,042.54	
合计	1,815,404,183.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	25.27%	2.0123	2.0123
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.86%	-0.4670	-0.4670

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他